气派科技股份有限公司

ChinaChippackingTechnologyCO.,Ltd.

（深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道165号恒顺厂区1栋1楼105、2-5楼）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告之招股说明书全文作为投资决定的依据。

保荐人 **国信证券股份有限公司**

（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼）

【发行概况】

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型	人民币普通股（A股）
本次发行股数	不超过2,434万股
拟公开发行新股数量	不超过2,434万股
拟公开发售股份数量	本次发行不安排现有股东进行公开发售
发行后总股本	不超过9,734万股
每股面值	1.00元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
本次发行新股提示	公司本次公开发行新股数量不超过2,434万股，占发行后总股本的25.01%。最终发行数量以本次发行募集资金投资项目所需资金量和中国证监会的最终核准文件为准。
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	公司实际控制人梁大钟、白瑛分别承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人梁大钟的关联方梁晓英承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、东

	莞红土创业投资有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业/公司已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除梁大钟、白瑛、梁晓英外的其它12名自然人股东分别承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期满后两年内，本人每年转让公司首次公开发行股票前已发行的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的25%，如持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。 除此之外，担任公司董事、监事和高级管理人员的梁大钟、白瑛、施保球、赵红、林忠、文正国、谭云烽分别承诺：上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2014年【】月【】日

【发行人声明】

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司提醒投资者在投资决策过程中应重点考虑公开发售股份的影响，并认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”全文，特别注意以下事项：

一、本次发行的相关重要承诺和说明

（一）公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案及约束措施

1、启动股价稳定措施的具体条件

公司上市后三年内，如公司A股股票收盘价格连续20个交易日（第20个交易日称为“触发稳定股价措施日”）均低于公司最近一期的每股净资产，则在触发稳定股价措施日之日起10个交易日内，公司、公司控股股东、公司的董事和高级管理人员（以下统称为“相关主体”）应协商确定启动本预案规定的及/或有关法律法规、监管机构届时要求的一种或多种措施，以稳定公司股价。

本预案中所称每股净资产是指经审计的公司最近一期合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数除以该期审计基准日时公司的股份总数；如该期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。

2、稳定股价的具体措施

在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，公司、公司控股股东、公司的董事和高级管理人员将采取以下一种或多种措施稳定公司股价：（1）公司控股股东增持公司股票；（2）公司回购公司股票；（3）公司董事（独立董事和不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）法律法规及证券监管部门允许的其他方式。该等具体措施将在公司及/或相关主体按照其所适用的法律法规履行相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后依法实施。

（1）控股股东增持A股股票

如相关主体确定由控股股东以增持公司A股股票方式稳定公司股价的，则公

司控股股东应在前述决定作出之日起5个交易日内向公司提出增持公司A股股票的计划，并由公司按规定予以公告。如在触发稳定股价措施日之日起10个交易日内，相关主体未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，则触发控股股东的自动增持义务，控股股东应于前述期限届满之日起5个交易日内向公司提出增持公司A股股票的计划，并由公司按规定予以公告。

在上述任一情形下，控股股东应按照有关法律法规的规定通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股票，增持价格不高于公司最近一期每股净资产，用于增持的资金总额不少于其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红的50%，增持期限为增持公告发布且控股股东的增持计划获得有权机构批准（如需要）之日起六个月。单一会计年度内控股股东用于增持公司A股股票的资金不超过其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红的100%。

控股股东的增持计划公告后及在增持期间，如公司A股股票收盘价连续20个交易日高于最近一期每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。如增持将导致公司股权分布不符合A股上市条件的，则控股股东可以终止实施增持计划。

（2）公司回购A股股票

如相关主体确定由公司以回购A股股票方式稳定公司股价，且在公司符合有关法律法规关于上市公司回购股份的前提下，公司应在前述决定作出之日起5个交易日内制订回购公司A股股票方案并提交董事会审议，董事会在审议通过后及时将回购方案提交股东大会审议。

公司制定的回购方案应包括以下内容：回购方式为通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购；回购价格不高于公司最近一期每股净资产，拟用于回购的资金总额不少于公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的20%，单一会计年度内用于回购的资金总额合计不超过公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的50%。公司回购A股股票的方案将在履行内部决策和外部审批、备案等手续（如需要）后六个月内实施。

上述回购方案生效后及回购期间，如公司A股股票收盘价连续20个交易日高于最近一期每股净资产，则公司可中止回购。如回购股份将导致公司股权分布不

符合A股上市条件的，则公司可以终止实施回购方案。

（3）董事和高级管理人员增持A股股票（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）

如相关主体确定由独立董事、不在公司领取薪酬的董事以外的其他董事和高级管理人员（以下简称“有增持义务的董事和高管”）以增持公司A股股票方式稳定公司股价的，则有增持义务的董事和高管应在前述决定作出之日起5个交易日内向公司提出增持公司A股股票的计划，并由公司按规定予以公告。有增持义务的董事和高管应在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，以不高于公司最近一期每股净资产的价格，并以不低于各自上一年度从公司取得的税后薪酬的20%的资金，以集中竞价交易方式增持公司A股股票，增持期限为增持公告发布之日起六个月。单一会计年度内有增持义务的董事和高管用于增持公司A股股票的资金不超过其上一年度从公司取得的税后薪酬的50%。

增持计划公告后及在增持期间，如公司A股股票收盘价连续20个交易日高于最近一期每股净资产，则有增持义务的董事和高管可中止实施增持计划。如增持将导致公司股权分布不符合A股上市条件的，则有增持义务的董事和高管可以终止实施增持计划。

（4）稳定股价措施的再次启动

在采取上述一种或多种稳定股价措施且在执行完毕后，再次出现公司A股股票收盘价格连续20个交易日均低于公司最近一期每股净资产的，则相关主体应在该情形出现之日起10个交易日内重新确定启动新一轮的稳定股价措施。

（5）其他股价稳定措施

独立董事、不在公司领取薪酬的董事应督促公司、控股股东、有增持义务的董事和高管执行本预案规定的稳定股价措施。

在实施上述既定的股价稳定措施过程中，公司和相关主体可以制定其他符合法律法规及监管要求的股价稳定措施。

3、相关约束措施

（1）相关主体未能及时协商确定股价稳定具体措施的约束措施

如在触发稳定股价措施日之日起10个交易日内，相关主体未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，则除非是由于不可抗力原因导致，否则，公司、公司控股股东、公司的董事和高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉。

（2）对控股股东的约束措施

如相关主体确定由控股股东以增持公司A股股票方式稳定公司股价，或者触发本预案规定的控股股东自动增持义务，但控股股东未按照本预案规定履行增持义务，以及如相关主体确定由公司以回购A股股票方式稳定公司股价，但控股股东无合法理由对股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得股东大会通过的，则公司有权扣留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款，控股股东放弃对该部分分红款的所有权，由公司用于回购股份资金或其他用途。

（3）对公司及公司董事、高级管理人员的约束措施

如相关主体确定由公司以回购A股股票方式稳定公司股价，但公司未及时制定公司股份回购方案提交董事会审议，则公司及负有责任的董事、高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉，公司应继续履行尽快制定股份回购方案的义务，董事和高级管理人员应督促公司履行前述义务。

（4）对有增持义务的董事和高管的约束措施

如有增持义务的董事和高管未按照本预案规定履行其增持义务的，则公司有权扣留相等于应履行但未履行增持义务的董事、高管应承担的用于增持的资金总额的薪酬，被扣留薪酬的董事或高级管理人员放弃对该部分薪酬的所有权。

（5）对独立董事、不在公司领取薪酬的董事约束措施

如独立董事、不在公司领取薪酬的董事未能勤勉尽责地依法督促公司、控股股东、有增持义务的董事和高管执行稳定股价措施的，应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉。

（6）对拟聘任的董事、高级管理人员的约束措施

在本预案有效期内，公司新聘任的董事、高级管理人员应履行本预案规定的

董事、高级管理人员的义务并按同等标准履行公司A股上市时董事、高级管理人员已作出的其他承诺和义务。对于拟聘任的董事、高级管理人员，公司应在获得其书面同意履行前述承诺和义务后方可聘任。

（二）信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺及约束措施

1、公司因信息披露虚假陈述的承诺及约束措施

公司承诺：如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效之日起10个工作日内制订回购全部新股的方案，并按照有关法律法规和本公司章程的规定提交董事会审议，董事会在审议通过后及时提交股东大会审议。本公司回购股份的价格按照市场情况确定，但每股回购价格将不低于首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若本公司在首次公开发行股票后有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。本公司将按照届时有效的法律法规及股东大会决议实施回购方案。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

本公司在上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一旦生效，本公司即会严格履行该等承诺事项。同时，本公司将积极督促本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等相关主体履行其在本公司上市过程中作出的公开承诺事项并执行有关约束措施。

如本公司未能履行或未能如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺，本公司应在指定信息披露媒体上公开道歉。如本公司未能依法、诚信、全面、适当履行所作出的公开承诺事项，使得本公司中小股东因信赖该等承诺而遭受直接经济损失的，本公司将按照有权司法机构作出的生效裁决赔偿中小股东遭受的全部直接经济损失。

本公司如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行公开承诺事项的，本公司应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护中小股东合法权益的，本公司应充分披露原因，并提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，上述变更方案应提交本公司股东大会审议，并向股东提供网络投票方式。本公司独立董事、监事会应就本公司提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司中小股东的合法权益发表意见。

除上述约束措施外，本公司愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。

2、公司控股股东信息披露虚假陈述的承诺及约束措施

公司控股股东及实际控制人梁大钟、白瑛承诺：如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效之日起10个工作日内制定购回已转让的原限售股份的具体方案，并在该方案取得有权机构批准（如需要）后依法实施。本人购回已转让的原限售股份的价格按照市场情况确定，但每股购回价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，购回价格将相应进行除权、除息调整）。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭

受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或者致使投资者在证券交易中遭受损失的，并因此触发公司回购首次公开发行的全部新股的义务、责任的，或者触发公司董事、监事和高级管理人员的赔偿义务、责任的，本人保证在公司股东大会上对与上述回购、赔偿有关的议案投赞成票，并将依法督促公司及其董事、监事和高级管理人员履行其相关义务和承担相关责任。

本人在公司上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一旦生效，本人即会严格履行该等承诺事项。同时，本人将积极督促公司及其董事、监事和高级管理人员、其他股东等相关主体履行其在公司上市过程中作出的公开承诺事项并执行有关约束措施。

除了本人所作出的公开承诺事项已列明的约束措施外，如本人未能依法履行本人作出的公开承诺事项的，本人应在指定信息披露媒体上公开道歉，并且公司有权扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款直至本人依法履行相关承诺。

本人如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行公开承诺事项的，本人应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司和中小股东合法权益的，本人应充分披露原因，并提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，上述变更方案应提交公司股东大会审议，且本人及关联方应回避表决。

除上述约束措施外，本公司愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。

3、公司董事、监事及高级管理人员因信息披露虚假陈述的承诺及约束措施

公司董事、监事及高级管理人员承诺：如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

本人在公司上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一旦生效，本人即会严格履行该等承诺事项。同时，本人将积极督促公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员等相关主体履行其在公司上市过程中作出的公开承诺事项并执行有关约束措施。

除了《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中规定与本人有关的约束措施外，如本人未能依法履行其他公开承诺事项的，本人应在指定信息披露媒体上公开道歉，并且公司有权扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款（如有）直至本人依法履行相关承诺。

本人如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行公开承诺事项的，本人应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司和中小股东合法权益的，本人应充分披露原因，并提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，上述变更方案应提交公司股东大会审议。

除上述约束措施外，本公司愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。

4、本次发行中介机构的承诺

国信证券股份有限公司承诺：如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该

等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本事务所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

北京市竞天公诚律师事务所承诺：若本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。

（三）公司持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向、减持意向及约束措施

公司首次公开发行股票前，持有公司股份超过股本总额的5%的股东梁大钟、白瑛分别承诺：

本人作为公司控股股东/实际控制人，通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好公司的长期发展，如本人因各种原因需要减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，本人将严格遵守中国法律法规关于控股股东/实际控制人持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行控股股东/实际控制人的义务，并在确定减持时间、方式和价格时充分考虑公司股价稳定和中小投资者合法权益。

基于上述原则，如本人在锁定期满后两年内需要减持的，则每年减持股份数量不超过本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份数量的25%，减持价格不低于发行价；如本人在锁定期满两年后需要减持的，可以按照法律法规允许的价格和数量减持。本人将在减持前4个交易日通知公司，并在减持前3个交易日公告。自公司上市之日起至本人减持期间如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等情况的，则本人减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相应调整。

如违反上述减持价格下限减持的，本人应将[（发行价－实际减持价格）×低于发行价减持股份数量]对应的所得款项上缴公司。如违反上述减持股份数量上限减持的，本人应将[实际减持价格×（实际减持股份数量－承诺减持股份数量上限）]对应的所得款项上缴公司。在本人未履行完毕前述约束措施时，公司有权等额扣留应向本人支付的分红及/或薪酬等款项。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

（四）本次发行方案的说明

2014年第四次（临时）股东大会审议通过了本次发行方案主要内容如下：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：人民币1.00元。

3、发行数量：不超过2,434万股，均为新股，具体发行新股的数量由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求协商确定。本次发行不安排现有股东进行公开发售。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合公司和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、定价方式：由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

7、承销方式：余额包销。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

9、决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起24个月。

（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及约束措施

1、公司实际控制人梁大钟、白瑛分别承诺：

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（以下简称“发行价”，期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

在遵守上述股份锁定承诺的基础上，如对本人适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本人所持公司股份有其他锁定要求，本人将自动遵守该等要求。

本人授权公司按照本人的上述承诺直接办理股份的锁定手续。除非经证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本人应将违反股份锁定承诺转让所持公司股份对应的所得款项上缴公司。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

2、梁大钟的关联人梁晓英承诺：

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期满后两年内，本人每年转让公司首次公开发行股票前已发行的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的25%，如持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。

在遵守上述股份锁定承诺的基础上，如对本人适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本人所持公司股份有其他锁定要求，本人将自动遵守该等要求。

本人授权公司按照本人的上述承诺直接办理股份的锁定手续。除非经证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本人应将违反股份锁定承诺转让所持公司股份对应的所得款项上缴公司。

3、除梁大钟、白瑛以外的担任董事、高级管理人员的施保球、林忠、文正国、谭云烽分别承诺：

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期满后两年内，本人每年转让公司首次公开发行股票前已发行的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的25%，如持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（以下简称“发行价”，期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

在遵守上述股份锁定承诺的基础上，如对本人适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本人所持公司股份有其他锁定要求，本人将自动遵守该等要求。

本人授权公司按照本人的上述承诺直接办理股份的锁定手续。除非经证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本人应将违反股份锁定承诺转让所持公司股份对应的所得款项上缴公司。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

4、担任公司监事的赵红承诺：

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期满后两年内，本人每年转让公司首次公开发行股票前已发行的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的25%，如持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

在遵守上述股份锁定承诺的基础上，如对本人适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本人所持公司股份有其他锁定要求，本人将自动遵守该等要求。

本人授权公司按照本人的上述承诺直接办理股份的锁定手续。除非经证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本人应将违反股份锁定承诺转让所持公司股份对应的所得款项上缴公司。

5、合伙企业股东和法人股东中和春生、创新投、深圳红土、东莞红土分别承诺：

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业/公司已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

在遵守上述股份锁定承诺的基础上，如对本企业/公司适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本企业/公司所持公司股份有其他锁定要求，本企业/公司将自动遵守该等要求。

本企业/公司授权公司按照本企业/公司的上述承诺直接办理股份的锁定手续。除非经证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本企

业/公司应将违反股份锁定承诺转让所持公司股份对应的所得款项上缴公司。

6、上述股东之外的自然人股东承诺

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期满后两年内，本人每年转让公司首次公开发行股票前已发行的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的25%，如持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。

在遵守上述股份锁定承诺的基础上，如对本人适用的有关法律、法规、规范性文件或有权监管机构对本人所持公司股份有其他锁定要求，本人将自动遵守该等要求。

本人授权公司按照本人的上述承诺直接办理股份的锁定手续。除非经证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本人应将违反股份锁定承诺转让所持公司股份对应的所得款项上缴公司。

二、滚存利润的分配安排

根据2014年9月13日召开的本公司2014年第四次（临时）股东大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票完成后由新老股东按其持股比例享有。

三、本次发行上市后的股利分配政策

公司2014年第四次（临时）股东大会审议通过了发行上市后适用的《公司章程》（草案），公司利润分配政策主要如下：

（一）利润分配的原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但应当优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，

应当采用现金分红进行利润分配。在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。

（三）利润分配的具体内容和条件

公司进行现金分红的具体条件为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过5,000万元。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。

在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的20%，且在任何3个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。

公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：1、公司经营情况良好；2、因公司股票价格与公司股本规模不匹配或者公司有重大投资计划或重大现金支出、公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东的整体利益；3、公司的现金分红符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）利润分配政策及其调整的决策程序和机制

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和《公司章程》的规定制订合理

的利润分配方案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，其中，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对公司生产经营造成重大不利影响的，公司经详细论证后可以对既定利润分配政策作出调整。公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定，经董事会审议通过后须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在有关法律、法规、规范性文件允许或《公司章程》规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因、留存未分配利润的用途以及独立董事的明确意见，公司当年的利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司在将该利润分配议案提交股东大会审议时应为投资者提供网络

投票便利条件。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司2014年第四次（临时）股东大会审议通过了《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，具体内容参见“第十四节 股利分配政策”。

四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险因素，并提醒投资者认真阅读“第四节 风险因素”全部内容。

（一）业绩下滑的风险

当宏观经济或集成电路行业景气度下降、原材料价格上涨、租赁厂房搬迁、税收政策变化等风险因素发生时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司将有可能出现经营业绩下滑甚至超过50%及以上的风险。

（二）所得税补缴的风险

公司是深圳市龙岗区注册成立的生产性企业，根据全国人民代表大会常务委员会于1980年8月26日颁发的《广东省经济特区条例》第14条规定：“特区企业所得税税率为15%”。深圳市政府于1993年1月21日颁布的《关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》第2条规定：“设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，按照深圳经济特区的规定，一律按15%的税率征收企业所得税，免征地方所得税和地方附加”。

公司于2008年4月1日取得深圳市龙岗区国家税务局平湖税务分局下发的“深国税龙平减免[2008]0009号”《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》：

根据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定同意本公司从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税。第3年至第5年减半征收所得税。

公司2011年10月被“深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局”评为“高新技术企业”。依据《中华人民共和国企业所得税法》享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）：自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行。

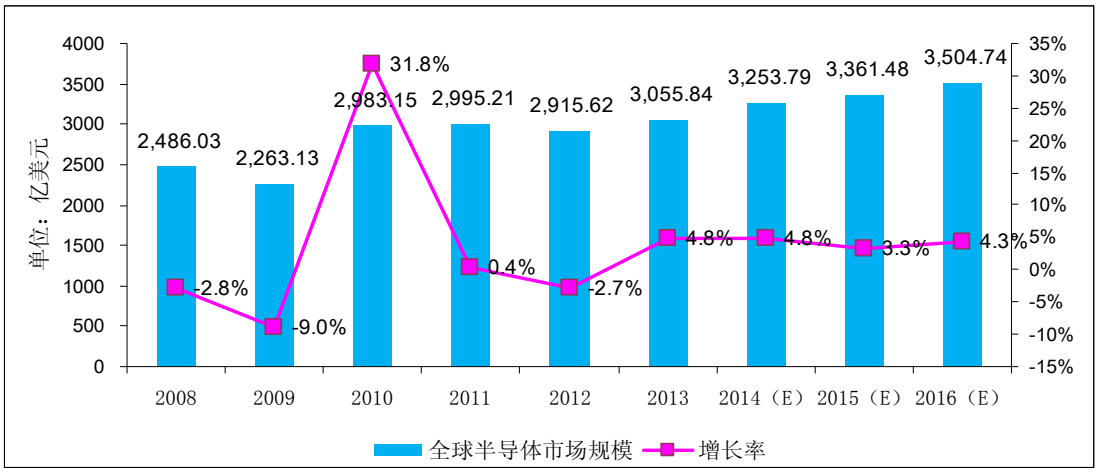
综上，公司选择2008年、2009年免征企业所得税，2010年-2012年减半征收企业所得税的优惠政策，2010年税率为11%，2011年税率为12%，2012年税率为12.5%，2013年开始按高新技术企业15%的税率缴纳企业所得税。

公司在2008-2012年享受的上述“两免三减半”和“企业所得税优惠过渡政策”的税收优惠系深圳市人民政府的规定，该等规定在深圳普遍适用，但其并无国家法律上的依据，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。针对可能被追缴所享受企业所得税优惠的风险，本公司控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛承诺：若公司因享受深圳市地方政府规定的企业所得税优惠政策而被国家税务主管机关要求补缴相关企业所得税差额的，本人将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受经济损失。如本人违反上述承诺导致公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

（三）行业大幅波动风险

公司属于集成电路封装测试行业，半导体行业的发展状况影响公司的生产经营状况。

图：2008-2016 年全球半导体销售情况及预测



资料来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）

半导体行业市场则呈现周期性波动的特点，国内半导体行业受全球半导体行业周期性的影响。如果全球半导体市场出现较大幅度下滑，可能对公司经营业绩造成重大不利影响。

目 录

第一节 释 义 28
一、普通术语 28
二、专业术语 29
第二节 概 览 31
一、公司简介 31
二、公司控股股东、实际控制人简介 32
三、公司主要财务数据 33
四、本次发行情况 34
五、募集资金用途 34
第三节 本次发行概况 36
一、本次发行的基本情况 36
二、发行费用 36
三、本次发行新股的有关当事人 36
四、发行人与本次发行相关当事人之间的关系 38
五、与本次发行上市有关的重要日期 38
第四节 风险因素 39
一、经营风险 39
二、管理风险 40
三、募集资金投资项目的风险 41
四、业绩下滑的风险 41
五、所得税优惠风险 41
第五节 公司基本情况 43
一、公司基本资料 43
二、公司的历史沿革及改制重组情况 43
三、公司股本结构的形成及变化情况 46
四、重大资产重组情况 62
五、公司股东机构和组织结构 63
六、公司控股子公司的基本情况 66

七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.....66
八、公司股本情况.....67
九、公司员工及其社会保障情况.....73
十、公司持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.....78
第六节 业务和技术.....81
一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.....81
二、发行人所处行业的基本情况.....82
三、发行人在行业中的竞争地位.....109
四、发行人主营业务情况.....113
五、固定资产及无形资产.....121
六、特许经营权情况.....127
七、发行人的技术与研究开发情况.....127
八、发行人主要产品的质量控制情况.....130
九、境外经营情况.....132
十、冠名“科技”的依据.....132
第七节 同业竞争与关联交易.....133
一、同业竞争.....133
二、关联方及关联关系.....133
三、关联方交易.....135
四、公司关联交易的决策权限与程序.....138
五、公司关联交易制度的执行情况及独立董事意见.....140
六、公司规范和减少关联交易的措施.....141
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....142
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.....142
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况.....146
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.....147
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬及兼职情况.....148
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.....149

六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议、作出的承诺及其履行情况.....149
七、公司与董事、监事、高级管理人员任职资格.....150
八、公司董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况.....150
第九节 公司治理.....152
一、公司法人治理制度建立健全情况.....152
二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责情况.....152
三、公司近三年违法违规行为情况.....161
四、公司近三年资金占用和对外担保的情况.....161
五、公司内部控制情况.....162
第十节 财务会计信息.....163
一、财务报表.....163
二、合并报表范围及变化情况.....169
三、采用的主要会计政策和会计估计.....170
四、公司适用的税率及享受的税收优惠政策.....187
五、经注册会计师核验的非经常性损益.....188
六、最近一期末主要资产的情况.....190
七、主要负债.....191
八、所有者权益情况.....191
九、现金流情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及影响.....193
十、期后事项、或有事项及其他重要事项.....193
十一、财务状况分析.....193
十二、资产评估情况.....195
十三、历次验资情况.....196
第十一节 管理层讨论与分析.....197
一、财务状况分析.....197
二、盈利能力分析.....212
三、现金流量分析.....224
四、其他事项说明.....226

五、财务状况和盈利能力未来趋势分析.....226
六、未来分红回报规划.....228
七、财务状况和盈利能力未来趋势的分析.....229
第十二节 业务发展目标.....231
一、公司总体发展目标和战略.....231
二、未来三年的发展规划.....231
三、拟定上述规划所依据的假设条件及面临的主要困难.....233
四、上述业务发展规划与现有业务的关系.....234
五、本次募集资金对实现上述业务目标的作用.....234
第十三节 募集资金运用.....235
一、募集资金运用概况.....235
二、本次募集资金投资项目情况.....236
第十四节 股利分配政策.....254
一、报告期内的股利分配政策.....254
二、报告期内的股利分配情况.....255
三、发行后的股利分配政策.....255
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....258
第十五节 其他重要事项.....259
一、信息披露制度相关情况.....259
二、重要合同.....259
三、对外担保.....263
四、重大诉讼或仲裁.....263
五、刑事诉讼.....264
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关 中介机构声明.....265
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明.....265
二、保荐人（主承销商）声明.....266
三、发行人律师声明.....267
四、审计机构声明.....268
五、验资机构声明.....269
六、评估机构声明.....270

第十七节 备查文件 271

一、备查文件 271

二、备查文件查阅时间 271

三、备查文件查阅地点 271

第一节 释 义

本招股说明书中，除另有说明外，下列简称具有以下含义：

一、普通术语

气派科技/发行人/股份公司/公司/本公司	指	气派科技股份有限公司
气派有限/有限公司	指	深圳市气派科技有限公司
广东气派	指	广东气派科技有限公司
天光集成	指	深圳市天光集成电路有限公司
中和春生	指	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司
东莞红土	指	东莞红土创业投资有限公司
深圳红土	指	深圳市红土信息创业投资有限公司
环宇微	指	深圳市环宇微电子有限公司
励创微	指	深圳市励创微电子有限公司
南翔科技	指	深圳市南翔科技有限公司
普达芯	指	深圳普达芯电子有限公司
华芯邦	指	深圳市华芯邦科技有限公司
馨晋商	指	深圳市馨晋商电子有限公司
华润赛美科	指	华润赛美科微电子（深圳）有限公司
汉高华威	指	汉高华威电子有限公司
宁波康强	指	宁波康强电子股份有限公司
进峰贸易	指	进峰贸易（深圳）有限公司
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
华润安盛科技	指	无锡华润安盛科技有限公司
本次发行	指	发行人本次向社会公众公开发行 2,434 万股人民币普通股的行为
股东大会	指	气派科技股份有限公司股东大会
董事会	指	气派科技股份有限公司董事会
监事会	指	气派科技股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

《公司章程》	指	公司现行的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
广东省发改委	指	广东省发展和改革委员会
保荐机构/主承销商	指	国信证券股份有限公司
审计机构/会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市竞天公诚律师事务所
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年、2011 年
报告期各期末	指	2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日

二、专业术语

封装	指	对通过测试的晶圆进行划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立具有完整功能的集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起着保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通芯片内部与外部电路的作用。
IDM	指	集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的集成器件制造商。
DIP	指	Dual in line-pin package 的缩写，也叫双列直插式封装技术，采用双列直插形式封装的集成电路芯片。
SOP	指	Small OutlinePackage 的缩写，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）
TSOP	指	Thin Small Outline Package 的缩写，意思是薄型小尺寸封装。TSOP 内存是在芯片的周围做出引脚，采用 SMT 技术（表面安装技术）直接附着在 PCB 板的表面。
TSSOP	指	Thin Shrink Small Outline Package 的缩写，薄的缩小型小尺寸封装，比 SOP 薄、引脚更密，相同功能的情况下，封装尺寸更小。
BGA	指	Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装技术，它是集成电路采用有机载板的一种封装法。
QFN	指	Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低。但是，当印刷基板与封装之间产生应力时，在电极接触处就不能得到缓解。因此电极触点难于作到 QFP 的引脚那样多，一般从 14 到 100 左右。
TSV	指	硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路。
晶圆	指	多指单晶硅圆片 ,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,按其直径分为 4 英寸、 5 英寸、 6 英寸、 8 英寸、 12 英寸等规格。

LED	指	发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics 的缩写，即世界半导体贸易统计组织
CSIA	指	中国半导体行业协会
3D	指	三维立体封装
CSP	指	芯片级封装产品

备注：本招股书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、公司简介

（一）公司简要情况

公司名称：气派科技股份有限公司

注册资本：7,300万元

法定代表人：梁大钟

有限公司成立日期：2006年11月7日

股份公司成立日期：2013年6月6日

住所：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道165号恒顺厂区1栋1楼105、2-5楼

公司前身为深圳市气派科技有限公司，成立于2006年11月7日，成立时注册资本为1,000万元，出资方式为货币出资。

2013年5月2日，梁大钟、白瑛、施保球等15位发起人共同签署了《发起人协议书》，决定以2013年3月31日为改制审计基准日，依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职深ZH[2013]457号），以经审计的账面净资产14,719.69万元为基础，按1:0.4484的比例折股，共折合为6,600万股，剩余部分计入资本公积，整体变更为气派科技股份有限公司。

2013年5月15日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《深圳市气派科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目的资产评估报告书》（沃克森评报字[2013]第0145号），气派有限2013年3月31日净资产评估值为15,785.15万元。

2013年5月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职深ZH[2013]464号），经审验，气派科技股份有限公司收到发起人股东投入的注册资本合计人民币6,600万元，资本公积为人民币8,119.69万元。

2013年6月6日，股份公司在深圳市市场监督管理局办理了变更设立登记，注册登记号440307103987683。

（二）公司主营业务情况

公司以集成电路封装测试技术的研发与应用为基础，从事集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案。据中国半导体行业协会的数据显示，2013年公司封测业务收入位列国内封装测试业第29名、内资封装测试企业第5名，公司业已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业，是我国内资集成电路封装测试服务商中少数具备较强的质量管理、工艺创新能力的技术应用型企业之一。

二、公司控股股东、实际控制人简介

公司的控股股东为梁大钟，其持有公司5,115万股股份，占发行前公司总股本的70.07%。

公司的实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇，白瑛持有公司1,080万股股份，占发行前公司总股本的14.79%；本次发行前，梁大钟、白瑛夫妇合计持有公司股份6,195万股股份，合计持股占发行前公司总股本的84.86%。

梁大钟：董事长、总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1959年2月，本科，毕业于电子科技大学固体器件专业；1984年至1990年任华越微电子有限公司工程师；1990年至1997年在深圳电子市场从事业务工作；1997年至2008年任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理；2001年至2012年任天光集成执行董事、总经理；2006年11月至2013年6月任气派有限执行董事、总经理；2011年至今任平湖街道商会（工商联）第五届理事会（执委会）常务理事（常务委员）；2013年至今任深圳市龙岗区电子行业联合会副会长；2013年6月至今任公司董事长、总经理；2013年5月至今任广东气派执行董事、总经理。作为公司核心技术人员，梁大钟主导并参与了公司35项专利技术的研发。

白瑛：董事，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年5月，高中；1983年至1992年就职于华越微电子有限公司；1992年至1997年在深圳电子市场从事业务工作；1997年至2008年任深圳市天光微电子有限公司副总经理，2004年至2012年任天光集成监事；2006年至2013年6月任气派有限监事；2013年6月至今，

任公司董事。

三、公司主要财务数据

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产合计	14,321.00	20,698.81	12,799.22	6,799.44
非流动资产合计	22,092.43	19,059.65	14,869.43	11,035.13
资产合计	36,413.44	39,758.46	27,668.65	17,834.56
流动负债合计	11,700.43	13,209.25	11,012.95	8,622.84
非流动负债合计	301.15	2,500.00	2,800.00	-
负债合计	12,001.58	15,709.25	13,812.95	8,622.84
所有者权益合计	24,411.86	24,049.21	13,855.70	9,211.72

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	12,904.61	28,395.48	26,039.82	19,437.91
营业利润	1,254.53	5,263.67	5,329.08	3,463.13
利润总额	1,273.91	5,397.34	5,422.54	3,585.86
净利润	1,092.64	4,628.51	4,717.98	3,150.35
归属于母公司所有者的净利润	1,092.64	4,628.51	4,717.98	3,150.35
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,076.17	4,593.89	4,495.28	2,933.46

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,593.16	7,165.65	5,439.05	4,983.63
投资活动产生的现金流量净额	-5,101.47	-6,346.22	-4,981.59	-5,189.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,235.18	3,737.76	1,762.54	685.58
现金及现金等价物净增加额	-4,743.49	4,557.20	2,219.99	479.91
期末现金及现金等价物余额	2,823.17	7,566.65	3,009.45	789.46

（四）公司主要财务指标

主要财务指标	2014 年 1-6 月 /2014-6-30	2013 年度/ 2013-12-31	2012 年度/ 2012-12-31	2011 年度/ 2011-12-31
流动比率（倍）	1.22	1.57	1.16	0.79
速动比率（倍）	0.95	1.36	0.99	0.67
应收账款周转率（次）	2.24	5.44	6.73	8.93
存货周转率（次）	3.45	8.81	12.48	17.76
资产负债率（母公司）	32.16%	39.80%	49.92%	48.35%
息税折旧摊销前利润（万元）	2,616.49	7,815.48	7,337.38	4,810.70
利息保障倍数（倍）	2,330.04	28.53	24.15	44.02
每股经营活动的现金流量（元）	0.49	0.98	0.82	0.83
每股净现金流量（元）	-0.65	0.62	0.34	0.08
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.15%	0.15%	0.28%	0.00%
归属于公司股东的每股净资产（元）	3.34	3.29	2.10	1.54
基本每股收益（元/股）	0.15	0.70	0.79	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.70	0.79	0.53
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	4.44%	28.43%	40.71%	37.24%

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：1.00元

发行股数：2,434万股，占发行后总股本的比例25.01%

发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式

发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

五、募集资金用途

根据公司的生产经营及发展规划，本次发行募集资金拟用于以下2个项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	建设期	项目的审批、核准或备案情况
1	先进集成电路封装测试扩产项目	36,527.83	4 年	已在广东省发改委备案（备案号：141900405319004）
2	研发中心建设项目	4,921.51	2.5 年	已在广东省发改委备案（备案号：141900405319005）

本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金少于投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款予以解决。

关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

序号	项目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股（A股）
2	每股面值	每股面值人民币1.00元
3	发行数量	本次公开发行数量不超过2,434万股，占发行后总股本的比例25.01%，其中公开发行新股数量不超过2,434万股，不涉及公司股东公开发售股份
4	每股发行价格	人民币【】元，根据向询价对象询价结果确定
5	发行市盈率	【】倍（发行价格除以按【】年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）
6	发行市净率	【】倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）
7	发行前每股净资产	3.34元（按合并口径截至2014年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
8	发行后每股净资产	【】元（按合并口径截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
9	发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式
10	发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11	承销方式	余额包销
12	预计募集资金总额	【】万元
13	预计募集资金净额	【】万元
14	上市地点	深圳证券交易所

二、发行费用

项目	费用
承销费用	【】万元
保荐费用	【】万元
审计、验资费用	【】万元
律师费用	【】万元
发行手续费	【】万元

三、本次发行新股的有关当事人

1	发行人：气派科技股份有限公司 住所：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道 165 号恒顺厂区 1 栋 1 楼 105、2-5 楼 法定代表人：梁大钟

	联系人：文正国 电话：0755-89386868-8501 传真：0755-89386103
2	保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路 1102 号国信证券大厦 16-26 楼 法定代表人：何如 保荐代表人：程久君、杜跃春 项目协办人：李钦军 项目组成员：张文、洪甜恬、侯立潇 电话：0755-82134633 传真：0755-82131766
3	发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所 住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 楼 负责人：赵洋 经办律师：支毅、敖华芳、王永强 电话：0755-23982200 传真：0755-23982211
4	审计、验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 负责人：陈永宏 经办注册会计师：屈先富、韩雁光、刘光荣 电话：0755-61330271 传真：0755-61330278
5	评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 法人代表：郑文洋 经办注册评估师：邓春辉、段振强 电话：010-88018731 传真：010-88019300
6	股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼 法定代表人：戴文华 电话：0755-25938000

	传真：0755-25988122
7	申请上市证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 法定代表人：宋丽萍 电话：0755-88668888 传真：0755-82083104
8	保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 户名：国信证券股份有限公司 账号：4000029129200042215

四、发行人与本次发行相关当事人之间的关系

发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、与本次发行上市有关的重要日期

序号	事项	时间
1	刊登发行公告的日期	【】年【】月【】日
2	开始询价推介的日期	【】年【】月【】日
3	刊登定价公告的时间	【】年【】月【】日
4	申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
5	股票上市日期	【】年【】月【】日

第四节 风险因素

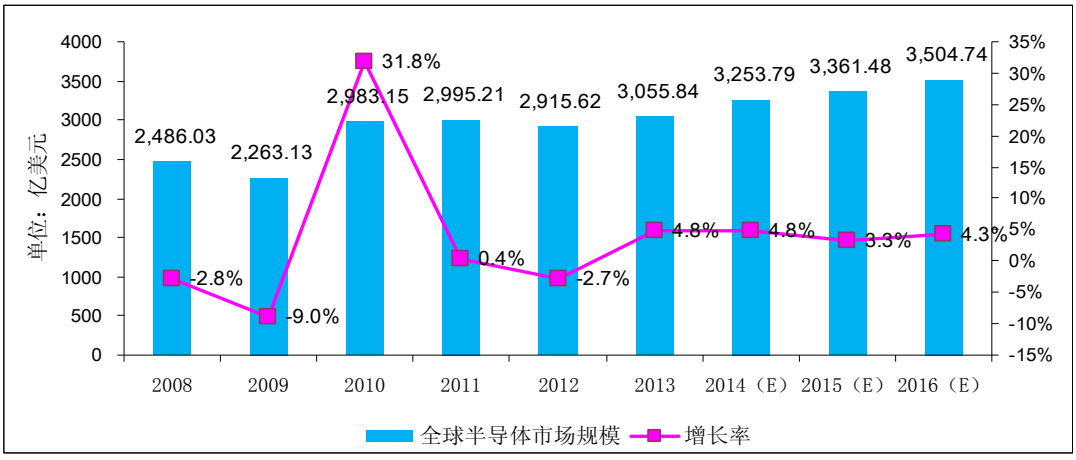
投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。

一、经营风险

（一）行业大幅波动风险

公司属于集成电路封装测试行业，半导体行业的发展状况影响公司的生产经营状况。

图：2008-2016 年全球半导体销售情况及预测



资料来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）

尽管随着全球集成电路市场规模的不断扩大，行业呈现出整体温和增长、受宏观经济影响小幅波动的特征，周期性越来越弱。但是，如果全球半导体市场短期内出现较大幅度下滑，可能对公司经营业绩造成重大不利影响。

（二）市场竞争加剧风险

公司所处集成电路封装行业的技术竞争较为激烈，部分内资企业通过上市募集资金增加生产线或进行技术升级或改造，产品质量、产能和技术水平得到较大提升，在一定程度上对公司市场竞争优势构成不利影响。同时，外资或合资封装测试公司对中国市场的加速开拓也可能对公司的经营带来不利影响。公司部分产品面临国内、国际同行企业的激烈竞争。如果在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

（三）行业技术更新替代风险

公司主要从事集成电路封装测试业务，属于集成电路封装行业。该行业技术更新较快，如果公司不能掌握新的封装技术，或者公司的生产经营技术和设备无法适应，未能开发出满足客户需要的新产品，将无法进一步开拓市场，这将对公司的经营造成重大不利影响。

（四）劳动力成本上升及用工短缺的风险

公司所属封装测试行业，人工成本占生产成本比重较高。随着公司的发展，公司的生产规模不断扩大，用工人数持续增加。如未来国内劳动力成本不断上升或出现用工短缺等情形，公司可能面临劳动力成本上升的风险，这将对公司的生产经营造成不利影响。

二、管理风险

（一）实际控制人风险

梁大钟、白瑛夫妇为本公司的实际控制人，合计持有本公司84.86%的股份，本次发行完成后，梁大钟、白瑛仍将持有本公司63.65%的股份（假设公司公开发行新股2,434万股，且未进行老股转让）。股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，未来梁大钟、白瑛可能利用其实际控制人地位，在股东大会上行使表决权，对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，作出有利于实际控制人但却可能损害公司利益或对公司发展不利的决策。

（二）生产效率下降风险

集成电路封装测试行业的生产模式最主要的特征是订单数量和订单品种多，如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出各类量小而品种繁杂的产品，并能满足客户快速交货的需求是企业核心竞争力的重要体现。

公司通过长期的实践积累，虽然已具备符合公司现有生产系统的管理技术和能力，能够满足客户纷繁多样的需求，并作出及时、快速响应，但随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日趋复杂，如果公司未来不能在管理方式上及时创新，以适应公司规模快速扩张的需要，或者在厂房设备搬迁时无法进行有效协调，可能导致交货期延长、竞争力削弱、客户流失等风险。

三、募集资金投资项目的风险

（一）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、试生产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。

（二）扩充的产能不能及时消化的风险

本次募集资金投资项目建成投产后将新增年23.35亿只的封测能力，募投项目的实施将使公司目前的产能有较大幅度的增加。虽然募投项目产品的市场需求较大且迅速增长，为本次募集资金投资项目的成功实施提供了有力的保障。但是，如果市场需求增速低于预期或公司市场开拓不力，募集资金投资项目将带来产能不能及时消化的风险。

四、业绩下滑的风险

当宏观经济或集成电路行业景气度下降、原材料价格上涨、租赁厂房搬迁、税收政策变化等风险因素发生时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司将有可能出现经营业绩下滑甚至超过50%及以上的风险。

五、所得税优惠风险

（一）所得税优惠补缴风险

公司是深圳市龙岗区注册成立的生产性企业，根据全国人民代表大会常务委员会于1980年8月26日颁发的《广东省经济特区条例》第14条规定：“特区企业所得税税率为15%”。深圳市政府于1993年1月21日颁布的《关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》第2条规定：“设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，按照深圳经济特区的规定，一律按15%的税率征收企业所得税，免征地方所得税和地方附加”。

公司于2008年4月1日取得深圳市龙岗区国家税务局平湖税务分局下发的“深

国税龙平减免[2008]0009号”《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》：根据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定同意本公司从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税。第3年至第5年减半征收所得税。

公司2011年10月被“深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局”评为“高新技术企业”。依据《中华人民共和国企业所得税法》享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）：自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行。

综上，公司选择2008年、2009年免征企业所得税，2010年-2012年减半征收企业所得税的优惠政策，2010年税率为11%，2011年税率为12%，2012年税率为12.5%，2013年开始按高新技术企业15%的税率缴纳企业所得税。

公司在2008-2012年享受的上述“两免三减半”和“企业所得税优惠过渡政策”的税收优惠系深圳市人民政府的规定，该等规定在深圳普遍适用，但其并无国家法律上的依据，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。针对可能被追缴所享受企业所得税优惠的风险，本公司控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛承诺：若公司因享受深圳市地方政府规定的企业所得税优惠政策而被国家税务主管机关要求补缴相关企业所得税差额的，本人将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受经济损失。如本人违反上述承诺导致公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

（二）所得税优惠税率变化的风险

报告期内，公司作为高新技术企业享受了企业所得税优惠，如果以后国家高新技术企业优惠政策发生变化，或者公司无法达到高新技术企业标准，将会对本公司的净利润产生一定的影响。

第五节 公司基本情况

一、公司基本资料

中文名称：	气派科技股份有限公司
英文名称：	China Chippacking Technology Co.,Ltd.
注册资本：	7,300.00 万元
法定代表人：	梁大钟
有限公司成立日期：	2006 年 11 月 7 日
股份公司成立日期：	2013 年 6 月 6 日
住所：	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道 165 号恒顺厂区 1 栋 1 楼 105、2-5 楼
邮政编码：	518111
电话号码：	0755-89386868-8501
传真号码：	0755-89386103
互联网网址：	http://www.szscpc.com
电子信箱：	wenzg@szscpc.com
负责信息披露和投资者关系的部门：	证券法律事务部
证券事务部负责人：	文正国
证券事务部电话：	0755-89386868-8501

二、公司的历史沿革及改制重组情况

（一）公司设立方式

2013年5月17日，气派有限股东会审议通过了将公司整体变更为股份有限公司的议案，根据股东会决议及《发起人协议》，气派有限以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职深ZH[2013]457号）截至2013年3月31日的净资产147,196,931.33元为基准，按1:0.4484的比例折股为股本6,600万股，整体变更为股份公司。全体股东作为股份公司的发起人，以其持有的有限公司股权所对应的经审计净资产份额折合为股份公司的发起人股份。股份公司依法继承有限公司的全部资产、业务、债权、债务，并将有限公司相关资产的权属变更登记至股份公司名下。2013年6月3日，全体股东签署了修改后的《公司章程》。

2013年5月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职深ZH[2013]464号），经审验，气派科技股份有限公司收到发起人股东投入的注册资本合计人民币6,600万元，资本公积为人民币81,196,931.33元。

2013年6月6日，股份公司在深圳市市场监督管理局办理了变更设立登记，注

册登记号为440307103987683。

（二）发起人

公司整体变更设立时，15名发起人持股情况如下：

股东名称	持股数（万股）	股权比例（%）
梁大钟	5,100.00	77.27
白瑛	1,080.00	16.37
施保球	200.00	3.03
林忠	35.00	0.53
饶锡林	28.00	0.42
文正国	28.00	0.42
林治广	24.00	0.36
谭云烽	23.00	0.35
周幸福	15.00	0.23
刘兴波	15.00	0.23
周佩军	13.00	0.20
高宏德	12.00	0.18
李庆丹	10.00	0.15
赵红	9.00	0.14
梁晓英	8.00	0.12
合计	**6,600.00**	**100.00**

（三）公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时拥有的全部资产为深圳市气派科技有限公司的全部资产，主要是集成电路封装、测试和相关服务业的经营性资产。公司设立时实际从事的主要业务为集成电路封装、测试和相关服务业。

（四）公司成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司成立前，主要发起人梁大钟先生拥有的主要经营性资产是持有气派有限的股权，主要从事气派有限的管理业务。

公司成立后，主要发起人梁大钟先生拥有的主要经营性资产是持有本公司的股权，主要从事公司的管理业务。

（五）公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系

公司自设立以来，主要发起人梁大钟、白瑛夫妇在公司从事高层管理工作，其中，梁大钟先生担任公司董事长兼总经理，白瑛女士担任公司董事。除此之外，本公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关系。

（六）公司成立前后的业务流程

公司是由深圳市气派科技有限公司整体变更设立，改制前后业务流程没有发生变化，请详见本招股说明书“第六节 业务和技术”相关内容。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由气派有限整体变更设立，气派有限的资产、业务和债权、债务全部由公司承继。公司在整体变更设立后，已完成全部资产相关产权的变更手续。

（八）公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东、实际控制人梁大钟、白瑛夫妇及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立

公司及其前身气派有限自设立以来，一直独立运作集成电路封装、测试和相关服务业。

公司与控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛不存在同业竞争的情况，亦不存在显失公平的关联交易，公司产品的销售不依赖于控股股东及实际控制人。

2、资产独立完整

本公司系由气派有限整体变更，承继了气派有限的全部资产。公司合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，公司资产完整。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行，不存在有关法律、法规禁止的任职、兼职情况。董事、监事（公司职工代表出任的监事除外）由股东大会选举产生，总经理由董事会聘任，副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名

并经董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。本公司不存在股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免的决定。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会、管理层等决策、监督和经营管理机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责，建立了有效的法人治理结构。公司建立了一套完整的、适应公司发展需要的组织机构，并独立行使经营管理职权，与其他企业间没有机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，没有与其他单位共用银行账户；公司独立进行纳税申报和履行缴纳义务，独立对外签订合同。截至本招股说明书签署日，公司的货币资金和其他资产没有以任何形式被股东、实际控制人及其控制的其他企业非经营性占用；公司没有为股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，或转借授信额度。

综上所述，公司在业务、资产、人员、机构和财务方面均独立于控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛，公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

三、公司股本结构的形成及变化情况

（一）股本形成及变化概览

本公司是由气派有限整体变设立，股本形成及变化的简要情况如下图所示：

深圳市气派科技有限公司成立
1、2006年11月——注册资本1000万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
2、2009年4月——注册资本1600万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
3、2009年5月——注册资本2100万元
梁大钟：64.76%
天光集成：23.81%
白瑛：11.43%
4、2009年7月——注册资本2500万元
梁大钟：68%
天光集成：20%
白瑛：12%
5、2009年8月——注册资本2800万元
梁大钟：69.82%
天光集成：17.86%
白瑛：12.32%
6、2009年11月——注册资本3000万元
梁大钟：70.83%
天光集成：16.67%
白瑛：12.5%
7、2009年12月——注册资本3000万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
8、2009年12月——注册资本3200万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
9、2010年1月——注册资本3400万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
10、2010年4月——注册资本3600万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
11、2010年5月——注册资本3850万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
12、2010年6月——注册资本4000万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
13、2010年7月——注册资本4150万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
14、2010年8月——注册资本4400万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
15、2010年9月——注册资本5100万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
16、2010年12月——注册资本6000万元
梁大钟：85%
白瑛：15%
17、2012年12月——注册资本6600万元
梁大钟：77.27%%
白瑛：16.37%
施保球等13名自然人：6.36%
气派科技股份有限公司成立
18、2013年6月——改制设立股份公司
梁大钟：77.27%%
白瑛：16.37%
施保球等13名自然人：6.36%
19、2013年11月——注册资本6620万元
梁大钟：77.04%
白瑛：16.31%
施保球等14名自然人：6.65%
20、2013年12月——注册资本7300万元
梁大钟：69.86%
白瑛：14.79%
中和春生等4名机构：9.32%
施保球等14人：6.03%
21、2014年10月——注册资本7300万元
梁大钟：70.07%
白瑛：14.79%
中和春生等4名机构：9.32%
施保球等13人：5.82%

（二）股本形成及变化情况

1、2006年11月，气派有限成立，注册资本1,000万元

气派有限由梁大钟、白瑛夫妇设立，于2006年11月7日取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：4403071247106），企业名称为“深圳市气派科技有限公司”，注册资本1,000万元。

2006年10月31日，梁大钟先生、白瑛女士签署《深圳市气派科技有限公司章程》。

2006年10月31日，深圳国安会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深国安内验报字[2006]第083号），验证截至2006年10月31日，气派有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,000万元，均以货币出资，其中梁大钟先生出资850万元、白瑛女士出资150万元。

2006年11月7日，气派有限取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，成立时的基本情况如下：

公司名称	深圳市气派科技有限公司
住所	深圳市龙岗区平湖街道平新大道恒顺工业区一栋二至三楼、一楼第五间
法定代表人	梁大钟
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	集成电路的测试封装、设计、销售（不含蚀刻等有工业废水产生的工艺及其他限制项目），货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
成立日期	2006 年 11 月 7 日
经营期限	自 2006 年 11 月 7 日起至 2016 年 11 月 7 日止
登记机关	深圳市工商行政管理局
营业执照注册号	4403071247106

气派有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	850.00	85.00%
2	白瑛	150.00	15.00%
合计		**1,000.00**	**100%**

2、2009年4月，增资至1,600万元

2009年4月20日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本增加至1,600万元，其中梁大钟先生增资510万元、白瑛女士增资90万元，按

照1元/注册资本的价格进行增资。同日，气派有限全体股东签署修改后的《公司章程》。

2009年4月21日，深圳市中洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深中洲[2009]验字第011号），验证截至2009年4月21日，气派有限已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计600万元，其中梁大钟先生增资510万元、白瑛女士增资90万元。

2009年4月30日，深圳市工商行政管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》（注册号：440307103987683），本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	1,360.00	85.00%
2	白瑛	240.00	15.00%
合计		**1,600.00**	**100%**

3、2009年5月，增资至2,100万元

2009年5月4日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意由天光集成作为新股东对气派有限增资500万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2009年5月7日，深圳市中洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深中洲[2009]验字第015号），验证截至2009年5月6日，气派有限已收到天光集成以货币方式缴纳的新增注册资本500万元。

2009年5月18日，深圳市工商行政管理局核准气派有限股东、注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	1,360.00	64.76%
2	天光集成	500.00	23.81%
3	白瑛	240.00	11.43%
合计		**2,100.00**	**100%**

4、2009年7月，增资至2,500万元

2009年6月30日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本增加至2,500万元，其中梁大钟先生增资340万元，白瑛女士增资60万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2009年7月2日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2009]060号），验证截至2009年7月1日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计400万元，其中梁大钟先生增资340万元、白瑛女士增资60万元。

2009年7月10日，深圳市工商行政管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	1,700.00	68.00%
2	天光集成	500.00	20.00%
3	白瑛	300.00	12.00%
合计		**2,500.00**	**100%**

5、2009年8月，增资至2,800万元

2009年8月4日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本增加至2,800万元，其中梁大钟先生增资255万元，白瑛女士增资45万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2009年8月6日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2009]073号），验证截至2009年8月4日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计300万元，其中梁大钟先生增资255万元、白瑛女士增资45万元。

2009年8月14日，深圳市工商行政管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	1,955.00	69.82%
2	天光集成	500.00	17.86%
3	白瑛	345.00	12.32%
合计		**2,800.00**	**100%**

6、2009年11月，增资至3,000万元

2009年11月3日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本增加至3,000万元，其中梁大钟先生增资170万元，白瑛女士增资30万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2009年11月5日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2009]100号），验证截至2009年11月5日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计200万元，其中梁大钟先生增资170万元、白瑛女士增资30

万元。

2009年11月12日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	2,125.00	70.83%
2	天光集成	500.00	16.67%
3	白瑛	375.00	12.50%
合计		**3,000.00**	**100%**

7、2009年12月，股权转让

2009年11月18日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意股东天光集成将其所占公司14.17%的股权以人民币425万元价格转让给梁大钟，天光集成将其所占公司2.5%的股权以人民币75万元价格转让给白瑛。2009年11月24日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2009年11月24日，天光集成与梁大钟先生、白瑛女士签订《股权转让协议》，约定天光集成将所持气派有限16.67%的股权分别转让给梁大钟先生、白瑛女士，其中，14.17%的股份以425万元转让给梁大钟先生，2.50%的股份以75万元转让给白瑛女士。同日，深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司出具《股权转让见证书》（深高交所见（2009）字第10342号），对前述股权转让行为进行了见证。

2009年12月7日，深圳市市场监督管理局核准气派有限股东变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	2,550.00	85.00%
2	白瑛	450.00	15.00%
合计		**3,000.00**	**100%**

8、2009年12月，增资至3,200万元

2009年12月17日，气派科技股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本增加至3,200万元，其中梁大钟先生增资170万元，白瑛女士增资30万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2009年12月21日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2009]120号），验证截至2009年12月21日，气派有限已收到股东以货币方式缴

纳的新增注册资本合计200万元，其中梁大钟先生增资170万元、白瑛女士增资30万元。

2009年12月24日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	2,720.00	85.00%
2	白瑛	480.00	15.00%
合计		**3,200.00**	**100%**

9、2010年1月，增资至3,400万元

2010年1月20日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由3,200万元增加至3,400万元，其中梁大钟先生增资170万元，白瑛女士增资30万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年1月21日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]006号），验证截至2010年1月21日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计200万元，其中梁大钟先生增资170万元、白瑛女士增资30万元。

2010年1月29日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	2,890.00	85.00%
2	白瑛	510.00	15.00%
合计		**3,400.00**	**100%**

10、2010年4月，增资至3,600万元

2010年3月30日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由3,400万元增加至3,600万元，其中梁大钟先生增资170万元，白瑛女士增资30万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年3月31日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]026号），验证截至2010年3月30日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计200万元，其中梁大钟先生增资170万元、白瑛女士增资30

万元。

2010年4月7日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	3,060.00	85.00%
2	白瑛	540.00	15.00%
合计		**3,600.00**	**100%**

11、2010年5月，增资至3,850万元

2010年5月13日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由3,600万元增加至3,850万元，其中梁大钟先生增资212.5万元，白瑛女士增资37.5万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年5月14日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]042号），验证截至2010年5月14日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计250万元，其中梁大钟先生增资212.5万元、白瑛女士增资37.5万元。

2010年5月20日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更予并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	3,272.50	85.00%
2	白瑛	577.50	15.00%
合计		**3,850.00**	**100%**

12、2010年6月，增资至4,000万元

2010年6月7日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由3,850万元增加至4,000万元，其中梁大钟先生增资127.5万元，白瑛女士增资22.5万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年6月7日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]050号），验证截至2010年6月7日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计150万元，其中梁大钟先生增资127.5万元、白瑛女士增资22.5

万元。

2010年6月12日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	3,400.00	85.00%
2	白瑛	600.00	15.00%
合计		**4,000.00**	**100%**

13、2010年7月，增资至4,150万元

2010年7月5日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由4,000万元增加至4,150万元，其中梁大钟先生增资127.5万元，白瑛女士增资22.5万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年7月6日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]058号），验证截至2010年7月6日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计150万元，其中梁大钟先生增资127.5万元、白瑛女士增资22.5万元。

2010年7月12日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	3,527.50	85.00%
2	白瑛	622.50	15.00%
合计		**4,150.00**	**100%**

14、2010年8月，增资至4,400万元

2010年8月9日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由4,150万元增加至4,400万元，其中梁大钟先生增资212.5万元，白瑛女士增资37.5万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年8月10日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]065号），验证截至2010年8月10日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计250万元，其中梁大钟先生增资212.5万元、白瑛女士增资37.5万元。

2010年8月17日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	3,740.00	85.00%
2	白瑛	660.00	15.00%
合计		**4,400.00**	**100%**

15、2010年9月，增资至5,100万元

2010年9月8日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由4,400万元增加至5,100万元，其中梁大钟先生增资595万元，白瑛女士增资105万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年9月9日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]075号），验证截至2010年9月9日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计700万元，其中梁大钟先生增资595万元、白瑛女士增资105万元。

2010年9月19日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	4,335.00	85.00%
2	白瑛	765.00	15.00%
合计		**5,100.00**	**100%**

16、2010年12月，增资至6,000万元

2010年12月6日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由5,100万元增加至6,000万元，其中梁大钟先生增资765万元，白瑛女士增资135万元，按照1元/注册资本的价格进行增资。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2010年12月8日，深圳泓兴会计师事务所出具《验资报告》（深泓兴验字[2010]085号），验证截至2010年12月7日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计900万元，其中梁大钟先生增资765万元、白瑛女士增资135万元。

2010年12月8日，深圳市市场监督管理局核准气派科技注册资本变更并换发

《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	5,100.00	85.00%
2	白瑛	900.00	15.00%
合计		**6,000.00**	**100%**

17、2012年12月，增资至6,600万元

2012年12月10日，气派有限股东会召开会议并作出决议，同意气派有限注册资本由6,000万元增加至6,600万元，增加注册资本由公司原股东之一白瑛女士和新增股东施保球先生等共计14名自然人以货币方式认缴，公司原股东梁大钟先生同意放弃优先同比例认缴新增注册资本的权利。公司本次新增注册资本的认缴价格以2012年11月30日公司账面净资产为定价依据，即每一元新增注册资本的认缴价格为1.96元，白瑛女士等14名自然人合计应向公司缴纳认购款人民币1,176万元，其中，人民币600万元作为公司新增注册资本，其余576万元计入公司的资本公积，各股东认缴新增注册资本的具体情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	认购金额（万元）
1	白瑛	货币	180.00	352.80
2	施保球	货币	200.00	392.00
3	林忠	货币	35.00	68.60
4	饶锡林	货币	28.00	54.88
5	文正国	货币	28.00	54.88
6	林治广	货币	24.00	47.04
7	谭云烽	货币	23.00	45.08
8	周幸福	货币	15.00	29.40
9	刘兴波	货币	15.00	29.40
10	周佩军	货币	13.00	25.48
11	高宏德	货币	12.00	23.52
12	李庆丹	货币	10.00	19.60
13	赵红	货币	9.00	17.64
14	梁晓英	货币	8.00	15.68
合计		-	**600.00**	**1176.00**

2012年12月11日，公司和控股股东梁大钟分别与白瑛、施保球、林忠、饶锡林、文正国、林治广、谭云烽、刘兴波、周幸福、周佩军、高宏德、李庆丹、赵红、梁晓英等十四人签订《增资协议》。《增资协议》中约定：（1）增资方在增资成为公司股东之日起，在公司服务的时间不少于五年且应在公司上市后服务不少于二年（若五年服务时间届满公司尚未上市，且公司尚在开展上市工作，则服务时间顺延，总服务时间不得少于七年）；（2）如果公司自增资方成为股东

之日起满五年时未上市，则在增资方没有违约的前提下：①如此时上市工作未终止且控股股东也未声明放弃上市，则增资方有权选择是否继续持有公司股权；若选择退出的，则应在该五年届满之日起三十日内与控股股东签订股权转让协议，将持有的公司全部股权转让给控股股东；②若此时上市工作已终止且控股股东也声明放弃上市，则增资方应在该五年届满之日起三十日内与控股股东签订股权转让协议，将持有的公司全部股权全部转让给控股股东；（3）若公司自增资方成为公司股东之日起满七年未实现上市，则控股股东有权要求增资方在该七年届满之日起三十日内与控股股东签订股权转让协议，将持有的公司股权全部转让给控股股东；（4）自公司上市之日起一年内，增资方不得对外转让其在公司上市前取得的公司股份；在前述法定锁定期满后二年内，增资方每年对外转让所持公司股份（指增资方在公司上市前取得的公司股份）的比例不得超过其在转让时持有公司股份总数的25%，如增资方持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。

2012年12月12日，公司法定代表人签署《章程修正案》。

2012年12月13日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职深QJ[2012]T112号），验证截至2012年12月12日，气派有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计600万元。

2012年12月14日，深圳市市场监督管理局核准气派有限注册资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	5,100.00	77.27%
2	白瑛	1,080.00	16.37%
3	施保球	200.00	3.03%
4	林忠	35.00	0.53%
5	饶锡林	28.00	0.42%
6	文正国	28.00	0.42%
7	林治广	24.00	0.36%
8	谭云烽	23.00	0.35%
9	刘兴波	15.00	0.23%
10	周幸福	15.00	0.23%
11	周佩军	13.00	0.20%
12	高宏德	12.00	0.18%
13	李庆丹	10.00	0.15%
14	赵红	9.00	0.14%
15	梁晓英	8.00	0.12%
合计		**6,600.00**	**100%**

18、2013年6月，整体变更为股份公司

2013年5月2日，梁大钟、白瑛、施保球等15名发起人共同签署了《发起人协议》，决定以2013年3月31日为改制审计基准日，依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职深ZH[2013]457号），以经审计的账面净资产147,196,931.33元为基础，按1:0.4484的比例折股，共折合为6,600万股，剩余部分计入股份公司资本公积，整体变更为气派科技股份有限公司。

2013年5月15日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2013]第0145号《深圳市气派科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告书》，对气派有限的全部资产和负债在2013年3月31日的市场价值进行了评估。经评估，净资产账面值14,719.69万元，评估值15,785.15万元，评估增值1,065.46万元，增值率7.24%。

2013年5月17日，气派有限股东会审议通过了将公司整体变更为股份有限公司的议案，根据股东会决议及《发起人协议》，气派有限以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（《天职深ZH[2013]457号》）截至2013年3月31日的净资产147,196,931.33元为基准，按1:0.4484的比例折股为股本6,600万股，整体变更为股份公司。全体股东作为股份公司的发起人，以其持有的有限公司股权所对应的经审计净资产份额折合为股份公司的发起人股份。股份公司依法继承有限公司的全部资产、业务、债权、债务，并将有限公司相关资产的权属变更登记至股份公司名下。

2013年5月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职深ZH[2013]464号），经审验，气派科技股份有限公司收到发起人股东投入的注册资本合计6,600万元，资本公积为81,196,931.33元。

2013年6月3日，气派科技股东大会召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，审议通过了气派有限整体变更设立为气派科技股份有限公司的议案。同日，全体股东签署了修改后的《公司章程》。

2013年6月6日，股份公司在深圳市市场监督管理局办理了变更设立登记，注册登记号为440307103987683。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	5,100.00	77.27%
2	白瑛	1,080.00	16.36%
3	施保球	200.00	3.03%
4	林忠	35.00	0.53%
5	饶锡林	28.00	0.42%
6	文正国	28.00	0.42%
7	林治广	24.00	0.36%
8	谭云烽	23.00	0.35%
9	刘兴波	15.00	0.23%
10	周幸福	15.00	0.23%
11	周佩军	13.00	0.20%
12	高宏德	12.00	0.18%
13	李庆丹	10.00	0.15%
14	赵红	9.00	0.14%
15	梁晓英	8.00	0.12%
合计		**6,600.00**	**100%**

19、2013年11月，增资至6,620万元

2013年11月11日，气派科技股东大会召开2013年第二次（临时）股东大会并作出决议，同意公司总股本由6,600万股增加至6,620万股，新增加的股本全部由刘明才以货币方式认购，新增股本的价格以2013年9月30日净资产为基础，确定为每股人民币4元，刘明才出资80万元认购股份20万股，其中，20万元计入注册资本，其余60万元计入资本公积。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2013年11月12日，公司和控股股东梁大钟与刘明才签订了《增资协议》，各方同意增资方按照人民币80万元的价格认购公司的新增注册资本20万元，其中，人民币20万元作为公司新增注册资本，其余人民币60万元计入公司的资本公积。《增资协议》中约定：（1）增资方承诺在增资方成为公司股东之日起，其在公司服务的时间将不少于五年且应在公司上市后服务不少于二年；（2）如果公司自增资方成为股东之日起满五年时未上市，则在增资方没有违约的前提下：①如此时上市工作未终止且控股股东也未声明放弃上市，则增资方有权选择是否继续持有公司股权；若选择退出的，则应在该五年届满之日起三十日内与控股股东签订股权转让协议，将持有的公司全部股权全部转让给控股股东；②若此时上市工作已终止且控股股东也声明放弃上市，则增资方应在该五年届满之日起三十日内与控股股东签订股权转让协议，将持有的公司全部股权全部转让给控股股东；（3）若公司自增资方成为股东之日起满七年未实现上市，则控股股东有权要求增资方在该七年届满之日起三十日内与控股股东签订股权转让协议，将持有的公司全部股权全部转让给控股股

东；（4）自公司上市之日起一年内，增资方不得对外转让其在公司上市前取得的公司股份；在前述法定锁定期满后二年内，增资方每年对外转让所持公司股份（指增资方在公司上市前取得的公司股份）的比例不得超过其在转让时持有公司股份总数的25%，如增资方持有公司股份总数不足1,000股时，可以一次性转让。

2013年11月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2013]1346号），验证截至2013年11月15日，气派科技已收到刘明才以货币方式缴纳的新增注册资本20万元。具体增资情况如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	认购金额（万元）
刘明才	货币	20.00	80.00

2013年11月18日，深圳市市场监督管理局核准气派科技股东、注册资本变更。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	5,100.00	77.04%
2	白瑛	1,080.00	16.31%
3	施保球	200.00	3.02%
4	林忠	35.00	0.53%
5	饶锡林	28.00	0.42%
6	文正国	28.00	0.42%
7	林治广	24.00	0.36%
8	谭云烽	23.00	0.35%
9	刘明才	20.00	0.30%
10	刘兴波	15.00	0.23%
11	周幸福	15.00	0.23%
12	周佩军	13.00	0.20%
13	高宏德	12.00	0.18%
14	李庆丹	10.00	0.15%
15	赵红	9.00	0.14%
16	梁晓英	8.00	0.12%
合计		**6,620.00**	**100%**

20、2013年12月，增资至7,300万元

2013年12月13日，气派科技股东大会召开2013年第三次（临时）股东大会并作出决议，同意由深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资320万元，深圳市创新投资集团有限公司增资130万元，东莞红土创业投资有限公司增资130万元，深圳市红土信息创业投资有限公司增资100万元，按照7.95元/股的价格进行增资。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2013年12月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

（天职业字[2013]1864号），验证截至2013年12月23日，气派科技已收到深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本320万元，深圳市创新投资集团有限公司缴纳的新增注册资本130万元，东莞红土创业投资有限公司缴纳的新增注册资本130万元，深圳市红土信息创业投资有限公司缴纳的新增注册资本100万元。具体增资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	认购金额（万元）	计入资本公积（万元）
1	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	320.00	2,544.00	2,224.00
2	深圳市创新投资集团有限公司	130.00	1,033.50	903.50
3	东莞红土创业投资有限公司	130.00	1,033.50	903.50
4	深圳市红土信息创业投资有限公司	100.00	795.00	695.00
合计		**680.00**	**5,406.00**	**4,726.00**

2013年12月24日，深圳市市场监督管理局核准气派科技股东、注册资本变更。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	5,100.00	69.86%
2	白瑛	1,080.00	14.79%
3	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	320.00	4.38%
4	施保球	200.00	2.74%
5	深圳市创新投资集团有限公司	130.00	1.78%
6	东莞红土创业投资有限公司	130.00	1.78%
7	深圳市红土信息创业投资有限公司	100.00	1.37%
8	林忠	35.00	0.48%
9	饶锡林	28.00	0.38%
10	文正国	28.00	0.38%
11	林治广	24.00	0.33%
12	谭云烽	23.00	0.32%
13	刘明才	20.00	0.27%
14	刘兴波	15.00	0.21%
15	周幸福	15.00	0.21%
16	周佩军	13.00	0.18%
17	高宏德	12.00	0.16%
18	李庆丹	10.00	0.14%
19	赵红	9.00	0.12%
20	梁晓英	8.00	0.11%
合计		**7,300.00**	**100%**

21、2014年10月，股权转让

2014年9月，公司股东周幸福因个人原因提出辞职，9月25日，周幸福与控股

股东梁大钟签订《股权转让协议》，约定将其持有的公司0.2055%的股权（15万股股份）及其派生权益以人民币28.2万元（增资款29.4万元－2013年度现金分红实收1.2万元）的价格转让给梁大钟。

2014年10月10日，气派科技股东大会召开2014年第五次（临时）股东大会并作出决议，同意鉴于公司股东周幸福先生将所持有的15万股股份转让给梁大钟先生的事宜，对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。同日，全体股东签署修改后的《公司章程》。

2014年10月22日，公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程》的变更备案手续。本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁大钟	5,115.00	70.07%
2	白瑛	1,080.00	14.79%
3	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	320.00	4.38%
4	施保球	200.00	2.74%
5	深圳市创新投资集团有限公司	130.00	1.78%
6	东莞红土创业投资有限公司	130.00	1.78%
7	深圳市红土信息创业投资有限公司	100.00	1.37%
8	林忠	35.00	0.48%
9	饶锡林	28.00	0.38%
10	文正国	28.00	0.38%
11	林治广	24.00	0.33%
12	谭云烽	23.00	0.32%
13	刘明才	20.00	0.27%
14	刘兴波	15.00	0.21%
15	周佩军	13.00	0.18%
16	高宏德	12.00	0.16%
17	李庆丹	10.00	0.14%
18	赵红	9.00	0.12%
19	梁晓英	8.00	0.11%
合计		**7,300.00**	**100%**

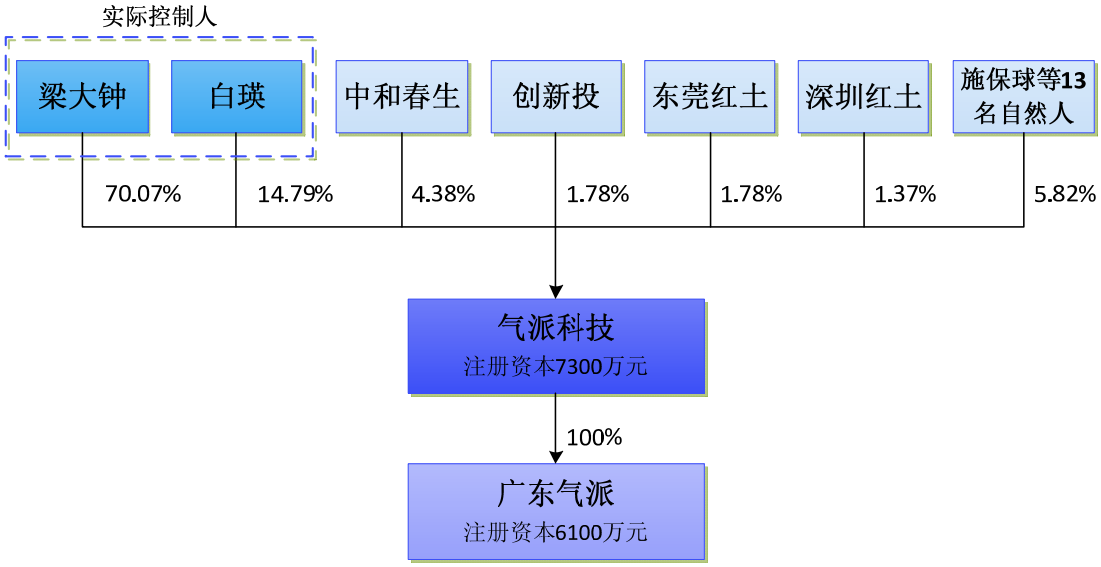
四、重大资产重组情况

公司自设立以来，未进行过重大资产重组。

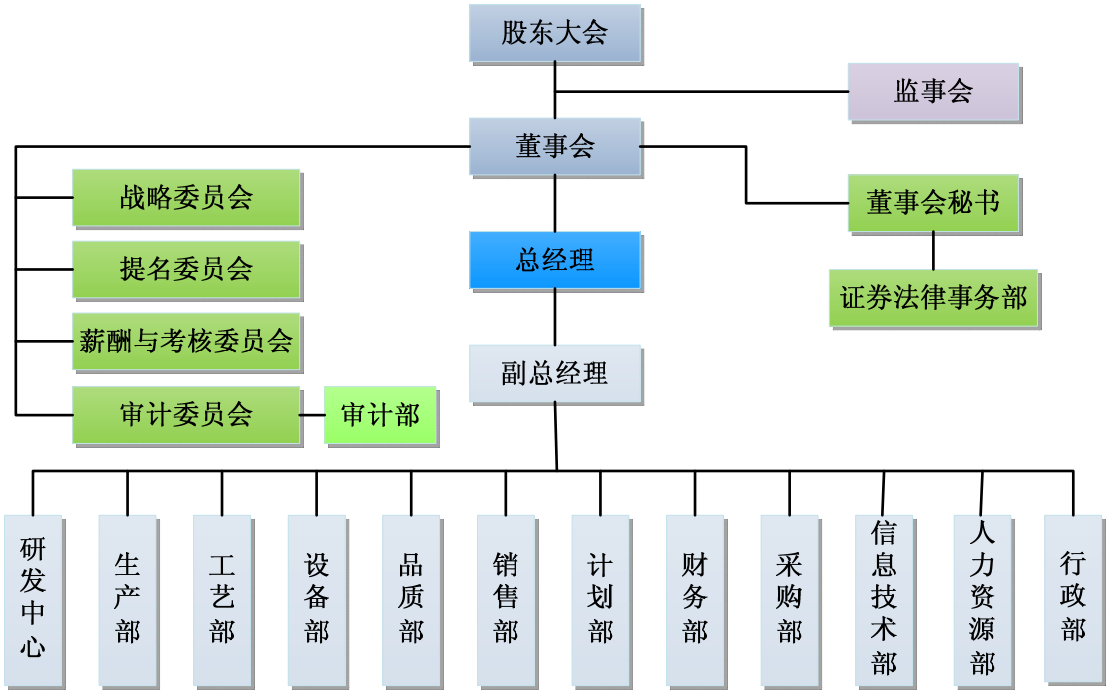
五、公司股东机构和组织结构

（一）公司组织结构图

1、截至招股说明书签署日，公司的股权架构图如下：



2、截至招股说明书签署日，公司的组织架构图如下：



（二）公司法人治理结构

股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。监事会是公司的监督机构。总经理负责公司的日常经营活动，执行

公司董事会决议。

（三）公司内部职能管理部门

股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，其中，审计委员会下设审计部，董事会秘书负责董事会的日常事务，同时管理证券法律事务部。监事会是公司的监督机构。总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会决议。总经理下辖研发中心、生产部、工艺部、设备部、品质部、销售部、计划部、财务部、采购部、信息技术部、人力资源部、行政部。各个部门运行情况良好，其主要职能如下：

部门名称	部门职能
审计部	负责对公司经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；负责对公司贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；负责对公司的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；负责制订公司内部审计制度和操作规程，并监督执行。
证券法律事务部	负责公司日常法律事务和合同事务管理；负责公司上市相关工作；负责组织董事会、监事会、股东大会筹备、召开工作；负责组织编制定期报告、临时报告及信息披露工作；负责对外项目投资者管理；负责与监管机构沟通、联系，负责投资者关系管理工作；负责信息保密及登记工作；负责公司内控制度的制定及管控。
研发中心	根据封装行业发展趋势、公司产品路线的战略规划，并结合市场调研的结果和客户要求制订产品开发方向，确定研发产品的种类，并制定研发产品的相关标准及研发工作计划；对可行性进行论证并组织实施；新材料新工艺的工程试样，按照 PCRB 授权开展相关导入工作；进行特殊采购的工程验证；持续改善产品品质、工艺控制和成本控制等；组织相关资源，完成新产品的导入；对重要客户及重要产品试产合格后，组织工程部，品质部，生产部等相关部门做好大批量生产的准备工作。
生产部	负责根据计划部投产计划，制订生产作业计划，合理进行生产调度，确保产品的生产周期，完成计划部下达的交期达成率和订单按时结批；不断提高生产效率，控制生产制造成本；抓好员工对各种规范的执行，对产品质量负责；做好产线员工安全和职业健康教育培训。
工艺部	负责稳定并提升生产工艺水平，推动产品质量和成本的持续改善，实现设备、材料和生产流程的不断优化；确保新产品快速平稳地实现大规模批量化生产，并以零缺陷为目标，推动良率不断提升；对新材料新工艺进行评估，不断满足产品对质量和成本的要求；对生产和技术人员提供培训，持续提升产线作业能力和工艺水平。
设备部	维持生产部门设备的正常运转；审核新设备的技术要求，进行相应评估；审核并执行设备相关维护计划，对设备维修进行监管；分析及改善设备备件的耗用。
品质部	负责质量监控及质量保证；维护和完善 ISO9001 和 ISO14001 管理体系的运行；负责客户投诉及内部质量异常的处理；负责原材料检验控制以及供应商审核；汇总、整理、分析日常质量报表；管控质量成本；宣传

	并提高员工质量观念。
销售部	负责制订公司年度、季度、月度销售目标，制订企业市场营销计划，并落实执行；积极开展市场调查、分析和预测，努力拓宽业务渠道，开发新客户，维持老客户，不断扩大公司封测业务的市场占有率；经常走访客户，主动配合品质部及时处理好客户投诉，提高客户满意度，提高企业信誉和竞争力；做好客户封装协议的签订，了解客户的信誉度，严格按协议付款期回收账款，防范企业经营风险。
计划部	根据销售计划制订公司年度、季度、月度生产计划和物料采购计划，每周定期召开投产计划会议，协调销售需求生产资源匹配，做好每天投料计划，并督促生产部管控好生产周期、交期达成率、客户急货、重点客户重点产品的交期、订单按时结批等工作；督促采购计划的达成和库存物料的管控，配合采购部做好库存呆滞物料的代用处理；根据销售订单做好产能评估，并向生产、设备部提出产能扩充的需求。
财务部	负责制定财会制度和相应的实施细则；参与制定公司经营计划，指导监控财务计划实施，编制财务报表；管理现金流量、营运资本、资本预算、企业融资、资本变动等。
采购部	根据生产计划，制定物资供应计划并组织采购公司所需物资，保证生产经营活动持续进行；负责选择、评审、管理供应商；负责开发新产品新材料供应商；负责对供应商的退换货及呆滞品的处理；持续推动公司采购物资的成本下降。
信息技术部	推动公司内部管理信息化，组织开发与实施或选择适合公司业务运作流程的信息化管理系统；负责公司内信息化相关硬件和软件的维护，组织维护信息化软、硬件的正常使用与升级等；优化配置公司信息资源，编制信息化管理相关规定。
人力资源部	根据公司发展战略，制定人力资源规划和拟定公司组织机构及其职能，主持确定各部门机构、编制、岗位、人员及其职责，建立公司绩效考核体系，并组织实施、建立公司合理的薪酬体系、编制公司年度、月度培训计划，并督导实施、制定公司人力资源招聘计划，并组织实施、建立内外部沟通渠道和公共关系，协调处理劳动争议，建立和谐的劳资关系、主持人力资源的录用、任免、调动、晋升、辞退，做好内部员工职业生涯规划，负责公司社会保险的规范管理、负责公司劳动合同的规范管理，建立健全公司各项人力资源管理制度，并推动执行。
行政部	负责公司通用规定的编制；管理公司总务、保洁及保安工作；监督执行公司规章制度，处理员工奖惩事宜；管理公司车辆；组织接待、活动、表彰等事宜。

六、公司控股子公司的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司仅有一家全资子公司广东气派科技有限公司。

（一）广东气派基本情况

成立日期	2013.5.22
法定代表人	梁大钟
注册资本	6,100 万元
实收资本	6,100 万元
住所	东莞市石排镇福隆第二工业区二路
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：集成电路的研发、测试封装、设计、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）广东气派最近一年及一期经营情况

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2013年/2013年12月31日	5,133.21	4,937.40	-62.60
2014年1-6月/2014年6月30日	5,604.78	4,857.75	-79.65

注：2013 年和 2014 年 1-6 月数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的主要股东为梁大钟、白瑛。公司控股股东为梁大钟先生，其直接持有公司5,115万股股份，占本次发行前公司总股本的70.07%。公司实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇，白瑛女士直接持有公司股份1,080万股，占本次发行前公司总股本的14.79%，梁大钟、白瑛合计持有公司股份6,195万股，合计持股占发行前公司总股本的84.86%。

截至本招股说明书签署日，梁大钟、白瑛持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情形。

（一）实际控制人的基本情况

1、梁大钟

男，出生于1959年2月，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33060219590205****，住所：深圳市福田区。

2、白瑛

女，出生于1964年5月，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33060219640529****，住所：深圳市福田区。

（二）实际控制人控制的其他企业的基本情况

实际控制人梁大钟、白瑛夫妇于2001年4月9日投资设立了深圳市天光集成电路有限公司，该公司于2012年12月12日注销。天光集成注销前的基本情况如下：

成立日期	2001.4.9
法定代表人	梁大钟
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
住所	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道 165 号恒顺厂区 1 栋 3 楼 301、303 房
经营范围	集成电路的设计及销售，货物及技术进出口
主营业务	封装产品的销售

天光集成注销当年经营情况如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2012年/2012年12月12日	346.75	346.75	-2.06

注：上述数据未经审计

八、公司股本情况

（一）公司本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本7,300万股，本次拟向社会公众发行2,434万股普通股，发行前后公司股本结构如下：

股东	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
梁大钟	5,115.00	70.07%	5,115.00	52.55%
白瑛	1,080.00	14.79%	1,080.00	11.10%
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	320.00	4.38%	320.00	3.29%
施保球	200.00	2.74%	200.00	2.05%
深圳市创新投资集团有限公司	130.00	1.78%	130.00	1.34%
东莞红土创业投资有限公司	130.00	1.78%	130.00	1.34%
深圳市红土信息创业投资有限公司	100.00	1.37%	100.00	1.03%
林忠	35.00	0.48%	35.00	0.36%
饶锡林	28.00	0.38%	28.00	0.29%

文正国	28.00	0.38%	28.00	0.29%
林治广	24.00	0.33%	24.00	0.25%
谭云烽	23.00	0.32%	23.00	0.24%
刘明才	20.00	0.27%	20.00	0.21%
刘兴波	15.00	0.21%	15.00	0.15%
周佩军	13.00	0.18%	13.00	0.13%
高宏德	12.00	0.16%	12.00	0.12%
李庆丹	10.00	0.14%	10.00	0.10%
赵红	9.00	0.12%	9.00	0.09%
梁晓英	8.00	0.11%	8.00	0.08%
拟发行流通股	--	--	2,434.00	25.01%
合计	**7,300.00**	**100%**	**9,734.00**	**100%**

（二）公司前十名股东

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	梁大钟	5,115.00	70.07%
2	白瑛	1,080.00	14.79%
3	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	320.00	4.38%
4	施保球	200.00	2.74%
5	深圳市创新投资集团有限公司	130.00	1.78%
6	东莞红土创业投资有限公司	130.00	1.78%
7	深圳市红土信息创业投资有限公司	100.00	1.37%
8	林忠	35.00	0.48%
9	饶锡林	28.00	0.38%
10	文正国	28.00	0.38%

（三）公司前十名自然人股东在公司的任职情况

截至本招股说明书签署日，公司共有3名法人股东、1名合伙企业股东和15名自然人股东。15名自然人股东均在公司任职，其中前10名自然人股东在公司的任职情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	在公司任职情况
1	梁大钟	5,115.00	董事长、总经理
2	白瑛	1,080.00	董事
3	施保球	200.00	董事、副总经理、研发中心主任
4	林忠	35.00	副总经理
5	饶锡林	28.00	运营总监、研发中心副主任
6	文正国	28.00	副总经理、董事会秘书
7	林治广	24.00	审计部经理
8	谭云烽	23.00	财务总监

9	刘明才	20.00	高级顾问
10	刘兴波	15.00	研发中心副经理、主管工程师

（四）公司股本性质

本次发行前，公司股本结构中无国有股份、外资股份和战略投资者持有股份。

（五）最近一年公司新增股东的情况

为了优化公司股东结构，增强公司法人治理能力和业务发展能力，补充公司经营的资金需求，最近一年，公司引入了刘明才、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、东莞红土创业投资有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司等1名自然人股东、3名法人股东和1名合伙企业股东。新增股东的基本情况如下：

1、刘明才

男，汉族，1953年6月出生；历任江苏长电科技股份有限公司车间主任、分厂厂长、办公室主任、总厂厂长、总经理助理、封装事业部副总经理等职务；2013年6月从长电科技办理退休手续；2013年9月至今任气派科技高级顾问。

2、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）公司基本情况

成立日期	2010 年 11 月 18 日
执行事务合伙人	深圳市中兴创业投资基金管理有限公司
认缴（实缴）出资额	100,000 万元
住所	深圳市南山区高新区南区科苑路东中兴综合大楼办公楼及厂房 A 座六楼 001 室
经营范围	企业股权投资及投资咨询（不含证券、保险、银行业务及其它法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。

（2）股权结构

截至2014年6月30日，中和春生出资比例如下：

姓名/单位名称	出资额（万元）	占比	股东类型
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司	1,000.00	1.00%	普通合伙人
中兴通讯股份有限公司	30,000.00	30.00%	有限合伙人
广东喜之郎集团有限公司	10,000.00	10.00%	有限合伙人
李永良	7,500.00	7.50%	有限合伙人
王柏兴	5,000.00	5.00%	有限合伙人
天津福瑞新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,400.00	4.40%	有限合伙人
汇中泰德投资有限公司	4,000.00	4.00%	有限合伙人
天津富石股权投资基金合伙企业（普通合伙）	4,000.00	4.00%	有限合伙人

深圳市云威投资有限公司	2,000.00	2.00%	有限合伙人
叶景坤	2,000.00	2.00%	有限合伙人
刘久金	2,000.00	2.00%	有限合伙人
魏万城	1,500.00	1.50%	有限合伙人
周旭	1,280.00	1.28%	有限合伙人
张远辛	1,250.00	1.25%	有限合伙人
庄丹明	1,200.00	1.20%	有限合伙人
杜守婕	1,200.00	1.20%	有限合伙人
谢建良	1,200.00	1.20%	有限合伙人
范洪福	1,200.00	1.20%	有限合伙人
胡焰龙	1,140.00	1.14%	有限合伙人
张静	1,100.00	1.10%	有限合伙人
邹玟	1,030.00	1.03%	有限合伙人
陶璇	1,000.00	1.00%	有限合伙人
邓荣	1,000.00	1.00%	有限合伙人
陈展辉	1,000.00	1.00%	有限合伙人
高宏坤	1,000.00	1.00%	有限合伙人
李成芬	1,000.00	1.00%	有限合伙人
张平	1,000.00	1.00%	有限合伙人
卢耀普	1,000.00	1.00%	有限合伙人
王县洪	1,000.00	1.00%	有限合伙人
张国瑞	1,000.00	1.00%	有限合伙人
寿斌	1,000.00	1.00%	有限合伙人
梁沪明	1,000.00	1.00%	有限合伙人
戈弋	1,000.00	1.00%	有限合伙人
梁涌	1,000.00	1.00%	有限合伙人
田卫兵	1,000.00	1.00%	有限合伙人
黄延军	1,000.00	1.00%	有限合伙人
张伯丹	1,000.00	1.00%	有限合伙人

（3）财务状况

中和春生最近一年及一期财务状况如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2013年/2013年12月31日	98,656.82	98,656.82	-559.31
2014年1-6月/2014年6月30日	91,781.57	91,781.57	-158.25

注：2013 年数据业经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2014 年数据未经审计

3、深圳市创新投资集团有限公司

（1）公司基本情况

成立日期	1999 年 8 月 25 日
法定代表人	靳海涛
注册资本	420,224.952 万元
住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业

	投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

（2）股权结构

截至2014年6月30日，创新投股东结构情况如下：

单位/姓名	出资额（万元）	占比
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	118,483.26	28.20%
深圳市星河房地产开发有限公司	73,081.41	17.39%
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	58,543.80	13.93%
深圳市远致投资有限公司	53,760.00	12.79%
深圳能源集团股份有限公司	21,139.09	5.03%
福建七匹狼集团有限公司	19,459.78	4.63%
深圳市立业集团有限公司	19,459.78	4.63%
广东电力发展股份有限公司	15,435.00	3.67%
深圳市亿鑫投资有限公司	13,917.12	3.31%
深圳市福田投资发展公司	10,273.82	2.44%
深圳市盐田港集团有限公司	9,807.00	2.33%
广深铁路股份有限公司	5,884.20	1.40%
中兴通讯股份有限公司	980.70	0.23%

（3）财务状况

创新投最近一年及一期财务状况如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2013年/2013年12月31日	1,281,775.39	862,916.01	92,988.80
2014年1-6月/2014年6月30日	1,277,338.21	856,409.35	52,748.64

注：以上数据未经审计

4、东莞红土创业投资有限公司

（1）公司基本情况

成立日期	2013 年 3 月 15 日
法定代表人	施安平
注册资本	50,000 万元
住所	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 12 号楼 4 楼 410A1 室
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

截至2014年6月30日，东莞红土股东结构情况如下：

姓名	出资额（万元）	占比
深圳市创新投资集团有限公司	17,500	35.00%
东莞市政府物业管理中心	10,000	20.00%
深圳市城市投资发展（集团）有限公司	10,000	20.00%
东莞市松山湖信息网络有限公司	5,000	10.00%
深圳盛创新合投资有限公司	2,500	5.00%
东莞市东糖集团有限公司	2,500	5.00%
东莞市海通工业煤炭销售有限公司	2,500	5.00%

（3）财务状况

东莞红土最近一年及一期财务状况如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2013年/2013年12月31日	9,288.21	9,288.21	-711.79
2014年1-6月/2014年6月30日	17,593.93	17,375.18	-413.02

注：以上数据未经审计

5、深圳市红土信息创业投资有限公司

（1）公司基本情况

成立日期	2011 年 5 月 6 日
法定代表人	靳海涛
注册资本	25,000 万元
住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 12 层 E1 区
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

（2）股权结构

截至2014年6月30日，深圳红土股东结构情况如下：

单位名称	出资额（万元）	占比
深圳市创新投资集团有限公司	11,000	44.00%
深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室	5,000	20.00%
盈富泰克创业投资有限公司	5,000	20.00%
江苏鼎力置业发展有限公司	2,500	10.00%
深圳市国融投资基金管理有限公司	1,500	6.00%

（3）财务状况

深圳红土最近一年及一期财务状况如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2013年/2013年12月31日	24,162.01	24,162.01	-341.92
2014年1-6月/2014年6月30日	24,240.45	24,240.45	78.44

注：以上数据未经审计

（六）本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例

控股股东与实际控制人梁大钟与白瑛为夫妻关系，其中，梁大钟直接持有公司5,115万股股份，占本次发行前公司总股本的70.07%，白瑛直接持有公司股份1,080万股，占本次发行前公司总股本的14.79%。股东梁晓英为梁大钟姐姐的女儿，直接持有公司8万股股份，占本次发行前公司总股本的0.11%。除此之外，其他股东之间无关联关系。

（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司股东已就发行前所持股份做出了自愿锁定的承诺，具体内容详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”之“（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及约束措施”

（八）公司工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况

自公司成立至本招股说明书签署日，公司不存在委托持股情况，未发行过内部职工股，不存在工会持股、职工持股会持股、委托持股或股东数量超过两百人的情况。

九、公司员工及其社会保障情况

（一）公司员工人数及构成情况

报告期各期末，公司及子公司广东气派员工合计人数情况如下：

公司名称	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
气派科技	548	678	600	446
广东气派	370	91	-	-
合计	**918**	**769**	**600**	**446**

截至2014年6月30日，公司员工构成情况如下：

分类方式	具体分类标准	员工人数（人）	占比
专业结构	研发技术人员	237	25.82%
	生产人员	591	64.38%
	销售人员	18	1.96%
	管理人员	39	4.25%
	财务人员	12	1.31%
	其他	21	2.29%
	合计	**918**	**100%**
受教育程度	本科及以上	74	8.06%
	大专	150	16.34%

	大专以下	694	75.60%
	合计	**918**	**100%**
年龄分布	30 岁以下	754	82.14%
	31-40 岁	117	12.75%
	41-50 岁	34	3.7%
	51 岁及以上	13	1.4%
	合计	**918**	**100%**

（二）公司执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度情况

本公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定，实行劳动合同制，并建立了完善的内部劳动用工管理规范。员工薪酬由公司根据《中华人民共和国劳动法》的规定、劳动合同的约定及公司的盈利情况决定。本公司根据国家及深圳市、东莞市的有关规定，依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，定期向深圳市龙岗区社会保险基金管理局和东莞市石排社会保险基金管理中心缴纳各项保险基金。

截至2014年6月30日，公司共有918名员工，除部分新进员工正在办理社会保险和住房公积金开户和缴纳手续，退休返聘人员根据相关规定不需要办理除外，公司已为所有在职员工缴纳了社会保险和住房公积金。

1、公司社保缴纳情况

2011年，气派科技社保缴纳情况如下：

单位：万元

项目		气派科技缴纳比例	气派科技缴纳金额
养老	深户	11.00%	23.73
	非深户	10.00%	
综合医疗	1-6 月	4.50%	9.46
	7-12 月	6.50%	
住院医疗	1-6 月	0.50%	
	7-12 月	0.60%	
农民工医保	1-6 月	6 元/人	2.65
	7-12 月	8 元/人	
综合医保中生育		0.50%	1.40
住院医保中生育		0.20%	
失业		深圳市上年度城镇职工月平均工资×1%×参加失业保险人数×40%	0.15
工伤		0.50%	3.12

2012年，气派科技社保缴纳情况如下：

单位：万元

项目		气派科技缴纳比例	气派科技缴纳金额
养老	深户	11.00%	142.40
	非深户	10.00%	
综合医疗		6.50%	20.00
住院医疗		0.60%	
农民工医保		8 元/人	3.53
综合医保中生育		0.50%	2.48
住院医保中生育		0.20%	
失业		深圳市上年度城镇职工月平均工资×1%×参加失业保险人数×40%	0.18
工伤	1 月	0.50%	0.30
	2-6 月	0.80%	3.30
	7-12 月	0.64%	6.32

2013年，气派科技社保缴纳情况如下：

单位：万元

项目		气派科技缴纳比例	气派科技缴纳金额
养老	深户	14.00%	409.45
	非深户	13.00%	
综合医疗		6.50%	38.49
住院医疗		0.60%	
综合医保中生育		0.50%	4.42
住院医保中生育		0.20%	
农民工医保		8 元/人	4.45
失业		2.00%	26.24
工伤	1 月	0.64%	13.15
	2-12 月	0.40%	

2013年，广东气派社保缴纳情况如下：

单位：万元

项目		广东气派缴纳比例	广东气派缴纳金额
养老	企业	11.00%	4.72
	地方	3.00%	
医疗	住院	1.75%	0.72
	门诊	0.05%	
失业		0.50%	0.17
工伤		1.00%	0.34

2014年1-6月，气派科技社保缴纳情况如下：

单位：万元

项目		气派科技缴纳比例	气派科技缴纳金额
养老	深户	14.00%	194.88
	非深户	13.00%	
医疗	一档	6.20%	23.14
	二档	0.60%	
	三档	0.45%	
生育	一档	0.50%	2.32
	二档	0.20%	
失业		2.00%	10.01
工伤	1 月	0.40%	11.00
	2-6 月	0.80%	

2014年1-6月，广东气派社保缴纳情况如下：

单位：万元

项目		广东气派缴纳比例	广东气派缴纳金额
养老	企业	11.00%	26.60
	地方	3.00%	
医疗	住院	1.75%	4.05
	门诊	0.05%	
失业		0.50%	0.93
工伤		1.00%	1.94

截至2014年6月30日，公司及子公司员工总数为918人，缴纳社保人数为777人，未缴纳人数为141人中：（1）1名员工为退休返聘；（2）11名员工过了缴纳年龄；（3）129名为新员工，缴纳手续在办理中。

2011年1月至2012年9月期间，公司实行由员工自己决定是否在深圳缴纳社保的政策，并对不缴纳的员工进行现金补偿，因此导致部分员工未能缴纳社保；2012年10月开始，公司决定所有员工必须缴纳社保。

2013年5月至7月期间，广东气派处于成立初期，各项事务在筹备阶段，没有正式招聘员工，主要通过气派科技借调员工开展前期工作，因此没有开立社会保险账户，自2013年8月开始，广东气派开立账户并缴纳社保。

2014年8月28日，深圳市社会保险基金管理局出具《证明》：“气派科技股份有限公司在2011年1月1日至2014年6月30日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被我局行政处罚的记录。”

2014年8月15日，东莞市石排社会保险基金管理中心出具《证明》：“广东

气派科技有限公司能够遵守社会保险方面的法律法规，该公司从2013年8月14日至今无欠缴社会保险费的情形，亦不存在因违反社会保险法律法规而受到行政处罚的情形。”

2、公司住房公积金缴纳情况

公司按照有关规定执行住房公积制度，为符合条件的员工缴纳住房公积金。

报告期内住房公积金缴纳的情况：

单位：万元

年度	公司缴纳比例	气派科技 缴纳金额（万元）	广东气派 缴纳金额（万元）
2011 年	5%	42.87	-
2012 年	5%	91.05	-
2013 年	5%	133.85	4.41
2014 年 1-6 月	5%	59.84	18.42

2011年1至5月，公司未缴纳住房公积金；自2011年6月开始，公司要求所有员工必须缴纳住房公积金。

2013年5月至7月期间，广东气派处于成立初期，各项事务在筹备阶段，没有正式招聘员工，主要通过气派科技借调员工开展前期工作，因此没有开立住房公积金账户，自2013年8月开始，广东气派开立账户并缴纳住房公积金。

截至2014年6月30日，公司及子公司员工总数为918人，公司为782名员工缴纳了住房公积金。其余未办理公积金的136名员工中：（1）1名员工为退休返聘员工；（2）6名漏缴，7月份已补缴；（3）129名员工为新员工，公积金缴纳手续正在办理中。

2014年8月20日，深圳市住房公积金管理中心龙岗区管理部出具《单位住房公积金缴存证明》：“气派科技股份有限公司在2011年6月至2014年7月缴存时段内，“没有因违法违规而被我中心处罚的情况。”

2014年8月29日，东莞市住房公积金管理中心出具《证明》：“广东气派科技有限公司自2013年8月为职工缴存住房公积金，该公司不存在因违反住房公积金有关法规而被我中心处罚的情况。”

3、实际控制人对报告期内社保、住房公积金缴纳情况的相关承诺

假设公司需补缴各项社会保险、住房公积金，经测算，2011年、2012年、2013年和2014年1-6月需要补缴的金额，以及对公司净利润的影响如下：

单位:万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
需补缴社保的金额	-	-	23.88	122.22
需补缴住房公积金的金额	-	-	-	26.80
对净利润的影响比例	-	-	0.05%	0.49%

针对报告期内公司未为全体员工缴纳社会保险、住房公积金的情形，实际控制人梁大钟、白瑛分别承诺：“如公司及子公司因首次公开发行股票并上市前未能遵守劳动与社会保障、住房公积金等有关法律法规而被有权政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的，本人将在公司及子公司收到有权政府部门的生效决定后，及时、足额的将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司及子公司，以避免公司及子公司遭受经济损失。如本人违反上述承诺导致公司及子公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。”

十、公司持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

（一）信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺及约束措施

1、公司控股股东信息披露虚假陈述的承诺及约束措施

详见本招股书“重大事项提示”之“一、（二）、2、公司控股股东信息披露虚假陈述的承诺及约束措施”部分。

2、公司董事、监事及高级管理人员因信息披露虚假陈述的承诺及约束措施

详见本招股书“重大事项提示”之“一、（二）、3、公司董事、监事及高级管理人员因信息披露虚假陈述的承诺及约束措施”部分。

（二）公司持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向、减持意向及约束措施

详见本招股书“重大事项提示”之“一、（三）公司持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向、减持意向及约束措施”部分。

（三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及约束措施

详见本招股书“重大事项提示”之“一、（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及约束措施”部分。

（四）关于稳定公司股价的预案及约束措施

详见本招股书“重大事项提示”之“一、（一）公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案及约束措施”部分。

（五）关于避免同业竞争的承诺

控股股东梁大钟，实际控制人梁大钟、白瑛就避免与发行人（包括发行人控制的企业）同业竞争与利益冲突事宜作出以下不可撤销的承诺：本人声明，除了作为发行人股东及董事或高级管理人员外，本人和本人控制的企业目前没有直接或间接从事与发行人相同或相似并构成竞争关系的业务，没有直接或间接拥有与发行人从事相同或相似并构成竞争关系的企业、其他组织、经济实体的控制权（包括共同控制）或可以对其施加重大影响的权利，也没有直接或间接从事损害发行人合法权益或者与发行人构成利益冲突的其他行为或事项。

本人承诺，在本人作为发行人股东及董事或高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同或相似并构成竞争关系的业务，不会直接或间接拥有与发行人从事相同或相似并构成竞争关系的企业、其他组织、经济实体的控制权（包括共同控制）或可以对其施加重大影响的权利，也不会直接或间接从事损害发行人合法权益或者与发行人构成利益冲突的其他行为或事项。本人将依法促使本人控制的其他企业按照与本人同样的标准遵守以上承诺。

在代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会、董事长、总经理中的任何一方（以下简称“异议方”）认为本人或本人控制的其他企业与发行人存在同业竞争或利益冲突的情形时，异议方有

权向本人书面询证，本人应在接到该询证函件后 10 个工作日内提出书面解释并如实提供相关证明材料（如有）。如异议方在收到本人的书面解释和资料后仍认为存在同业竞争或利益冲突情形的，异议方有权根据《公司法》和发行人章程的规定提议召开董事会会议，审议本人是否存在同业竞争或利益冲突情形，本人和本人的关联方应在董事会审议时回避表决。如董事会认为本人确实存在同业竞争或利益冲突情形的，本人应在董事会决议作出之日起 30 个工作日内停止从事构成同业竞争或利益冲突的业务并将从事同业竞争或利益冲突业务所得收益上缴发行人。同时，如发行人要求本人无偿将构成同业竞争或利益冲突的业务依法转让给发行人的，本人无条件配合办理相关手续。

如违反本声明、承诺事项并导致发行人遭受经济损失的，本人应赔偿发行人遭受的全部经济损失。

如本人违反上述承诺事项或者未依法执行相应约束措施的，发行人有权扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款直至本人依法履行相关承诺或执行相关约束措施。

第六节 业务和技术

一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）主营业务

公司以集成电路封装测试技术的研发与应用为基础，从事集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案。据中国半导体行业协会的数据显示，在2013年中国境内封测业收入排名中，公司封测业务收入排名第29，在内资封装测试企业中排名第5，公司业已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业，是我国内资集成电路封装测试服务商中少数具备较强的质量管理、工艺创新控制能力的技术应用型企业之一（数据来源：《中国半导体封装测试产业调研报告（2013年度）》，中国半导体行业协会封装分会，2014年5月）。

（二）主要产品

公司封装产品主要包括DIP、HDIP、Qipai、SOP、ESOP、SSOP、TSSOP、SOT、TO、MSOP、EMSOP、LQFP、HSOP、QFN、DFN等。作为封装测试领域的后进入者，公司主要采取跟进策略，充分利用后发优势，以提高产品封装效率为主导，通过与设备厂商、原材料供应商合作研发设计，改进生产工艺，持续推出高性价比的封装产品。此外通过持续稳定的研发投入以及与科研机构的合作，公司不断向先进封装产品进行延伸，已经具备了批量生产国内技术比较先进的QFN/DFN产品的能力；通过与香港应用科技研究院有限公司合作研制出了BGA样品，并掌握了Flip-Chip技术，目前BGA处于前期生产的准备阶段。

未来，随着资本实力的增强、持续稳定的研发投入以及募投项目的建设，公司将逐步布局进行先进封装技术的研发和拓展，提升技术层级、制造规模和品牌形象。

（三）主营业务变更情况

公司自2006年底设立以来，一直从事集成电路的封装测试服务，主营业务未发生变更。

二、发行人所处行业的基本情况

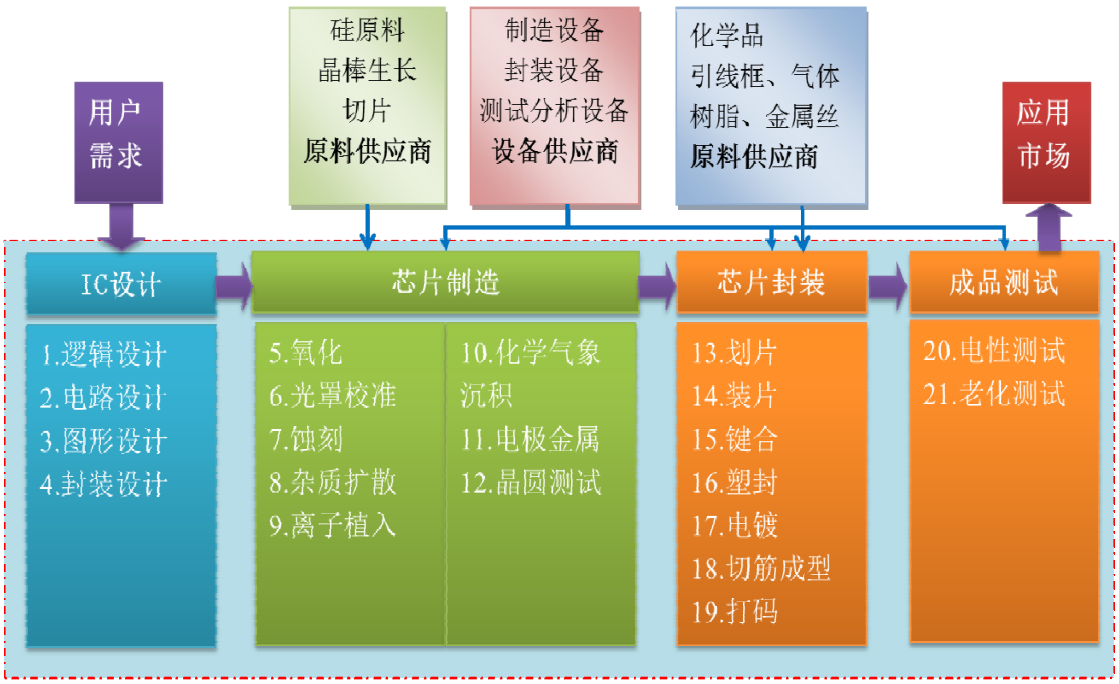
（一）发行人所属行业基本情况

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订版），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下面的集成电路制造业（C3963），具体细分行业为集成电路封装测试业。

1、集成电路产业链基本情况

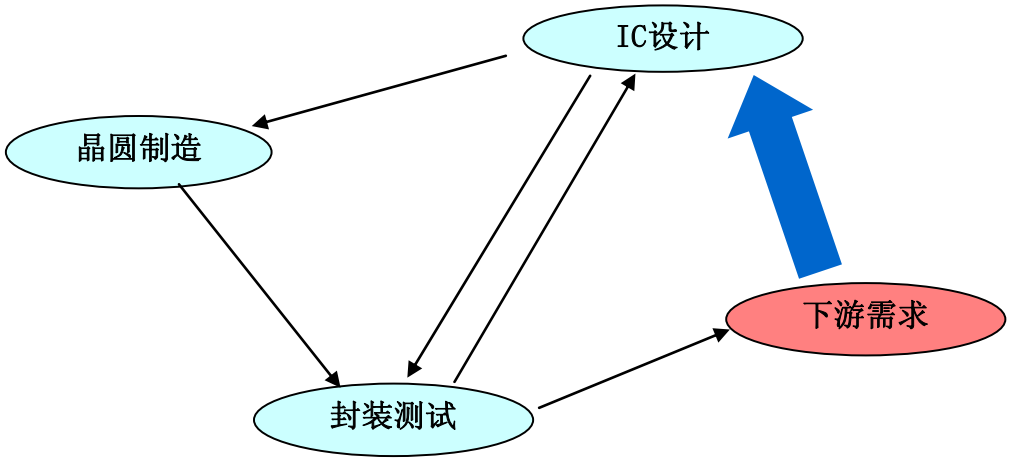
半导体包括集成电路（IC）和分立器件两大类，集成电路产业是半导体产业的典型代表，是电子信息产业的核心与基础，是国家重点鼓励发展的产业。由于集成电路技术更新、市场竞争等原因，集成电路产业链已专业化细分为IC设计、芯片制造和封装测试三大独立的子行业。

图：集成电路产业链环节



为了满足消费者需求，IC设计厂商依据芯片制造厂商和封装测试厂商的工艺技术能力完成线路设计和版图转换，最终实现相应功能的集成电路产品。晶圆制造和封装测试环节在整个半导体产业链上则扮演着专业生产角色，实现了产品从设计图纸到成品的转变。随着先进封装技术的不断应用和推广，IC设计厂商已经开始与封装测试厂商合作对集成电路的各项性能做最优的协同设计，因此可以说

集成电路的先进封装技术环节已然成为最终器件在设计之初的重要考量因素。



2、封装测试行业基本情况

封装是指对通过测试的晶圆进行划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是使电路芯片免受物理、化学等环境的损伤，起着保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，以及便于将芯片的I/O端口联接到部件级（系统级）的印制电路板（PCB）、玻璃基板等，以实现电气连接，确保电路正常工作。测试主要是对芯片、电路以及老化后的电路产品的功能、性能测试等，外观检测也归属于其中。其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来。目前，国内测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业（以下简称“封测业”）。

（二）行业管理体制

我国集成电路产业的主管部门是工业和信息化部，主要负责拟定高新技术产业中涉及信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动信息服务业发展。

中国半导体行业协会是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。中国半导体行业协会成立于1990年11月，主要职能是贯彻落实国家及政府有关的政

策、法规，向政府业务主管部门提出行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、统计、研究、预测行业产业与市场，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；协助政府制订行业标准、国家标准及推荐标准，推动标准的贯彻执行；促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善；广泛开展经济技术交流和学术交流活动，发展与国外团体的联系，促进产业发展，推动产业国际化等。

（三）行业法律法规及政策

集成电路产业为充分的市场竞争行业，我国对集成电路产业没有制定单独的法律法规，相关的生产经营活动使用《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等市场主体普遍使用的法律法规。

集成电路产业是电子信息产业的核心，是国家战略性新兴产业，封装测试业是集成电路产业的重要组成部分。国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展，先后出台了一系列促进行业发展的政策：

年份	政策	内容摘要
2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	到2015年，集成电路产业发展体制机制创新取得明显成效，建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境。集成电路产业销售收入超过3500亿元。移动智能终端、网络通信等部分重点领域集成电路设计技术接近国际一流水平。32/28纳米（nm）制造工艺实现规模量产，中高端封装测试销售收入占封装测试业总收入比例达到30%以上，65-45nm关键设备和12英寸硅片等关键材料在生产线上得到应用。 大力推动国内封装测试企业兼并重组，提高产业集中度。适应集成电路设计与制造工艺节点的演进升级需求，开展芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装等先进封装和测试技术的开发及产业化。
2013年	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（国家发改委[2013]16 号）	将采用SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、Flip-Chip、TSV等技术的集成电路封装列为战略性新兴产业重点产品目录，作为引导社会资源投向，各地区政府重点培育的新兴产业。
2012年	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2012]28 号）	围绕重点整机和战略领域需求，大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试

		技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势。
	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）	指出集成电路线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；《通知》还列明了在机器折旧、员工培训等方面可享的税收优惠政策。
	《2012 年度集成电路产业研究与开发专项资金申报指南》（国家发改委、工业和信息化部）	将新型封装技术、工艺及产品研发和产业化、新型封装材料研发和产业化、高速测试技术研发及实用化列为集成电路产业研究与开发专项资金申报的主要对象之一。
	《电子信息制造业“十二五”发展规划》（工业和信息化部）	明确将集成电路作为电子信息制造业的发展重点，着力发展设计业，壮大芯片制造业，提升封装测试水平，增强关键设备、仪器及材料自主开发能力，推动集成电路产业做大做强。提升封装测试业层次和能力，发展先进封测技术和产品。顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术。
	《集成电路产业“十二五”发展规划》（工业和信息化部）	指出集中力量、整合资源、攻破一批共性关键技术和重大产品，做强做优做大骨干企业，提升企业核心竞争力；完善产业生态环境，构建大产业链等发展重点，强调提升封测业层次和能力，发展先进封测技术和产品。从落实产业法规、提高财政资金使用效率、加强人才培养等方面制定了详细的政策措施。
2011 年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	指出集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场开发等方面制定了全面的优惠政策。在投融资方面，积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。
	《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（发改委[2011]9 号）	明确将“集成电路设计，线宽0.8微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）等先进封装与测试”为鼓励类发展的项目。
	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（国家发改委、科技部、商务部、知识产权局公告2011年第6号）	明确将集成电路产业中的高端芯片设计，线宽65纳米以下的纳米级集成电路芯片封装和测试被归入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
	《国家“十二五”科学与技术发展规划》（科学技术部）	提出“十二五”时期，要大力培育和发展包括集成电路在内的战略性新兴产业，推动传统产业升级，加快发展现代服务业，全面提升

		高新技术产业竞争力，在体制机制创新和环境建设方面取得关键性突破。
	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的六项措施》（国务院常务会议）	会议确定了强化集成电路产业投融资支持、加大对研发开发的支持力度、实施税收优惠、加强人才培养和引进、严格落实知识产权保护制度和加强市场引导、规范市场秩序等六项措施。
2010年	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	提出着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
2006 年	《2006-2020 年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11 号）	提出要培育有核心竞争能力的信息产业。加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。
2005年	《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）》（国家发改委、信息产业部、国家税务总局、海关总署）	将从事集成电路芯片制造、封装、测试以及6英寸（含）以上硅单晶材料生产的具有独立法人资格的组织归类为集成电路制造企业。通过该办法认定为集成电路企业的公司，可享受财税激励、技术创新、市场促进、人才保障等方面的政策优惠。
	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》(财建[2005]132 号)	为鼓励集成电路企业加强研究与开发活动，国家设立了集成电路产业研究与开发专项资金，用于无偿资助符合条件的集成电路企业进行产品研发和技术创新。
	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》（国发[2005]44号）	将“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”列为“为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是我国科技发展的重中之重”的16个重大专项重点第2项，因此集成电路的该项目简称为“02专项”。

（四）公司所处行业发展概况

1、集成电路产业市场概况

（1）全球半导体市场概况

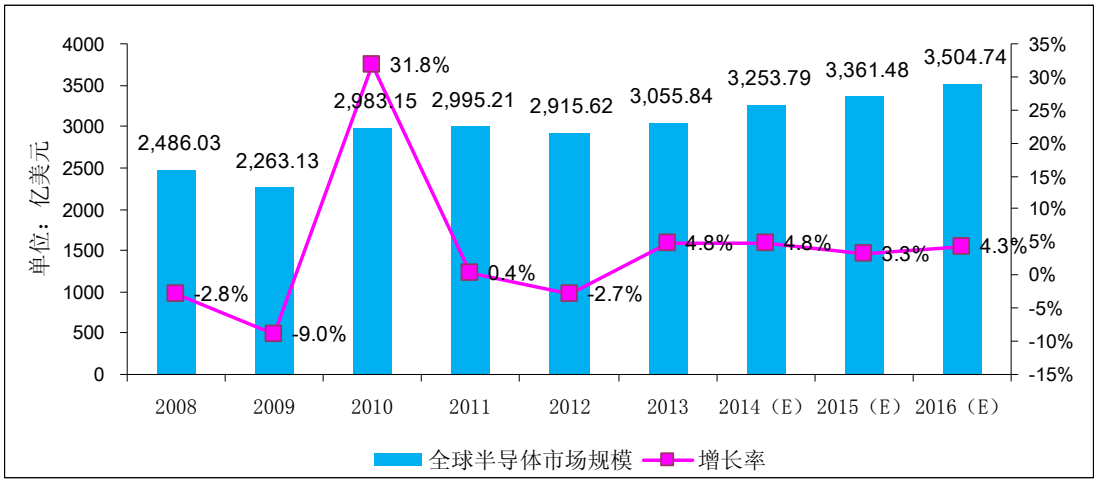
全球范围内集成电路和分立器件两大产品往往混合生产且无严格区分，为便于统计，国际研究机构通常将二者合并统计为半导体的市场数据。总体上来说，全球半导体产业的市场状况基本与世界经济发展形势保持一致。作为半导体的典型代表和占比最大的类型，集成电路自诞生以来，拉动全球半导体产业经历了20世纪60年代至90年代的迅猛增长。进入21世纪以后市场日趋成熟，增速逐步放缓。据世界半导体贸易统计组织（WSTS），全球半导体市场概况的2008年至2013年

的销售情况及之后三年的预测如下：

由于2008年全球金融危机及下游电子产品需求下滑影响，2009年半导体产业销售收入降为2,263.13亿美元，同比下滑9%；2010年，随着经济复苏和终端电子产品如智能手机、平板电脑等兴起，销售收入达到2,983.15亿美元，同比上涨31.8%；2011年因受欧债危机、美国量化宽松货币政策、日本地震以及终端电子产品需求下滑和价格下降影响，2011年销售收入为2,995.21亿美元，增速降为0.4%。2012年，继续受全球严峻经济形势的影响，致全球半导体产业销售增速自2009年来首次降为负值。在智能手机、平板电脑、机顶盒及汽车电子产品等市场强劲需求的推动下，2013年恢复增长至3,055.84亿美元。

据世界半导体贸易统计组织（WSTS）对未来三年全球半导体销售额的预测，2014年全球半导体产业的销售额将达到3,253.79亿美元，较2013年的销售总额增长4.8%。其中，亚太地区销售额将同比增长9.3%，欧洲将同比增长7.9%，美洲将增长2.1%。2015年全球半导体销售总额将增长3.3%，达到3,361.48亿美元；2016年将进一步增长4.3%，达到3,504.74亿美元。WSTS预计未来几年，全球半导体产业将呈现稳步适度增长的整体特征。

图：2008-2016 年全球半导体销售情况及预测



资料来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）

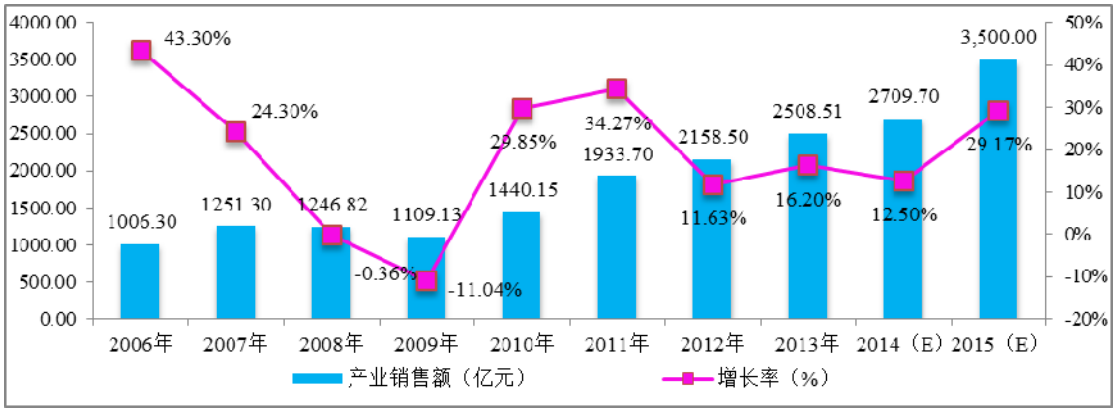
（2）我国集成电路产业市场概况

① 我国集成电路整体产业呈稳健增长的趋势

相比全球市场而言，我国集成电路市场起步较晚，但发展速度明显快于全球水平，保持了平稳较快的增长势头。1997年到2007年10年间，我国集成电路销售

额的年均增长率达到37.3%，销售额在2006年首次突破1,000亿元大关。行业的整体波动趋势与全球经济形势基本一致，近几年受金融危机冲击及全球经济低迷影响，增速放缓。根据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2013年中国集成电路产业销售额为2,508.51亿元，同比增长16.20%，远高于全球4.8%的增长率。

图：2007-2015 年我国集成电路行业销售额及增长情况



资料来源：中国半导体行业协会（CSIA）、《国家集成电路产业发展推进纲要》、《2013年中国集成电路产业运行情况》

同时，我国集成电路产业销售规模占全球产业销售收入比重呈逐年上升的态势：

表：我国集成电路产业销售额占全球产业销售收入的份额

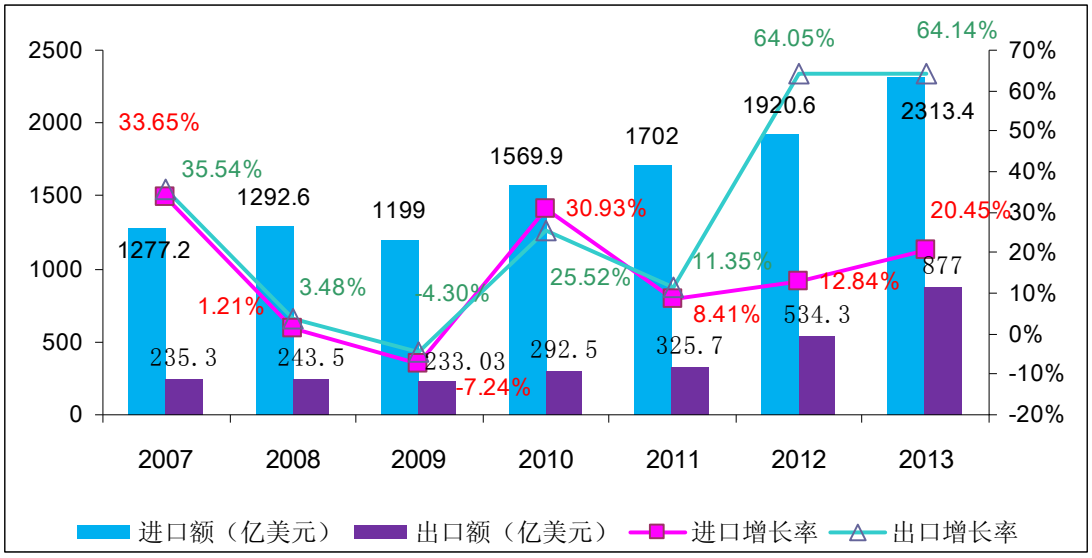
年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
比重	6.06%	7.54%	8.65%	8.54%	8.60%	12.42%	14.41%	13.46%

资料来源：中国半导体行业协会（CSIA）《中国半导体产业发展状况报告（2013 年版）》、《2013 年中国集成电路产业运行情况》、SIA《SemiconductorIndustryPostsRecordSalesin2013》

② 进口集成电路替代空间较大

我国作为庞大的电子、通信、汽车、工业自动化等终端消费市场，对集成电路的需求量非常大，而本土集成电路产业规模依然较小，供求缺口较大，产业的进口额远高于出口额。

图：2007-2013 年我国集成电路行业进出口额及变化情况



资料来源：中国海关

工信部统计数据指出，2001年到2012年年间，我国集成电路产量、销售额的年均增长率均超过20%，中国集成电路产业规模已经由2001年不足世界集成电路产业总规模的2%提高到2012年的10%，但国内集成电路产业规模与市场规模之比始终未超过20%。如扣除集成电路产业中接受境外委托代工的销售额，则中国集成电路市场的实际国内自给率还不足10%，国内市场所需的集成电路严重依靠进口的局面并未发生实质性改变，进口替代空间巨大。

③ 本土集成电路市场内生增长前景广阔

我国是目前全球最大的半导体消费市场，2006-2012年，我国半导体市场需求额占全球半导体市场的份额如下：

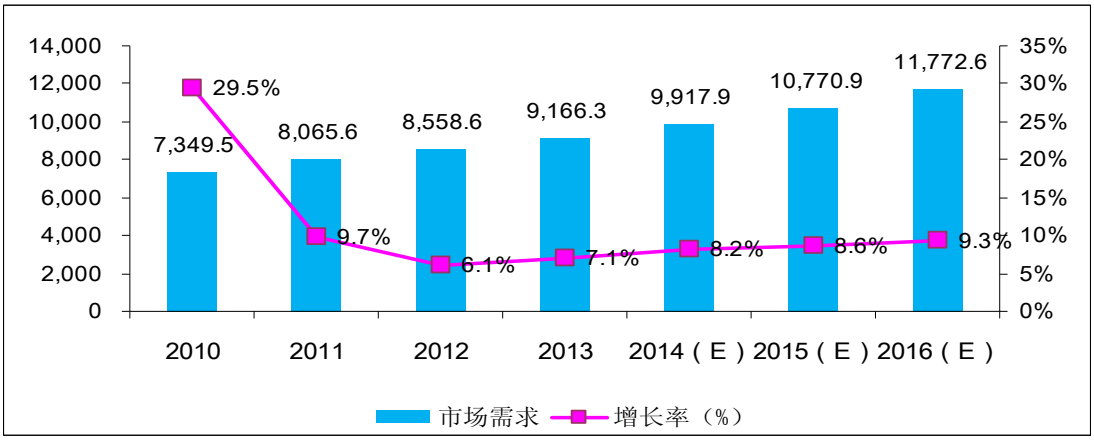
表：我国半导体市场需求额占全球半导体市场的份额

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
比重	28.9%	34.1%	38.3%	42.5%	42.4%	47.7%	54.1%

资料来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2013 年版）》

在集成电路产品方面，中国市场对集成电路产品的需求增速远高于全球平均水平，2013 年需求规模增至 9,166.3 亿元，同比增长 7.1%，据 CSIA 预计，集成电路市场需求增速将呈稳步上升的势头，至 2016 年市场需求规模将达到 11,772.6 亿元。

图：我国集成电路市场需求和发展预测



资料来源：中国半导体行业协会、赛迪顾问

从集成电路的市场应用结构看，计算机、网络通信和消费电子仍然是我国集成电路最主要的应用市场，三者合计占整体市场比重超过85%。2013年，我国电子信息产业销售收入12.4万亿元，折美元计算，占同期全球IT支出比重超过50%。在硬件产品制造方面，我国手机、计算机和彩电等产品产量分别达到14.6亿部、3.4亿台和1.3亿台，占全球出货量比重均在半数以上，稳居全球第一。同时，由于近年来移动智能设备对移动AP、触摸屏控制芯片、基带、射频等网络通信类集成电路需求量的迅猛增加，我国本土集成电路市场表现出强劲的内生增长潜力，拥有广阔的市场空间。

2、封装测试行业发展概况

（1）封装测试行业发展特征

①产业链专业化分工趋势更加明显

集成电路产业从诞生至今的60多年中，随着技术进步、行业竞争和市场需求的不断变化，经历了多次结构调整之后，已经逐渐由原来“大而全”的IDM模式的逐渐演化成目前“专而精”的多个专业细分产业（如下表），适应了企业发挥核心专长、创造价值最大化的要求。

表：集成电路产业模式演变历程

发展阶段	产业链模式发展历程
产业链集于一身（1950-1970’S）	①20世纪50年代，集成电路诞生于美国。作为一项新兴技术，其研发、制造等被少数大型企业掌握，而生产所用的设备、材料、制造工艺技术等又有高度专业性，最初能发展集成电路产业的企业只有掌握包括产品设计、研发、加工制造在内的全套技术，拥有集成电路材料制备和制造

	设备的大型公司（IDM-整合组件制造商）； ②IDM参与到集成电路产业是为自身制造的电子整机产品如电子设备、通信设备、家用电器等服务，以此增加其整机产品的附加值，提升产品的功能和质量，降低生产成本，争夺市场； ③代表企业：IBM、德州仪器、摩托罗拉、三星、东芝、日立等；
集成电路与设备、材料业的分离 （1960-1980’S）	①20世纪60年代中后期，随着产业规模的扩大和工业技术的提升，专业化分工的优势逐步显现，于是集成电路制造设备业、材料业逐渐从这些IDM分离，作为上游行业发展起来； ②最初集成电路产业系统就分离为集成电路业、集成电路设备业和材料业三个行业； ③代表企业：美国应用材料公司、日本东京电子、荷兰ASML和香港ASM公司在1967-1975年间成立并迅速壮大。
设计、制造、封装测试业的分离 （1970’s至今）	①**封测业兴起**：20世纪70年代起，行业竞争加剧和封装测试工艺日渐成熟，集成电路封装测试环节的技术逐渐转移到封装测试的工艺制程、生产管理、制造设备和原材料技术中；IDM为专注于核心优势，降低经营风险，逐步将封装测试环节剥离，专业的封装测试公司开始出现，封测行业首先从产业中独立出来；
	②**设计业兴起**：20世纪80年代，随着计算机辅助工程（CAE）、辅助设计（CAD）和工艺模拟、仿真等设计方法的发展，使集成电路设计可独立于生产工艺进行，门槛大大降低；同时顺应产品多元化趋势，大量专业集成电路设计公司应运而生，设计业兴起；
	③**制造业兴起**：随着制造工艺水平的提高，对集成电路生产线的资金要求也越来越大（多达几亿至几十亿美元），多数IDM不愿或无力承担巨额投入所带来的风险，于是只专注于集成电路芯片制造的企业兴起；
	④**封测产业转移**：最初的封装测试业技术和资金门槛较低，需要较多的人力和土地资源，马来西亚、菲律宾、中国台湾及大陆地区的比较成本优势突出，且当地政府大力支持和鼓励集成电路产业发展，因此全球集成电路产业的封装测试环节大量向这些地区转移，亚太地区迅速发展成为全球集成电路封测基地；这些国家或地区多数以封装测试业为基础，逐步发展设计业和制造业，最终形成三业并举的格局。

目前，集成电路产业越来越显示出产业链细分和模式多元化的发展趋势，已形成了集成电路设计业、芯片制造业、封装测试业协调互动共同发展的格局。

根据市场研究机构ICInsights的统计，在全球排名领先的半导体企业中，专业企业的增长速度整体继续高于IDM企业。ICInsights指出，2013年全球前二十大半导体厂商中业务增长率最高的5家均为专业化企业，包括两家内存公司SK海力士和美光，平均增长达到62.5%；2家专业IC设计企业联发科（MediaTek.Inc）和高通（Qualcomm），平均增长达到33.5%；1家专业晶圆制造商台积电(TSMC)，增长达17%。

②封装测试行业在产业链中的作用更加突出

A、封装测试在保护芯片及增强性能方面的作用突出

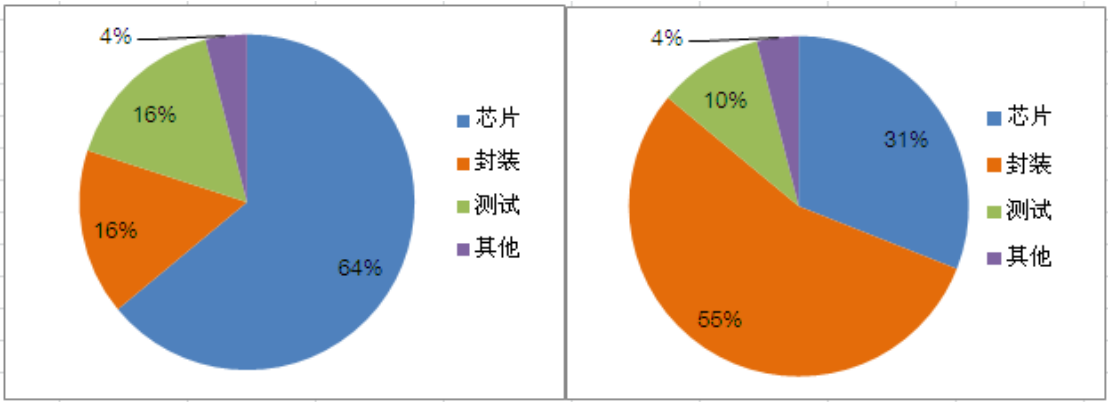
因为芯片必须与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降，保护芯片表面以及连接引线等，使芯片在电气或热物理等方面免受外力损害及外部环境的影响；同时通过封装使芯片的热膨胀系数与框架或基板的热膨胀系数相匹配，这样就能缓解由于热等外部环境的变化而产生的应力以及由于芯片发热而产生的应力，从而可防止芯片损坏失效。

此外，随着封装技术的不断发展，封装能够显著提高封装密度、增强产品性能、提高速度、降低功耗和噪声、实现电子设备的小型化和多功能化，还能使设计自由度提高，开发时间大幅缩短。

B、封装测试在集成电路产业成本的占比最大

随着芯片产品的不断微缩化、多功能化，引脚数越来越多，单位芯片设计及制造成本呈现较快下降的趋势。而由于芯片复杂度提高、封装技术由低阶向高阶持续演进以及封装原材料价格上涨等因素，使芯片的封装成本不断提高，至2007年封装成本已经占到了集成电路器件成本的一半以上，成为占比最大的环节，生产成本优势成为封装测试企业竞争力的核心体现之一。

图：2002 与 2007（右）年封装在半导体器件成本中比重变化



数据来源：2012SEMICONChina 研讨会

此外，相比IC设计和晶圆制造环节，半导体封装制程具有通用性和可复制性。IC设计环节会承担某特定芯片量产后市场销量不达预期而造成的高成本风险，而在封装测试环节，尤其对于先进封装制程，其工艺步骤具有可通用性和可移植性，故不存在上述风险。

C、封装测试环节与设计环节的联系越来越紧密

随着技术的进步和质量标准的提高，先进封装技术的应用不仅要求IC设计企业

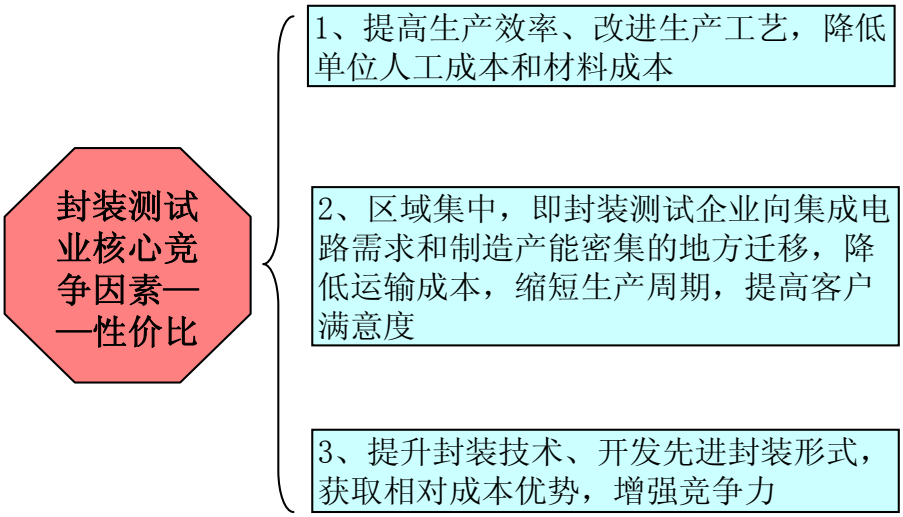
和封装企业共同对集成电路的各项性能、制造过程做最优的协同设计，而且封测技术也直接关系到与芯片连接的PCB的设计与制造。IC设计要有封装测试的支持并对封装测试提出更高的要求，封装测试技术的不断提升又为IC设计提供了保障。

（2）我国具备集成电路封装测试行业的发展优势

我国的集成电路产业较晚，直到90年代初我国才真正形成集成电路设计、芯片制造和封装测试三业并存的格局。我国集成电路产业从无到有、从小到大，从封装测试到芯片设计、制造和封测全产业链，不但形成了一定的产业规模，并且在基础研究、技术开发、人才培养等方面都取得了较大成绩。可以说，封测业对我国集成电路全产业的成长和壮大发挥了巨大作用。我国在集成电路封装测试环节已经具备较突出的发展优势，主要体现在：

①成本优势和区位优势

用户需求和产品性能是集成电路产业及电子产品市场不断推陈出新的决定因素，驱使企业不断研发先进技术、推出新兴产品。当新兴产品逐步成熟，越来越多的企业掌握了其技术工艺并拥有了一定的客户群体之后，新产品转变为成熟产品，核心竞争要素转变为性价比，即在同等性能的情况下，通过控制成本来提高竞争优势。



封装测试是技术密集型和资金密集型行业，不仅需要掌握封装技术和工艺制程，而且需要较多的劳动力、土地、资金等要素资源。成本是封装测试业的首要驱动因素，性价比高的企业能够获得较多的订单，成功的可能性更高。相对于欧

美日韩等国家，我国具备发展集成电路封装测试业的综合成本优势。

我国处于全球集成电路市场规模最大和增长最快的亚太区域，具有就地销售的地缘区位优势，可大大节省产品运输时间和成本。根据WSTS（World Semiconductor Trade Statistics）和SIA（Semiconductor Industry Association）的统计，1986年亚太区半导体市场规模仅占全球的8%，到1990年占比为14%，到2000年占比为25%，2012年为69.98%，同年中国半导体市场规模占全球54.1%。当前封装测试行业市场变化加快且客户对交货期十分敏感，我国作为集成电路下游产业电子整机产品的制造基地和消费市场，为国内封装测试企业创造了无可比拟的地缘优势。

②封装测试是我国在集成电路产业链具有国际竞争力的环节

经过多年的技术开发，目前我国封装技术正从DIP、SOP、QFP等封装形式，向QFN/DFN、BGA、CSP、FC、LGA、WLP等封装形式和技术升级，取得较为明显的突破。我国部分内资先进封测企业在先进封装技术上已经进行了多年的积累，尽管销售占比目前还比较低，但是分别在WLCSP，FCBGA和TSV技术上有了实质性突破，国内封装测试技术与国际最先进水平的差距越来越小。在全球前十大封测企业中，中国内资企业长电科技已稳居十强，2013年中国半导体封装测试企业（含外资）前十大中内资企业占据三席，相比我国在芯片设计环节较欧美发达国家差距较大，本土封装测试行业已具备较强的国际竞争力。

③本土IC设计企业的崛起带来新的发展机遇

近年来，我国加大对集成电路设计企业的扶持力度，《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）着力强调对IC设计环节的支持，国内已经涌现了海思半导体、华大、展讯、国民技术和珠海炬力等综合实力较强的设计企业。封装测试业经过多年的技术和市场积淀，已经为设计业创造了良好的产业发展环境，助推设计业成为市场增速最快的环节；而反过来设计企业作为封测企业的客户，出于对封装地缘和成本因素的考虑，国内设计企业的崛起将为国内封装测试企业带来更多的发展机会。

（3）我国封装测试业在集成电路产业中仍占市场主体地位

近几年，由于国家产业政策的大力推动，设计业和晶圆制造业增速明显加快，封装测试业增速略有放缓，但行业整体规模仍呈稳步增长趋势。

表：2006-2013 年我国集成电路封装测试行业销售额情况

单位：亿元

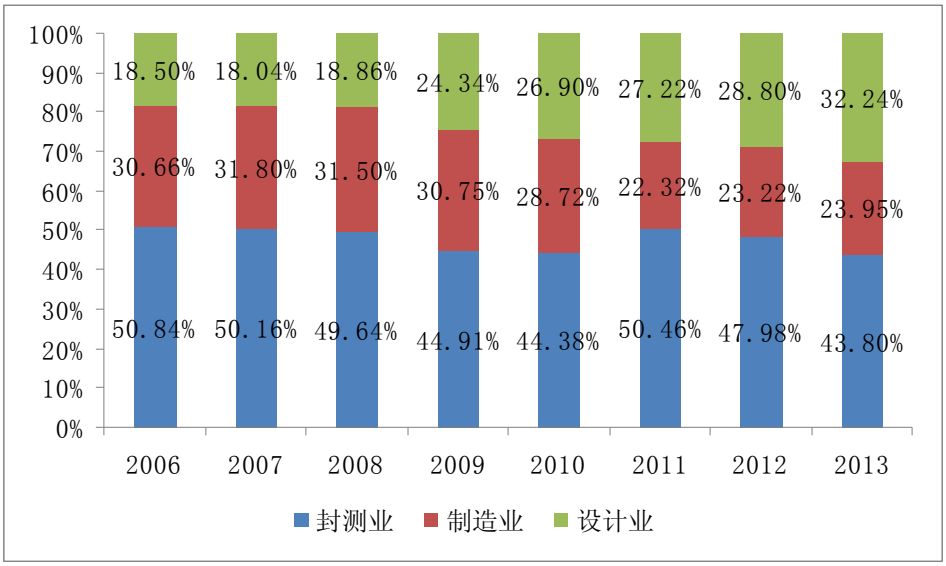
年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
销售额	511.6	627.7	618.91	498.16	629.18	975.7	1,035.67	1,098.85

资料来源：中国半导体行业协会

据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2013年中国集成电路产业2,508.51亿的销售规模中，封装测试业占产业销售收入比重为43.80%，封装测试业仍然是集成电路产业链中占比最大的环节。

2006-2013年集成电路产业销售结构如图所示：

图：2006-2013 年我国集成电路产业销售结构



资料来源：中国半导体行业协会（CSIA）

（4）性价比是封装测试行业的核心竞争要素

①技术创新型和技术应用型企业优势并存

集成电路封装测试是技术和资金密集型行业，对生产管理能力要求很高，其核心竞争要素是性价比，即技术水平和成本控制能力。技术水平则表现在行业前沿技术的攻关能力、新兴产品开发技术以及生产过程中的工艺技术和原材料应用技术；成本控制表现在对生产效率的提升、原材料的利用和产品合格率的控制（生产管理水平）。

表：封装测试技术创新型和技术应用型企业特征

企业类型	主要特征	代表企业
技术创新型企业	• 技术和资金雄厚，规模大、综合实力强 • 引导行业技术进步和产品更新换代 • 以产品技术创新为主导，获取新产品开发带来的前期超额收益 • 数量极少的技术领先企业，技术效益佳	大型跨国外资、合资企业
技术应用型企业	• 具备一定的技术实力和客户基础，规模中等 • 工艺创新能力较强、生产管理出色 • 以工艺技术创新和应用为主导，获取工艺创新带来生产效率提高、材料耗用减少的高毛利收益 • 为数不多的成长企业、兼具技术效益和成本效益	以华天科技、长电科技、气派科技为代表的少数内资企业
技术模仿型企业	• 综合实力相对薄弱，中小型规模 • 不具备明显的技术或工艺创新能力 • 无明确的竞争策略，徘徊在生存边缘 • 为数众多、占比最高的中小型企业	国内众多实力薄弱的内资企业

目前，我国封装测试行业企业可以归为以下三类：

一是以前沿技术创新和新兴产品开发为主要竞争策略的技术创新型企业：用户需求和产品性能是集成电路产业及电子产品市场不断推陈出新的决定因素，驱使企业不断研发先进技术、推出新兴产品，而行业前沿技术、新兴产品的开发往往由行业领先企业主导，他们有雄厚的技术基础进行攻关，有充足的资源承担巨额研发资金和风险，拥有庞大的市场群体推广最新产品，并获取初期的高额利润，此类以技术为主导的企业是技术创新型企业。新兴产品领域的核心竞争要素是技术，掌握先进技术的企业具有竞争优势，并获得初期的高额收益。

二是以工艺创新和成本控制为主要竞争策略的技术应用型企业：当新兴产品逐步成熟，越来越多的企业掌握了其技术工艺并拥有了一定的客户群体之后，新产品转变为成熟产品，核心竞争要素转变为性价比。行业中市场规模最大的产品类型是技术工艺相对成熟、市场应用成熟的产品。那些能将封装技术应用娴熟，凭借持续的工艺创新、原材料改进及高效的生产管理把成本控制在较低限度，创造较高毛利率的企业将建立竞争优势并获得成功的，此类以技术应用和成本控制为主导的企业是封装技术应用型企业。

三是以模仿优势企业的技术和工艺为主要生存策略的技术模仿型企业：这些企业无明显的竞争优势，面临两种选择，要么发展成技术创新型或技术应用型企业，要么徘徊在生存的边缘。

②不同产品领域呈现不同的竞争特征

经过60多年的发展，集成电路产业随着电子产品小型化、智能化、多功能化的发展趋势，技术水平、产品结构、产业规模等都取得举世瞩目的成就。就集成电路封装类型而言，在它的三个阶段发展过程中，已出现了几十种不同外型尺寸、不同引线结构、不同引线间节距、不同连接方式的电路。由于它们对应不同的应用需求，如在功能上有大功率、多引线、高频、光电转换等，在中国及全球多元化的市场上，目前及未来较长一段时间内都将呈现并存发展的格局：A、直插封装工艺成熟、操作简单、功能较单一，虽然市场需求呈缓慢下降的趋势，但今后几年内仍有一定的市场空间；B、表面贴装工艺中，两边或四边引线封装技术如SOP、PLCC、QFP、QFN、DFN等已发展成熟，由于其引脚密度大大增加且可实现较多功能，应用非常普遍，目前拥有三类中最大的市场容量，未来几年总体规模将保持稳定；面积阵列封装技术如WLCSP、BGA、LGA、CSP等技术含量较高、集成度更高，现阶段产品利润高，产品市场处于快速增长阶段，但基数仍然相对较小；C、高密度封装工艺如3D堆叠、TSV等仍处于研发阶段，鉴于该类技术在提高封装密度方面的优异表现，待实用化后将迎来巨大的市场空间。

我国目前集成电路封装市场中，DIP、SOP、QFP、QFN/DFN等传统封装仍占据我国市场的主体，约占70%以上的封装市场份额；BGA、CSP、WLCSP、FC、TSV、3D堆叠等先进封装技术只占到总产量的约20%。

表：国内集成电路封装测试行业竞争特征

封装类型		典型产品/技术	市场前景	市场参与者
直插封装		TO、DIP 等	市场容量大但逐步萎缩	以技术应用型企业、技术模仿型企业
表面贴装	两边或四边引线封装	SOP、PLCC、QFP、QFN、DFN 等	市场容量大，保持平稳	以技术应用型企业为主
	面积阵列封装	WLCSP、BGA、LGA、CSP 等	市场较大，增长速度较快	以技术应用型企业为主
高密度封装		3D 堆叠、TSV 等	市场正处于起步阶段	以技术创新型企业为主

当前，技术应用型企业保持自身在传统主流产品领域成本领先、工艺创新优势的同时，也逐步加大了对先进封装技术如BGA、CSP、WLCSP、TSV、3D堆

叠等的研发力度，逐步掌握先进产品技术，从而保证在未来市场变化时能顺应产品趋势，抓住新市场机会。

（五）行业竞争状况

1、全球竞争状况

集成电路产业诞生于美国，并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来，但是随着产业的技术进步和市场发展，封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地区转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区，也是目前全球最大的集成电路封装测试基地，中国大陆位居其次。2012年全球前10大集成电路专业封装测试企业中，中国台湾企业有5家，新加坡企业2家，我国内资企业长电科技已居全球第8位。

表：2012 全球前十大集成电路专业封测企业

单位：亿美元

排名	公司名称	封测收入	地区
1	日月光（ASE）	43.87	中国台湾
2	安靠科技（Amkor）	27.60	美国
3	矽品精密（SPIL）	22.29	中国台湾
4	星科金朋（STATSChipPAC）	17.02	新加坡
5	力成科技（PTI）	14.35	中国台湾
6	J-devices	9.56	日本
7	优特半导体（UTAC）	9.08	新加坡
8	长电科技（JCET）	7.03	中国大陆
9	南茂科技（ChipMOS）	6.62	中国台湾
10	欣邦科技（Chipbond）	5.21	中国台湾

数据来源：IC insights

2、国内竞争状况

1995年之前国内半导体封装行业主体一直由无锡华晶、华越、首钢NEC等晶圆制造企业内部的封测线和江苏长电、南通富士通、华天科技等国内独立封测企业组成。但1995年以来，随着Freescale（飞思卡尔）、Intel（英特尔）、ST（意法半导体）、Renesas（瑞萨）、Spansion（飞索半导体）、Infineon（英飞凌）、Samsung（三星）、Fairchild（飞兆半导体）、NS（美国国家半导体）等众多国际大型半导体企业来华建立封装测试基地，国内封装测试行业的产量和销售额大幅增长，外资企业开始成为封装测试行业的主要力量。2013年IC封装测试前十大

企业中，我国内资企业仅占据3席：

表：2013 年国内 IC 封装测试收入前 10 名企业

单位：亿元

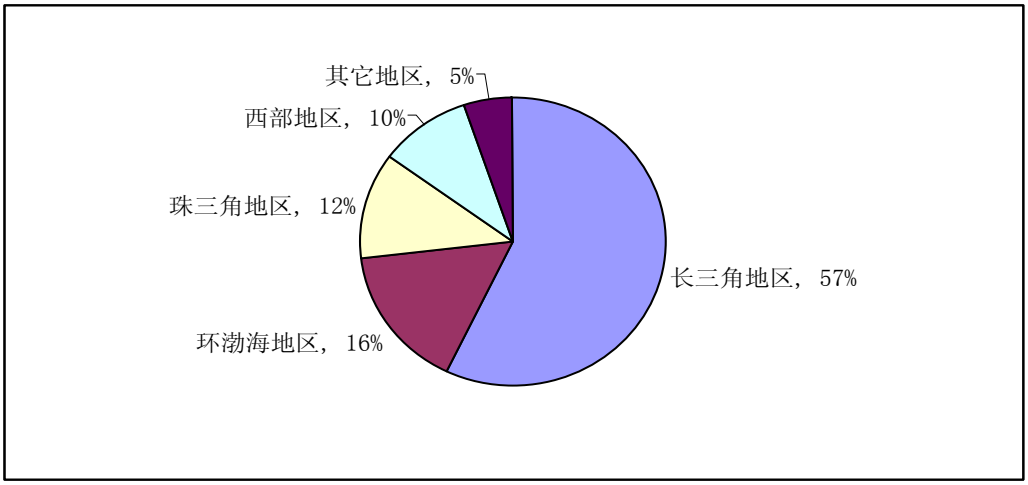
排名	公司名称	销售收入	业务模式	性质
1	江苏新潮科技集团有限公司	77.2	专业封测服务商	内资
2	飞思卡尔半导体（中国）有限公司	66.3	IDM	外资
3	威讯联合半导体（北京）有限公司	56	专业封测服务商	外资
4	英特尔产品（成都）有限公司	51.4	IDM	外资
5	南通华达微电子集团有限公司	45.4	专业封测服务商	内资
6	天水华天电子集团有限公司	35.4	专业封测服务商	内资
7	海太半导体（无锡）有限公司	32.6	专业封测服务商	外资
8	日月光封装测试有限公司（含上海、杭州）	28.0	专业封测服务商	外资
9	上海松下半导体有限公司	27.7	IDM	外资
10	上海凯虹科技有限公司	27.6	专业封测服务商	外资

资料来源：《中国半导体封装测试产业调研报告（2013 年度）》，2014 年 5 月

注：长电科技为江苏新潮科技集团有限公司的控股子公司

但是经过多年的技术创新和市场积累，内资企业产品正由DIP、SOP、SOT、QFP、QFN/DFN等产品向BGA、CSP、MCM、MEMS、Flip-Chip、TSV等技术更先进型产品发展，并且产量与规模不断提升，尤其是内资领先企业如长电科技、华天科技等上市公司借助资本市场近年来取得快速发展，逐步缩小了与外资厂商的差距，也极大地带动了我国封装测试行业的发展。

图：2013 年国内集成电路产业销售收入地域分布



数据来源：中国半导体行业协会

从区域分布来看，我国封装测试企业主要分布在长江三角洲地区、京津环渤海地区和珠江三角洲地区。其中，长江三角洲地区集成电路产业起步最早、基础雄厚，2013年产业销售额占全国份额达57%，其次京津环渤海地区占比16%，以

深圳为核心的珠三角地区是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，虽然起步较晚，但受益于本地芯片设计企业迅猛增长和强劲市场需求带动，发展速度领先全国区域，2013年占全国比重增至12%，未来将继续释放巨大的发展潜力。

从企业综合实力来看，可以将国内封装测试厂商分为三个梯队，具体如下表所示：

表：国内集成电路封装测试企业类别

类型	主要特征	主要优势	代表厂商
第一梯队	规模大、综合实力强、引领行业技术和产品创新，外资企业以 BGA、CSP、WLCSP、Flip-Chip、MEMS、Bumping、TSV 等为主，内资企业仍以 DIP、SOP、BGA 等产品为主	技术、市场和资金优势	飞思卡尔（中国）、英特尔（成都）、日月光（上海）、深圳赛意法、长电科技、华天科技和通富微电等
第二梯队	规模中等、具备一定的技术实力，专注于技术应用和工艺创新，以 DIP、SOT、SOP、QFP、QFN/DFN 等系列产品为主，逐步向 BGA、CSP、Flip-Chip、TSV 等先进产品延伸	精细化生产管理、产品性价比优势	以气派科技为代表的中等规模企业
第三梯队	规模小、技术或生产管理能力弱，主要以 TO、DIP 等低端产品为主	无明显优势	数量众多的中小型企业

（六）行业利润水平及变动趋势

集成电路封装测试企业的利润水平不仅与集成电路产业的景气状况相关，而且与企业自身的产品结构、技术实力、成本控制能力和质量管理水平等因素有紧密相关。

当前以移动互联网、云计算、物联网、节能环保为代表的战略性新兴产业快速发展，成为推动集成电路产业发展的新动力。我国作为全球集成电路增长最快和需求最大的市场区域，未来几年集成电路产业将继续稳步增长，并给封装测试企业带来良好的发展空间。

由于封装成本为电子类产品成本重要组成部分，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，封装产品价格遵循电子类产品价格变动一般规律，其定型产品总体呈现稳步下降趋势。因此，对于封装企业来说，其为了保持较为稳定利润水

平，主要采取两方面措施：一是通过生产工艺创新、原材料改进和精细化的生产管理，以及规模化生产效应来降低成本；另一方面通过产品升级，逐步向高附加值的先进封装产品转型。

（七）进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

集成电路封装测试行业属于技术密集型行业，摩尔定律反映了封装测试技术更新换代快的特征。半导体行业摩尔定律指出，单位面积芯片上集成的晶体管数每隔18个月增加一倍，其背后驱动力是行业对高性能、低功耗芯片的不断需求，并导致芯片不断小型化，同时从降低芯片流片成本、节约电路板空间考虑也要求芯片面积缩减。

封测企业需要不断进行技术创新、开发新产品才能适应市场变化，顺应集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化的发展趋势。封装领域不断涌现出新兴封装类型以及先进封装技术，这对于封装测试企业在新产品的研发和测试方面提出了苛刻的要求，技术门槛越来越高。

此外，行业的技术壁垒还体现在工艺制程上，如对引线框的创新设计、金线改为铜线焊接技术、合金线焊接技术等，而技术和工艺的创新来源于企业长期的技术攻关和大规模的生产经验积累，对新进入者而言形成了较高的壁垒。

2、资金壁垒

集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，一方面封测企业为了确保产品高品质需要投入大量资金购买先进封装测试设备，如装片机、键合机、塑封机、自动切筋成型系统和检测设备等，这些设备大部分要从国外进口，价格昂贵；另一方面由于封装技术更新换代快，产品类型较多，需要封测企业持续地投入较多资金进行技术创新、产品研发和设备更新换代。

3、生产管理经验壁垒

集成电路封装测试行业竞争的关键要素是技术工艺创新和成本控制，对生产管理水平要求较高。由于封装测试行业产品种类繁多，企业为了节约投入、提高设备利用率，往往需在不同产品线共用设备，这就要求企业建立快速灵活的生产

模式，在市场需求变化时迅速转换生产线、调试生产设备，快速组织不同类型产品的生产。在此基础上，企业还必须保证产品的质量和性能符合各项标准，这就对企业生产组织能力和质量控制水平提出了严格的要求。

此外，企业要想在行业中生存或建立竞争优势，必须在对封装测试的工艺流程深刻理解的基础上进行改良与创新，以提高生产效率和原材料利用率，降低生产成本，而快速组织生产线、工艺改良和创新都是建立在长期的生产实践的积累和管理经验的总结上，新进入者在短期内难以实现。

4、人才壁垒

我国集成电路产业起步较晚，本土人才培养和积累不足，懂技术和管理的人才比较稀缺。集成电路封装测试行业属于技术密集型产业，需要大量的新产品开发人才、工艺创新人才以及熟练的一线技术操作工人和生产管理人才。部分有技术优势和历史沉淀的封装测试企业可以通过内部的人才培养建立起稳固的人才队伍，保证企业技术创新和业务发展所需的人才资源，而新进入者从外部引进人才的难度较大。

5、认证壁垒

随着我国封装测试行业的逐步成熟，行业的竞争更加激烈，封装测试企业在取得客户尤其是大型客户或国外客户的订单时，需要经过严格的认证，包括对内部生产管理流程、质量管理体系的审查、公司产品可靠性和供货能力的评估等，认证时间短则数月、长则数年，新进入者难以在短期内形成销售规模。

（八）影响本行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策逐步完善

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性产业，是电子信息产业的核心。我国政府一直以来高度重视集成电路产业的发展，相继出台了多项支持性政策措施，如《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《鼓励软件产业和集成电路产业发展的六项措施》、《集成电路产业“十二五”发展规划》和《国家集成电路产业发展推进纲要》等。这一系列政策的出台不仅保持了

对集成电路产业支持的长期性、连续性，而且支持力度越来越大，产业政策也越来越完善，为我国集成电路产业的进一步发展提供了坚实的保障。

（2）市场前景持续向好

近年来，以智能手机、平板电脑等为主的移动终端产品爆发式增长，成为产业发展的重要支撑；而新一代网络通信、物联网、云计算、节能环保等新兴产业的快速发展，成为推动集成电路产业发展的新动力。

作为全球电子产品制造大国和消费大国，我国集成电路产业规模虽增长快速，大量产品仍依赖进口，未来无论是国内需求增长潜力还是进口替代空间都非常大。据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》预计，到“十二五”末，集成电路产业规模将再翻一番以上，集成电路产量超过1,500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。

（3）国内技术与国际先进水平差距逐步缩小

近年来，我国集成电路封装测试技术不断取得突破，本土封装测试企业已逐渐掌握了全球领先厂商的先进技术，如铜制程技术、BGA、PGA、WLP、MCM、MEMS、TSV、Bumping技术等，并且在应用方面也逐步成熟，部分先进封装产品已实现批量出货。国内封装技术与国际领先技术的差距越来越小，为推动我国封装测试行业继续做大做强奠定了牢固的基础。

（4）本土设计业崛起为行业带来新机遇

封装测试行业为我国集成电路发展设计业和制造业打下了良好的产业基础，同时，由于我国着力加强对IC设计公司的支持力度，推动我国IC设计业实现了高速增长，近几年设计业成为集成电路产业中增长最快的环节。根据GSA公布的2012年全球前20大IC设计业企业名单，我国本土企业海思半导体位居第15名，本土IC设计业的崛起为本土封装测试企业提供了新的发展空间。

2、不利因素

（1）行业景气状况受国际经济波动影响较大

自2007年以来，全球集成电路产业越来越表现出受国际经济形势波动影响的

特征，尤其近几年受美国次贷危机和欧洲债务危机等影响，行业销售增长性波动和产品价格波动较大，由此对国内企业造成较大的冲击，尤其是对于成本控制能力不足、质量管理水平不高的小规模企业来说，生存压力更大。

（2）支撑性行业发展滞后

当前，我国集成电路支撑性产业发展相对滞后，尤其是关键设备、关键材料几乎无法自给。集成电路封装测试所需的减薄机、划片机、装片机、键合机、分选机、测试机等主要设备均主要从日本、荷兰、美国和中国香港等地引进，封装材料如基板、塑封树脂、引线框等也主要从日本、德国、美国和中国香港等地进口。

（九）行业技术水平及发展趋势

自集成电路产业诞生开始，封装技术不断进步，已经历三个阶段的技术更新，具体如下：

第一阶段是1980年之前的通孔插装(THD)时代。这个阶段技术特点是插孔安装到PCB上，主要技术代表包括TO（晶体管外形）和DIP（双列直插封装），其优点是结实、可靠、散热好、布线和操作较为方便，缺点是电路功能较少，封装密度及引脚数难以提高，难以满足高效自动化生产的要求。

第二阶段是1980年代开始的表面贴装（SMT）时代，该阶段技术的主要特点是引线代替针脚，由于引线为翼形或丁J形，从两边或四边引出，较THD插装形式可大大提高引脚数和组装密度。最早出现的表面贴安装类型以两边或四边引线封装为主，主要技术代表包括SOT(小外形晶体管封装)、SOP（小外形封装）、QFP（四边翼型引线方扁平封装）等。采用该类技术封装后的电路产品轻、薄、小，提升了电路性能。性价比高，是当前市场的主流封装类型。

在电子产品趋小型化、多功能化需求驱动下，20世纪末期开始出现以焊球代替引线、按面积阵列形式分布的表面贴装技术。这种封装的I/O是以置球技术以及其它工艺把金属焊球（凸点）矩阵列式的分布在基板底部，以实现芯片与PCB板等的外部连接。该阶段主要的封装形式包括球状栅格阵列封装（BGA）、芯片尺寸封装（CSP）、晶圆级芯片封装（WLP）、多芯片封装（MCP）等。BGA等技术的成功开发，解决了多功能、高集成度、高速低功耗、多引线集成电路电路芯片的封装问题。

第三阶段是21世纪初开始的高密度封装时代。随着电子产品进一步向小型化和多功能化发展，依靠减小特征尺寸来不断提高集成度的方式因为特征尺寸越来越小而逐渐接近极限，以3D堆叠、TSV（硅穿通孔）为代表的三维封装技术成为继续延续摩尔定律的最佳选择。其中3D堆叠技术是把不同功能的芯片或结构，通过堆叠技术，使其在Z轴方向上形成立体集成和信号连通以及圆片级、芯片级、硅帽封装等封装和可靠性技术为目标的三维立体堆叠加工技术，用于微系统集成。TSV是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通孔，实现芯片之间互连的最新技术。与以往IC封装键合和使用凸点的叠加技术不同，三维封装技术能够使芯片在三维方向堆叠的密度最大，外形尺寸最小，大大改善芯片速度和低功耗的性能。

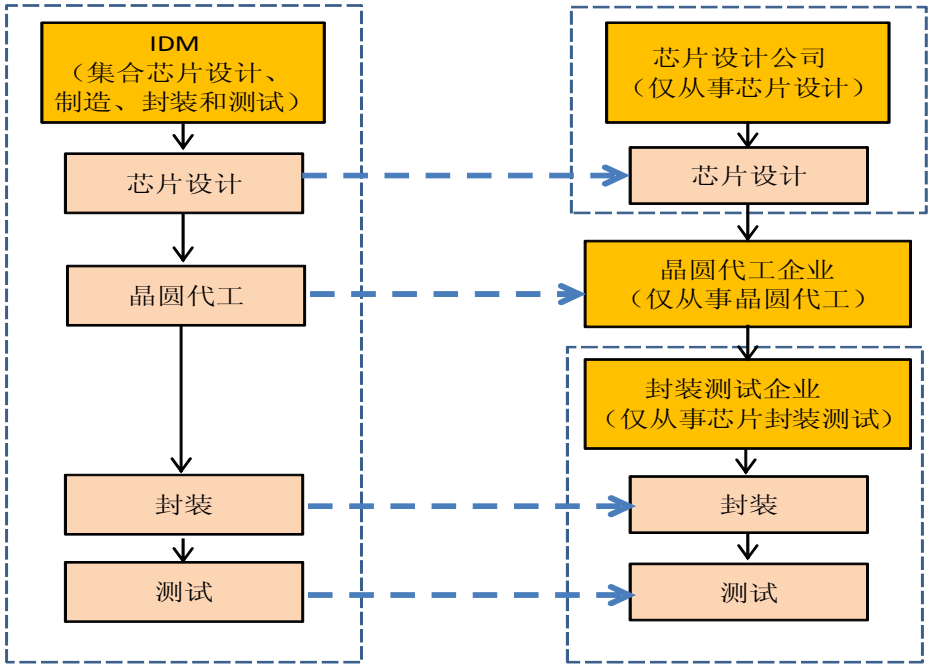
3D叠装、TSV等三维封装技术，由于封装成本、工艺成熟度、实用性等因素影响，仅在部分特殊领域少量应用。目前全球集成电路主流封装技术还处在第二阶段。封装测试技术现阶段的应用范围及代表性产品如下表所示：

应用类型	产品名称	采用的封装技术
计算机类	手提电脑、平板电脑、显示屏、打印机、鼠标、硬盘等	SOP、SOT、QFP/LQFP、BGA、QFN/DFN、WLCSP、FC、MCM、CSP、TSV
通讯电信类	手机、蓝牙产品、交换机、储存卡、智能手环、智能手表等	SOP、SOT、QFP/LQFP、TSSOP、BGA、QFN/DFN、CSP、WLCSP、FC、MCM、SIP、TSV
消费电子类	电视、空调、电冰箱、电吹风、微波炉、吸尘器、学习机等家用及学习电子用品等	TO、DIP、BGA、SOP、QFP/LQFP、QFN/DFN、TSSOP、GBA、CSP、SIP
汽车电子类	汽车整流器、汽车音响、汽车空调、ABS 控制器、导航系统、行车记录仪、倒车雷达等	SOT、TSSOP、QFP/LQFP、BGA、FC、QFN/DFN
工业自动化系统	光机电一体、工业电子整流器、变频器、机器人、高清摄像头等	SSOP、QFP/LQFP、TSSOP、BGA、WLCSP、MCM、TSV
照明电路	调光灯、节能灯、智能开关等	SSOP、QFN/DFN、TSSOP
电源电器类	UPS（不间断电源）、计算机电源、充电器等	TO、DIP、SOT、SOP、QFN/DFN、BGA

（十）行业特有的经营模式

集成电路封装测试行业的经营模式主要包括两大类：一类是从事集成电路设计、芯片制造、封装测试到销售业务为一体的垂直整合制造商（Integrated Device Manufacturing），称为IDM模式，另一类是专业分工模式，即芯片设计、晶圆制

造、封装测试各自独立生产运营。专业分工的模式，有利于产能资源整合，实现产能资源的优化配置。一方面是产能利用率的提高带来半导体行业生产成本的降低，另一方面则是专业分工产品多样化有利于分散下游终端产品需求变化带来的产品需求结构的变化。



随着集成电路产业技术进步和产品更新换代加快，市场竞争日益激烈，资金门槛不断提高，产业链分工的趋势愈加明显，专业分工模式逐步显现出在加快产业技术进步、降低经营风险、促进企业快速增长方面的优势，专业分工模式将成为未来的发展方向。

（十一）行业的周期性、季节性、区域性特征

1、周期性

集成电路的发展基本上按照摩尔定律演进，产业的技术、市场也呈现周期性的波动。业界普遍认为硅材料的加工极限是10纳米线宽，受物理原理的制约，小于10纳米后不太可能生产出性能稳定、集成度更高的产品，因而芯片更新换代的周期会放慢。未来集成电路的技术、市场周期性波动也会逐渐趋缓，这也是产业经历几十年高速增长之后的正常调整。事实表明，随着全球集成电路市场规模的不断扩大，2005年以后行业呈现出整体温和增长、受宏观经济影响小幅波动的特征，周期性越来越弱。尤其是我国集成电路产业受政府强有力的政策支持和巨大

的电子产品市场需求驱动，产业呈现高速稳步增长的态势，我国集成电路产业的周期性并不明显。

2、季节性

过去较长一段时间以来，集成电路产业表现出一定的季节性特征，即上半年略显淡季，下半年尤其是第四季度为旺季，主要原因在于终端电子产品消费集中在下半年。但是，随着集成电路产品需求的多元化、应用领域越来越广的外部因素以及行业发展逐渐成熟，企业通过调整产品库存水平、合理利用产能、低价采购原材料、提前生产备货等内部因素影响，市场季节性特征逐步减弱。

3、区域性

全球半导体封装产业主要集中在亚太地区，从事封装的国家或地区主要是中国台湾、马来西亚、中国大陆、菲律宾、韩国和新加坡。从国内来看，从事半导体封装测试的企业集中在长三角、环渤海及珠三角地区。长三角地区是目前我国集成电路设计、制造和封装测试企业最密集的区域，产业基础较好，产业链完善；珠三角地区是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，目前其在区域产值的比重具有提升的潜力；中西部地区由于成本优势、当地政府大力扶持和产业环境得到持续改善，对于集成电路产业的投资吸引力也明显提高。

（十二）所处行业与上下游之间的关联性

1、主要上下游行业

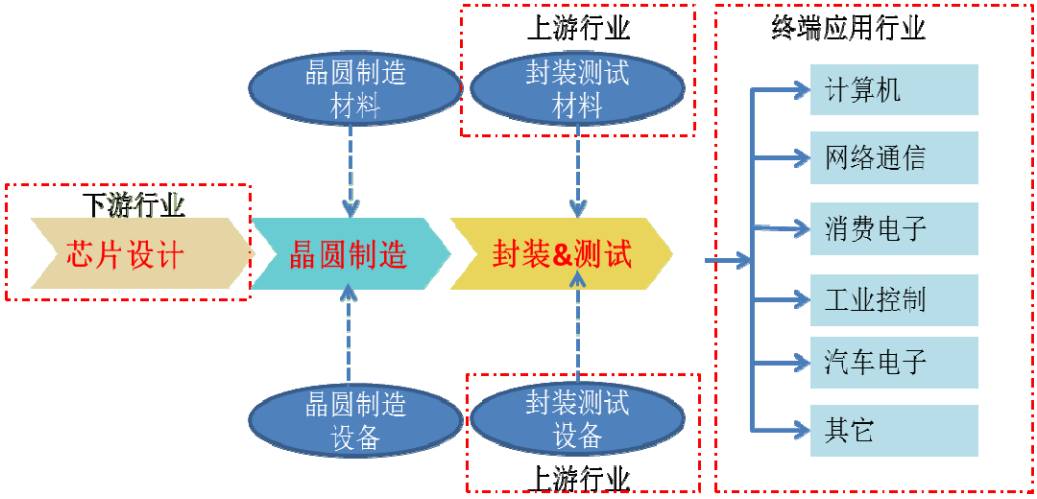
经过几十年的发展，集成电路产业由最初的大产业模式逐渐分离成集成电路行业、集成电路制造设备业和材料业，随后集成电路行业内部又进行产业链分工，划分为芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节，目前三大环节均已发展成独立的子行业。

从集成电路行业的经营模式分析，集成电路产业以芯片设计为源头和主导，由芯片设计商根据市场需求设计出集成电路版图，然后由芯片制造商生产晶圆，再委托封装测试厂商进行封装和测试，之后将芯片产品销售给电子整机产品制造商，最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。另外，还有一种较常见的模式是部分不具备设计能力或设计能力较弱的芯片设计公司，对

于大众、通用的集成电路产品，该类公司通过向专业IC设计公司购买方案，然后委托芯片制造商生产晶圆，再委托封装测试厂商进行封装和测试，之后将芯片产品销售给电子整机产品制造商。

因此，集成电路封装测试行业的直接客户是芯片设计公司，对应的下游行业是芯片设计业；直接供应商是提供封装测试所需原材料的材料供应商和提供封装测试设备的设备供应商，对应上游行业是集成电路生产设备业和材料业。集成电路封装测试上下游行业如下图所示：

图：集成电路封装测试上下游行业



2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联

（1）上游行业对本行业的影响

上游封装材料制造业为本行业提供引线框架、金线、铜线、装片胶和塑封树脂等原材料，上述原材料供应影响本行业产品生产，原材料价格波动影响本行业产品生产成本。目前，塑封树脂、装片胶等原材料供应充足，价格波动较小，公司已经与汉高华威等供应商建立了稳定的合作关系，能保证原材料的稳定供应。

近年来，金线价格随黄金价格波动而波动较大，公司金线采购根据上海期货市场当日黄金现货交易开盘价作为交易计价标准，但由于公司应用金线的产品比重较低，少于20%，因此黄金价格波动对公司影响不大。

尽管引线框、铜线的价格受银和铜的价格波动影响，但随着引线框、铜线生产工艺改进以及规模化生产效应，近年来该类原材料价格整体呈稳步下降的趋势。

此外，在封装测试设备和引线框架方面，公司已与行业领先的引线框生产商康强电子和设备商香港太平洋科技（ASM）、三佳等建立了长期的战略合作关系，并合作开发高密度矩阵引线框，定制相应配套创新工艺的生产设备。

（2）下游行业对本行业的影响

封装测试行业的经营状况和发展环境直接受芯片设计行业和终端电子整机产品销售的影响。终端用户对电子整机产品的需求决定了对芯片设计的要求，从而促进封装测试行业的技术进步和产品创新。由于集成电路及其电子整机产品应用面广、占国民经济比重高，从更高层面上讲，集成电路产业受宏观经济波动影响较大并保持一致的变化趋势。近年来，受益于智能手机、平板电脑、网络电视、物联网等新兴产业的迅猛增长，全球集成电路产业市场规模不断扩大，产业整体呈稳步增长的态势。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）行业地位

公司在集成电路直插封装和贴片封装产品领域具有突出的成本控制和质量管理领先优势，是国内封装技术应用型的代表企业之一。

自成立以来，公司不断引进国际先进的生产设备，持续加大研发投入和工艺创新，凭借核心管理团队丰富的技术研发和生产管理经验，取得了一系列创新成果。公司自主研发了取得国家发明专利的全新封装形式Qipai系列产品，其在封装兼容性、性价比和产品轻薄化方面均有重大突破。公司拥有IDF型高密度大矩阵引线框技术、大电流低饱和压降TrenchMOS生产工艺、铜制程技术、合金线制程技术、塑封模具流道优化技术等重要工艺技术创新，在保证或提高封装产品性能的同时提高了封测效率，降低了生产成本，各项指标符合国际认证及环保标准。

自2006年成立以来，公司业务增长迅猛，先后与华润赛美科、深圳华芯邦、杭州士兰微、深圳励创微、深圳南翔等企业建立了稳固的合作伙伴关系，在产品质量、交货期、专业服务等方面赢得了客户的高度认可。2013年公司集成电路封装测试达到29.10亿只的年产量，营业收入达到2.84亿元。据中国半导体行业协会的数据显示，2013年公司封测业务收入位列中国封装测试业第29名、内资封装测试企业第5名，公司业已发展成为华南地区技术工艺领先、产品系列相对齐全、

产销量规模最大的内资集成电路封装测试企业（数据来源：《2013年度中国IC封装测试产业调研报告》，中国半导体行业协会封装分会，2014年5月）。

（二）公司的竞争优势

1、人才与技术工艺创新优势

公司的核心技术团队和管理团队多数拥有15年以上集成电路技术研发和生产管理经验，尤其是公司研发中心主任及创始人拥有近30年的集成电路技术研发和市场营销经验，公司已经建立了一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队。截至2014年6月底，公司拥有研发技术人员237人，占比25.82%。

公司成功研发了IDF型高密度大矩阵引线框技术、塑封模具流道优化技术、大电流低饱和压降TrenchMOS生产工艺、铜制程技术和银合金线制程技术等，使得原材料利用率提高、生产效率提升、人员工时减少、能耗降低。公司的技术创新成果显著，已取得授权专利56项，其中发明专利1项，实用新型专利55项。

虽然目前公司的产品主要为引线框封装，基板封装、晶圆封装领域有待进入，与竞争对手华天科技、长电科技等上市公司相比存在一定差距。但是，随着持续稳定的研发投入以及与科研机构的合作，公司不断向先进封装产品进行延伸，已经具备了批量生产国内技术比较先进的QFN/DFN产品的能力；通过与香港应用科技研究院有限公司合作研制出了BGA样品，并掌握了Flip-Chip技术，目前BGA处于前期生产的准备阶段。

2、生产组织与质量管理优势

集成电路封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括DIP、HDIP、Qipai、SOP、ESOP、SSOP、TSSOP、SOT、TO、MSOP、EMSOP、LQFP、HSOP、QFN、DFN等。2013年公司集成电路封装量达到29.10亿只，齐全的产品线为公司赢得客户和建立市场优势发挥了重要作用，但不同的产品类型往往需要不同生产工艺和设备，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，培养了200多名经验丰富的研发技术人员和一大批生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划

和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量控制制度，并于2010年5月通过了ISO9001:2008质量管理体系与ISO14001:2004环境管理体系认证。

3、规模优势

足够的产能规模以及大批量、高品质供货的能力，是芯片设计公司选择长期合作伙伴的重要考虑因素。为建立在国内封装测试行业的规模优势，公司持续投资进行了产能的扩充和技术改造，最近三年一期公司累计资本性支出22,383.17万元，不仅提升了公司技术层级，亦使得产能和销售规模得到有效增加，巩固和提升了公司在行业内的地位。

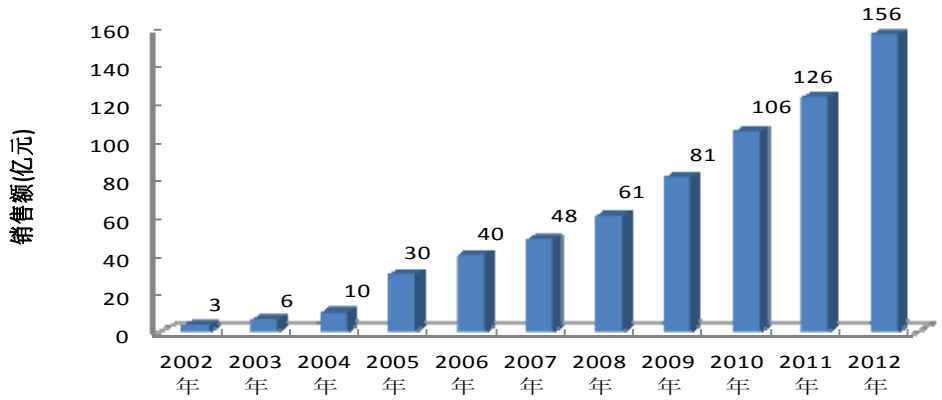
公司虽然较上市公司华天科技、长电科技起步晚，但是自2006年设立以来集成电路封装测试业务一直保持高速增长。根据2013年中国境内封测业收入排名，公司在内资封装测试企业中排名第5，公司业已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业。

4、地域优势

集成电路芯片设计企业对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约资金成本、及时应对来自客户的随机性和突发性需求，增强其竞争力。公司充分发挥地处珠三角和深圳的地域优势进行重点开拓，通过上门接送货物等服务方式节约运输时间和成本，加深了与客户的交流和反馈。

目前，珠三角地区是中国电子产品制造基地和进出口集散地，集成电路市场需求一直占据全国的40%以上。依托发达的电子整机制造业，近年来该地区的集成电路设计业发展迅速，在国内集成电路产业中所占比重也逐年上升。随着珠三角地区集成电路发展潜力的逐步释放，产业配套的逐步完善，区域的发展优势将进一步突显。其中，深圳2012年主要集成电路设计公司境内外销售合计约156.29亿元，同比增长24%。

深圳集成电路设计企业 2002～2012 年销售额变化情况



数据来源:中国半导体行业协会（CSIA）《中国半导体产业发展报告（2006－2012）》

（三）公司的竞争劣势

1、公司规模相对较小

作为行业的后进入者，公司的规模与行业已上市公司长电科技、华天科技等相比仍然较小，公司的资产规模在一定程度上制约了业务的扩张。公司迫切需要加大资金投入促进技术创新，扩大业务规模，以适应不断增长的市场需求。

2、资金不足限制公司发展

封装测试行业属于资金密集型和技术密集型行业，公司需要不断加大投入购买先进的生产设备，研发新的封装技术和生产工艺，才能不断抢占市场，巩固竞争优势。然而，公司运营资金主要来源于自身的积累及部分银行贷款，与国内已上市的同行业公司相比，融资渠道较窄，融资能力和规模有限。尽管公司现金流运转良好，财务结构比较健康，但是随着业务和规模的不断扩大，公司需要扩建新的生产基地。同时，公司需要持续和足够的研发创新资金来开拓高端产品，资金不足制约了产品种类的延伸拓展和产业化进度，已经成为限制公司快速发展和规模化经营的主要瓶颈。公司亟需资金来扩大生产规模、提升技术层级，进一步增强公司的综合实力。

（四）主要竞争对手

1、长电科技

江苏长电科技股份有限公司专注于半导体封装测试业务，为海内外客户提供芯片测试、封装设计、封装测试等全套解决方案。公司的产品包括分立器件、引

线框封装、基板封装和封装材料4大类，封装产品有TO、SOD、SOT、FBP、QFN、QFP、SIP、SOP、DIP、PDFN、PQFN、MIS、MSD、SIM、USB、LGA、BGA、WL-CSP、BUMP等系列，公司于2003年在上海主板成功上市，成为国内首家半导体封测上市公司，现已拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站，是国家重点高新技术企业、高密度集成电路国家工程实验室依托单位及集成电路封装技术创新战略联盟的理事长单位。（资料来源：企业网站）

2、华天科技

天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月。公司主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。封装测试产品有DIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP、LQFP、MCM（MCP）、MEMS、BGA、LGA、SiP、TSV-CSP等系列185个品种。公司是我国西部地区最大的集成电路封装基地、甘肃省微电子骨干龙头企业和富有创新精神的现代化高新技术企业。华天科技于2007年11月在深圳证券交易所成功发行上市。（资料来源：企业网站）

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品用途

公司封装产品主要包括DIP、HDIP、Qipai、SOP、ESOP、SSOP、TSSOP、SOT、TO、MSOP、EMSOP、LQFP、HSOP、QFN、DFN等。

公司封装产品主要应用于消费电子、电源电器、通讯电信、照明电路、工业自动化系统等多种领域。

（二）封装技术及生产工艺流程

1、发行人使用的封装技术

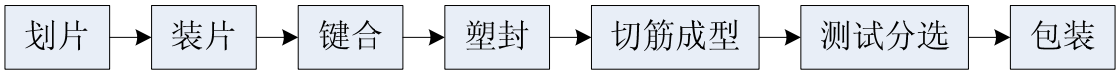
公司生产经营所使用的封装技术主要集中在直插封装和两边或四边引线封装，目前正在向球栅阵列封装（BGA）方向延伸发展。

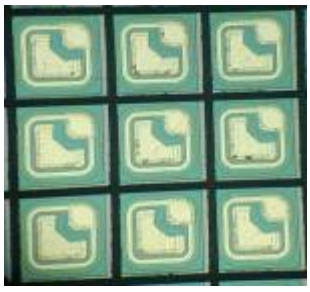
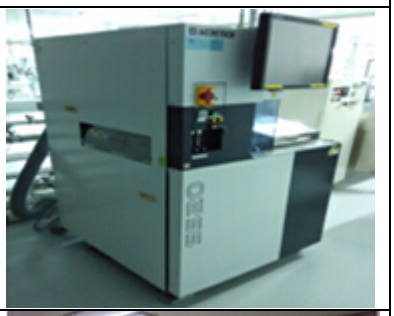
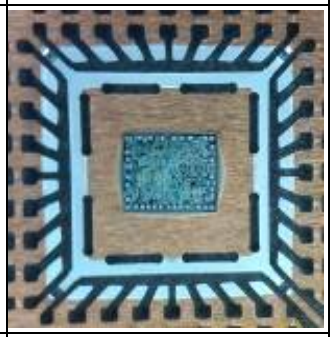
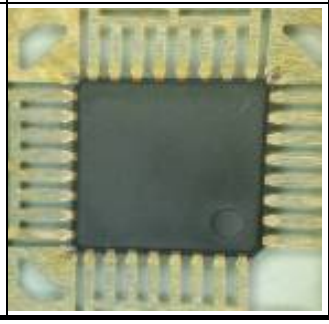
作为封装测试领域的后进入者，面对我国封测市场基本被外资和合资封测企业占据的情况，公司主要采取技术跟进策略，并充分利用后发优势，降低新技术开发带来的不确定风险。通过加大研发力度以及与科研机构的合作，公司已经具备了批量生产国内技术比较先进的QFN、DFN产品的能力，并且研制出了BGA

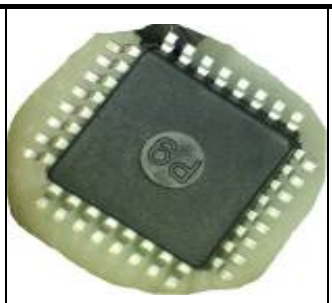
样品、掌握了Flip-Chip技术，目前正在进行BGA前期生产的准备工作。随着资本实力的增强、研发投入的持续增加以及募投项目的建设，公司将逐步布局进行先进封装技术的研发和拓展，提升技术层级、制造规模和品牌形象。

2、发行人的生产工艺流程

发行人封装测试的生产工艺流程主要步骤如下所述：



制程名称	主要制程	制程主要内容	主要设备选例
制程 1：划片		将整片 wafer 切割为单粒的芯片	
制程 2：装片		将芯片装贴在框架基岛上，并控制装贴位置和偏移量	
制程 3：键合		使用金丝/铜丝将芯片 PAD 与框架引脚连接，使芯片信号/功能与外部连接	
制程 4：塑封		使用塑封料将产品芯片/焊丝包裹保护，不受外力和环境破坏	

制程 5：切筋成型		将产品从整条框架上分离成型为单粒产品	
制程 6：测试分选		测试产品的电性能指标，将测试良品与不良品分类并包装	

（三）主要经营模式

公司为专业封装测试企业，主要由客户提供芯片，公司自行采购原辅料并按照用户要求对其进行封装测试后将成品交还客户，公司向委托方收取加工费，生产使用的原材料主要包括引线框架、铜线、金丝、装片胶和塑封树脂等。

1、采购模式

公司设置采购部统一负责所需原辅材料的集中采购，对于主要原辅材料，公司定期与合作供应商进行洽谈，认定合格供应商的资格、确定主要供应商并签署意向性采购框架协议。具体采购时，采购部根据计划部确定的物料需求计划，制定采购计划并向供应商下达采购订单。

2、生产模式

公司作为专业封装测试厂商，所生产的产品主要系按照客户的要求定制，属于以销定产的定制化生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织生产。由于客户对产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求，在生产过程中，生产部根据客户认定的产品规格及功能要求，设计、生产样件，并提交客户认定。经客户最终认定后，制定生产计划表进行批量生产。

3、销售模式

公司客户主要为芯片设计公司，芯片设计公司根据市场需求设计出集成电路版图，其本身无芯片制造工厂和封装测试厂，芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装测试，之后芯片设计公司将芯片产品销售给电子整机产品制造商，最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。

公司与客户建立合作关系时，通常会签署框架合同，具体的委托加工事项一般由客户每期发送的订单确定。集成电路封装属于充分竞争的行业，公司产品价格通常由公司与客户在市场价格的基础上协商确定。

（四）发行人主营产品的产能、产量、销量情况

1、主要产品或服务产销情况

年度	项目	产能（万只）	产量（万只）	销量(万只）	销售收入（万元）
2011 年	封装测试	164,350.60	154,445.26	153,132.35	18,965.00
2012 年	封装测试	257,490.85	244,804.01	235,044.05	24,251.26
2013 年	封装测试	323,554.80	291,028.64	291,458.29	27,308.18
2014 年 1-6 月	封装测试	181,578.03	135,033.85	129,513.09	12,375.49

（1）报告期内公司封装测试设备产能利用率情况

2011年-2014年1-6月，公司产能利用率分别为93.97%、95.07%、89.95%和74.37%。2013年和2014年1-6月，公司产能利用率较低，原因是公司无自有生产厂房，2013年公司开始在东莞购买土地进行募投项目建设，为了避免厂房建成后集中搬迁导致的生产中断、人员大幅流失等不利影响，公司在募投项目用地附近租赁厂房并将部分生产工序逐步搬迁。由于公司需要进行跨地区生产管理，以及存在设备安装调试、老员工流失以及新聘员工技能培训等问题，导致生产效率下降，单位生产成本上升，产能利用率亦随之下降。

（2）报告期内，公司封装测试公司产销率情况

2011年-2014年1-6月，公司产销率分别为99.15%、96.01%、100.15%和95.91%，始终维持在95%以上，保持了相对较高的水平。

2、产品内销和外销情况

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	12,336.74	99.69%	27,258.44	99.82%	24,246.66	99.98%	18,965.00	100%
外销	38.75	0.31%	49.74	0.18%	4.60	0.02%	-	-

公司产品主要以内销为主，外销占比很低，一方面是由于我国是目前全球最大的半导体消费市场，我国半导体市场需求额在2012年已突破全球50%的比重，达到54.1%；另一方面，以深圳为核心的珠三角地区由于是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，集成电路设计公司将封装和销售环节放在深圳，通过销售环节的快速反应能力，能够更紧密的与客户联系。

3、前五大客户销售情况

报告期内，公司向前五大客户销售的情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入比
2014 年 1-6 月	1	深圳市励创微电子有限公司	871.68	6.76%
	2	深圳市南翔科技有限公司	692.02	5.36%
	3	上海普芯达电子有限公司	690.35	5.35%
	4	深圳市环宇微电子有限公司	472.22	3.66%
	5	上海晟矽微电子股份有限公司	370.22	2.87%
	小计		**3,096.49**	**24.00%**
2013 年	1	深圳市励创微电子有限公司	2,161.46	7.61%
	2	深圳市南翔科技有限公司	1,909.51	6.73%
	3	深圳市华芯邦科技有限公司	1,737.09	6.12%
	4	深圳市馨晋商电子有限公司	1,471.87	5.18%
	5	华润赛美科微电子（深圳）有限公司	1,102.21	3.88%
	小计		**8,382.13**	**29.52%**
2012 年	1	深圳市华芯邦科技有限公司	2,412.34	9.26%
	2	深圳市励创微电子有限公司	2,346.91	9.01%
	3	深圳普达芯电子有限公司	1,567.96	6.02%
	4	深圳市爱矽电子有限公司	1,478.82	5.68%
	5	深圳市环宇微电子有限公司	1,468.25	5.64%
	小计		**9,274.27**	**35.61%**
2011 年	1	深圳市环宇微电子有限公司	1,786.58	9.19%
	2	深圳市励创微电子有限公司	1,451.88	7.47%
	3	深圳市南翔科技有限公司	1,433.03	7.37%
	4	北京燕东微电子有限公司	1,390.47	7.15%
	5	华润赛美科微电子（深圳）有限公司	840.91	4.33%
	小计		**6,902.87**	**35.51%**

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过50%的情况，也不存在严重

依赖少数客户的情况。

公司前五大客户中不存在受同一实际控制的情形，公司与上述客户不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份股东在上述其他客户中持有股份的情形。

（五）发行人主要原材料、能源供应情况

1、主要原材料供应情况

公司生产所需主要原材料为引线框架、铜线、金丝、装片胶、塑封树脂等。

2、主要能源供应

公司生产所需的主要能源包括水、电，公司自设立以来，以上能源的供应均保持稳定。

3、报告期内公司主要原材料以及能源平均采购价格变动情况

（1）原材料采购单价

材料名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
引线框（元/只）	0.0178	0.0167	0.0193	0.0238
铜线（元/米）	0.1288	0.1415	0.1218	0.1243
金丝（元/米）	1.53	1.62	1.83	1.82
合金线（元/米）	0.2731	0.5187	0.6195	0.7581
树脂（元/千克）	27.32	26.37	25.95	24.01
装片胶（元/克）	10.16	10.47	10.32	8.62

注：以上价格不含税

（2）能源采购单价

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
水（元/吨）	2.33	3.05	2.90	2.22
电（元/度）	0.67	0.68	0.66	0.63

注：以上价格不含税

4、产品主要原材料所占成本比例

项目	原材料		能源	
	金额（万元）	占主营业务成本比重（%）	金额（万元）	占主营业务成本比重（%）
2011 年度	8,548.20	61.88%	513.62	3.72%
2012 年度	9,372.74	56.30%	814.53	4.89%
2013 年度	10,334.94	52.33%	919.11	4.65%
2014 年 1-6 月	4,630.03	46.54%	504.29	5.07%

注：以上价格不含税

5、向前五名供应商合计采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的具体情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占比	采购内容
2014年1-6月	1	宁波康强电子股份有限公司	1,118.81	12.47%	丝材、引线框
	2	进峰贸易（深圳）有限公司	570.47	6.36%	引线框
		先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司	385.88	4.30%	设备
	3	深圳市宝裕华实业有限公司	472.91	5.27%	电镀加工费
	4	深圳市供电局有限公司	373.56	4.16%	电费
	5	汉高华威电子有限公司	348.12	3.88%	树脂
	小计		**3,269.75**	**36.44%**	
2013年	1	先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司	3,679.65	16.47%	设备、备件
		进峰贸易（深圳）有限公司	1,931.68	8.65%	引线框
		ASMPacific(HongKong)Limited	677.70	3.03%	设备
	2	宁波康强电子股份有限公司	2,466.09	11.04%	丝材、引线框
	3	深圳市供电局有限公司	983.75	4.40%	电费
	4	汉高华威电子有限公司	969.79	4.34%	树脂
	5	铜陵三佳山田科技股份有限公司	754.90	3.38%	设备、备件
		铜陵丰山三佳微电子有限公司	75.83	0.34%	引线框
	小计		**11,539.38**	**51.65%**	
2012年	1	宁波康强电子股份有限公司	3,380.17	15.99%	丝材、引线框
	2	先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司	2,425.88	11.48%	设备、备件
		进峰贸易（深圳）有限公司	1,324.71	6.27%	引线框
		ASMPacific(HongKong)Limited	1,059.58	5.01%	设备、备件
	3	汉高华威电子有限公司	1,366.96	6.47%	树脂
	4	华越微电子有限公司	821.46	3.89%	芯片集成电路
	5	铜陵三佳山田科技股份有限公司	794.93	3.90%	设备、备件
		铜陵中发三佳科技股份有限公司	169.66	0.80%	设备
		铜陵富仕三佳机械有限公司	74.57	0.35%	设备
		铜陵丰山三佳微电子有限公司	52.65	0.25%	引线框
	小计		**11,470.56**	**54.40%**	

2011年	1	宁波康强电子股份有限公司	3,431.40	19.92%	丝材、引线框
	2	ASMPacific(HongKong)Limited	2,201.36	12.78%	设备、备件
		先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司	659.85	3.83%	设备
		进峰贸易（深圳）有限公司	444.68	2.58%	引线框
	3	汉高华威电子有限公司	1,568.90	9.11%	树脂
	4	宁波埃斯科光电有限公司	953.80	5.54%	引线框
	5	铜陵三佳山田科技有限公司	729.14	4.23%	设备、备件
		铜陵富仕三佳机械有限公司	54.27	0.32%	设备
		铜陵丰山三佳微电子有限公司	32.94	0.19%	引线框
	小计		**10,076.35**	**58.48%**	

注：ASMPacific(HongKong)Limited、先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司、进峰贸易（深圳）有限公司受香港上市公司ASMPacificTechnologyLimited同一控制；铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵中发三佳科技股份有限公司、铜陵富仕三佳机械有限公司、铜陵丰山三佳微电子有限公司受铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司同一控制。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。

（六）环境保护与安全生产

公司所处半导体封装测试行业，该行业不属于高危险、重污染行业，且公司已将芯片的减薄划片工艺及金属表面处理工艺全部外包代工，从源头降低或控制整个生产过程对环境的影响，日常生产经营过程中产生的废水、废气也较少。

尽管如此，公司历来非常重视安全生产与环境保护，建立了一套完备的安全生产管理控制制度和环境保护制度，并通过了SO14001:2008版环境管理认证。公司严格控制废水排放，将生产过程产生的废旧物资集中存放妥善处理；对噪音污染源采取严格的隔音、隔离措施。公司生产过程中排放的废气、废水和厂界噪声均达到国家规定的排放标准，未受到环保部门的处罚。

根据深圳市龙岗区环境保护和水务局于2014年8月25日出具的《环境保护守法情况说明》【深龙环水监（2014）02057号】，“经核查，该公司自2011年1月1日至2014年6月30日期间没有行政处罚的记录”。

根据东莞市环境保护局石排分局于2014年8月12日出具的《证明》，“兹证

明广东气派科技有限公司自设立之日（2013年5月22日）起至今一直按照国家有关环境保护法律、法规、规章的规定从事生产经营活动，未曾出现环境污染事故和环境违法行为，不存在因违反有关环境保护的法律、法规、规章而受到行政处罚的情形。”

五、固定资产及无形资产

（一）固定资产

1、固定资产基本情况

截至2014年6月30日，公司固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	折旧年限（年）	原值	净值	成新率
机械设备	10	21,580.00	15,988.18	74.09%
通用设备	5	2,244.26	1,132.33	50.45%
其他设备	5	552.11	426.57	77.26%
运输工具	5	198.64	102.47	51.59%

公司的固定资产使用状况良好，不存在闲置、报废等减值情形。

2、主要生产设备

按照生产工艺划分，公司各生产环节的关键固定资产情况如下：

单位：万元、台

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	账面净值	数量	账面净值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量
键合设备	6,978.10	267	7,433.83	267	5,721.21	197	4,184.59	139
装片设备	3,677.27	65	3,593.63	61	3,044.56	49	2,261.92	36
塑封设备	795.02	31	822.29	30	878.2	30	774.49	22
切筋成型设备	1,417.13	31	1,514.57	31	1,379.18	29	1,200.91	26
测试设备	348.04	25	368.66	25	267.62	17	169.74	10
合计	**13,215.57**	**419**	**13,732.98**	**414**	**11,290.77**	**322**	**8,591.65**	**233**

3、房屋建筑物

报告期内，气派科技生产经营用厂房、员工宿舍均为向无关联第三方租赁取得，具体情况如下：

序号	合同名称	租赁期限	出租方	承租情况	该物业是否有房屋所有权证
1	深圳市房屋	自 2011.6.1	谭石周、谭	发行人承租厂房位于深圳市龙	是

	租赁合同书	至 2015.5.31	彬	岗区平湖街道禾花社区平新大道 165 号恒顺厂区 1 栋 1 楼 105 号、2-5 楼，面积为 5,162.12m^2，月租金为 95,912 元。	
2	宿舍租赁协议书*	自 2014.3.1 至 2015.12.31	深圳市金涛物业管理有限公司	发行人承租宿舍位于深圳市龙岗区平湖街道平新北路 166-1 号宿舍楼三楼、四楼，共计 18 间宿舍，月租金为 14,400 元。	否
3	宿舍租赁协议书*	自 2014.4.1 至 2015.12.31	深圳市金涛物业管理有限公司	发行人承租宿舍位于深圳市龙岗区平湖街道平新北路 166-1 号宿舍楼二楼，共计 3 间宿舍，月租金为 2,400 元。	否
4	厂房租赁合同及其补充协议	自 2013.4.1. 至 2018.3.31	东莞华盛音响制品有限公司	广东气派承租厂房位于东莞市石排镇福隆村第二工业区的建筑面积为 9,725.7m^2 的电子厂 B 和建筑面积为 4,547.6m^2 的干部宿舍，2014 年 10 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日每月租金为 142,733 元，2015 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 31 日每月租金为 149,869.65 元，2017 年 5 月 1 日以后每月租金为 157,006.3 元。	是
5	厂方租赁合同	自 2011.10.1 至 2014.2.28	李小军	深圳市龙岗区平湖街道同富路 4 号厂房，厂房面积 5,150m^2，宿舍面积 2,250m^2，月租金 11.45 万元，租期至 2016 年 9 月，双方于 2013 年底签署协议确定在 2014 年 2 月底终止租赁关系。	否

*注：上述两处宿舍租赁房产均未办理房屋所有权证，出租方在《宿舍租赁协议书》中承诺：金涛物业保证该房屋产权清楚，没有纠纷，若发生与出租方有关的产权纠纷或其他债务，概由出租方负责清理；给承租方造成损失的，出租方负责赔偿。

（二）无形资产

1、发行人的商标情况

截止本招股说明书签署日，公司正在使用或申请的商标情况如下：

序号	商标	注册号	注册类别	有效期限	注册地	取得方式	他项权利
1	Qipai16	10645113	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
2	Qipai8	10645114	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
3	Qipai	10645115	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
4	Qipai	10645117	第 9 类	2013.11.28-2023.11.27	中国	自行申请	无

5	气派	10645118	第 9 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
6	Chippacking	10645128	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
7	气派16	10645129	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
8	气派8	10645130	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
9	气派	10645131	第 40 类	2013.5.14-2023.5.13	中国	自行申请	无
10	Chippacking 气派科技	11232782	第 40 类	2013.12.14-2023.12.13	中国	自行申请	无
11	Chippacking 气派科技	11232783	第 9 类	2013.12.14-2023.12.13	中国	自行申请	无
12	Chippacking 气派科技	11232784	第 40 类	2013.12.14-2023.12.13	中国	自行申请	无
13	Chippacking 气派科技	11232785	第 9 类	2013.12.14-2023.12.13	中国	自行申请	无
14	Chippacking 气派科技	11232786	第 40 类	2013.12.14-2023.12.13	中国	自行申请	无
15	Chippacking 气派科技	11232787	第 9 类	2013.12.14-2023.12.13	中国	自行申请	无

2、发行人的专利、软件著作权情况

（1）专利

截止招股说明书签署日，公司已获得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利期限	取得方式	他项权利
1	SOP8 封装引线框结构	实用新型	ZL200920206377.7	2009.10.28	2009.10.28-2019.10.27	自行申请	无
2	一种交叉型 DIP8 引线框结构	实用新型	ZL200920206379.6	2009.10.28	2009.10.28-2019.10.27	自行申请	无
3	TSSOP8 封装引线框结构	实用新型	ZL200920206378.1	2009.10.28	2009.10.28-2019.10.27	自行申请	无
4	一种 TSSOP6 引线框结构	实用新型	ZL200920206376.2	2009.10.28	2009.10.28-2019.10.27	自行申请	无
5	集成电路封装中引线框及基岛结构	实用新型	ZL200920206287.8	2009.10.30	2009.10.30-2019.10.29	自行申请	无
6	一种交叉型 DIP14 引线框结构	实用新型	ZL200920260034.9	2009.11.03	2009.11.03-2019.11.02	自行申请	无
7	一种 DIP 封装芯片引线框及其封装模具	实用新型	ZL201020103532.5	2010.01.22	2010.01.22-2020.01.21	自行申请	无
8	一种多排集成	实用	ZL201020103490.5	2010.01.22	2010.01.22-	自行	无

	电路引线框	新型			2020.01.21	申请	
9	8 引脚高密度集成电路封装结构	实用新型	ZL201120420138.9	2011.10.28	2011.10.28-2021.10.27	自行申请	无
10	14 引脚高密度集成电路封装结构	实用新型	ZL201120420678.7	2011.10.28	2011.10.28-2021.10.27	自行申请	无
11	16 引脚高密度集成电路封装结构	实用新型	ZL201120420128.5	2011.10.28	2011.10.28-2021.10.27	自行申请	无
12	一种高密度集成电路封装结构、封装方法以及集成电路	发明	ZL201110334691.5	2011.10.28	2011.10.28-2031.10.27	自行申请	无
13	一种新型引线框结构	实用新型	ZL201120441367.9	2011.11.08	2011.11.08-2021.11.07	自行申请	无
14	一种 IDF 型大矩阵 SOP14 引线框结构	实用新型	ZL201120490221.3	2011.11.29	2011.11.29-2021.11.28	自行申请	无
15	一种 IDF 型大矩阵 SOP16 引线框结构	实用新型	ZL201120490228.5	2011.11.29	2011.11.29-2021.11.28	自行申请	无
16	一种 DIP10 集成电路器件及引线框、引线框矩阵	实用新型	ZL201120509407.9	2011.12.08	2011.12.08-2021.12.07	自行申请	无
17	一种多芯片双基岛的 SOP 封装结构	实用新型	ZL201220360665.X	2012.07.25	2012.07.25-2022.07.24	自行申请	无
18	芯片封装中的塑封模具的引线框架预热设备	实用新型	ZL201220401178.3	2012.08.14	2012.08.14-2022.08.13	自行申请	无
19	一种集成电路 EMSOP10 封装的引线框架结构	实用新型	ZL201220472476.1	2012.09.17	2012.09.17-2022.09.16	自行申请	无
20	一种 MSOP8 封装的引线框架结构	实用新型	ZL201220472202.2	2012.09.17	2012.09.17-2022.09.16	自行申请	无
21	芯片封装的 DIP8 双基岛压板治具	实用新型	ZL201220450798.6	2012.09.06	2012.09.06-2022.09.05	自行申请	无
22	一种测试编带机封压模块	实用新型	ZL201220566304.0	2012.10.31	2012.10.31-2022.10.30	自行申请	无
23	SOP8 芯片封装的塑封体的塑封模具	实用新型	ZL201220400443.6	2012.08.14	2012.08.14-2022.08.13	自行申请	无
24	切筋成型系统中的下料助推	实用新型	ZL201220735119.X	2012.12.28	2012.12.28-2022.12.27	自行申请	无

	器						
25	塑封压机的自动门控系统	实用新型	ZL201220727694.5	2012.12.26	2012.12.26-2022.12.25	自行申请	无
26	一种 MSOP10 集成电路封装的引线框架结构	实用新型	ZL201320117487.2	2013.03.15	2013.03.15-2023.03.14	自行申请	无
27	一种 EMSOP8 集成电路封装的引线框架结构	实用新型	ZL201320117474.5	2013.03.15	2013.03.15-2023.03.14	自行申请	无
28	一种用于芯片封装中键合焊线机器上的治具	实用新型	ZL201320247847.0	2013.05.09	2013.05.09-2023.05.08	自行申请	无
29	集成电路封装切筋工艺中减少产品开裂的模具	实用新型	ZL201220726952.8	2012.12.26	2012.12.26-2022.12.25	自行申请	无
30	集成电路封装中焊线设备下料部防叠料机构	实用新型	ZL201220736455.6	2012.12.28	2012.12.28-2022.12.27	自行申请	无
31	一种液氨瓶内压力控制系统	实用新型	ZL201320467701.7	2013.08.02	2013.08.02-2023.08.01	自行申请	无
32	一种液氨泄漏自动喷淋水及报警系统	实用新型	ZL201320467670.5	2013.08.02	2013.08.02-2023.08.01	自行申请	无
33	可靠性高的框架引线键合治具	实用新型	ZL201320564160.X	2013.09.12	2013.09.12-2023.09.11	自行申请	无
34	框架引线键合治具	实用新型	ZL201320564154.4	2013.09.12	2013.09.12-2023.09.11	自行申请	无
35	框架引线键合治具	实用新型	ZL201320625640.2	2013.10.11	2013.10.11-2023.10.10	自行申请	无
36	ESOP8 集成电路封装的引线框结构	实用新型	ZL201320625326.4	2013.10.11	2013.10.11-2023.10.10	自行申请	无
37	SOP28 集成电路封装的引线框结构	实用新型	ZL201320625324.5	2013.10.11	2013.10.11-2023.10.10	自行申请	无
38	SSOP20 集成电路封装的引线框结构	实用新型	ZL201320625573.4	2013.10.11	2013.10.11-2023.10.10	自行申请	无
39	SSOP24 集成电路封装的引线框结构	实用新型	ZL201320625299.0	2013.10.11	2013.10.11-2023.10.10	自行申请	无
40	芯片封装的高周波塑封料预热机报警电路	实用新型	ZL201320809246.4	2013.12.10	2013.12.10-2023.12.09	自行申请	无

41	球型排水阀	实用新型	ZL201320670975.6	2013.10.29	2013.10.29-2023.10.28	自行申请	无
42	照明光源延迟关闭控制装置	实用新型	ZL201320671088.0	2013.10.29	2013.10.29-2023.10.28	自行申请	无
43	供水水泵停水自动停机保护装置	实用新型	ZL201320671528.2	2013.10.29	2013.10.29-2023.10.28	自行申请	无
44	消防警铃局部报警控制装置	实用新型	ZL201320721218.7	2013.11.15	2013.11.15-2023.11.14	自行申请	无
45	中央空调湿膜加湿装置	实用新型	ZL201320721134.3	2013.11.15	2013.11.15-2023.11.14	自行申请	无
46	散热循环水异常处理装置	实用新型	ZL201320721047.8	2013.11.15	2013.11.15-2023.11.14	自行申请	无
47	一种基于框架的无载体式单圈封装件	实用新型	ZL201320185278.1	2013.03.29	2013.03.29-2023.03.28	受让取得	无
48	一种基于框架的无载体式多圈封装件	实用新型	ZL201220425693.5	2012.08.18	2012.08.18-2022.08.17	受让取得	无
49	防止 MSOP 封装集成电路的滑道堵料的下料装置	实用新型	ZL201420102214.5	2014.03.07	2014.03.07-2024.03.06	自行申请	无
50	集成电路的双基岛 7 引脚结构及切筋模具	实用新型	ZL201420102257.3	2014.03.07	2014.03.07-2024.03.06	自行申请	无
51	集成电路的双基岛 7 引脚引线框结构	实用新型	ZL201420101959.X	2014.03.07	2014.03.07-2024.03.06	自行申请	无
52	一种减少集成电路 DIP 封装报废的下料结构	实用新型	ZL201420110035.6	2014.03.12	2014.03.12-2024.03.11	自行申请	无
53	一种高密度 QFN 封装引线框	实用新型	ZL201420205257.6	2014.04.25	2014.04.25-2024.04.24	自行申请	无
54	一种基于框架腐蚀凸点的无载体式新型封装件	实用新型	ZL201220479169.6	2012.09.19	2012.09.19-2022.09.18	受让取得	无
55	一种基于框架采用键合线连接技术的封装件	实用新型	ZL201320335198.X	2013.06.10	2013.06.10-2023.06.09	受让取得	无
56	一种基于框架采用镀银技术的封装件	实用新型	ZL201320335457.9	2013.06.10	2013.06.10-2023.06.09	受让取得	无

（2）软件著作权

截止本招股说明书签署日，公司取得的软件著作权情况如下：

序号	编号	名称	开发完成日	取得方式
1	2013SR038072	TESTOS 软件[简称：TESTOS]V2.0	2012.10.01	自主研发

3、土地使用权

公司子公司广东气派科技有限公司通过出让方式获得1宗工业用地使用权，位于东莞市石排镇福隆村，面积为66,670.10平方米，土地证号为东府国用（2014）第特112号，终止日期为2064年3月16日。

六、特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。

七、发行人的技术与研究开发情况

（一）主要产品的生产技术水平

集成电路封装测试行业属于高度标准化的行业，各种形式的封装产品是标准化的，行业的创新主要体现为生产工艺上的创新，技术水平主要体现为产品加工的工艺水平。生产工艺的创新和技术水平主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和研究开发，需要持续的生产经验的积累。

通过持续稳定的投入，公司核心技术人员及研发团队在总结过去多年的研发、生产、加工经验的基础上取得了如下核心技术：IDF型高密度大矩阵引线框技术、大电流低饱和压降Trench MOS生产工艺、铜制程技术、塑封模具流道优化技术、银合金线制程技术等，其中部分已申请了专利。截至招股说明书签署日，已取得授权专利56项，其中发明专利1项，实用新型专利55项。

1、IDF型高密度大矩阵引线框技术

引线框架的宽度受制于装片机的作业距离、焊线机的有效焊接范围、塑封工艺、切筋成型、应力叠加等，公司通过技术攻关，研发出IDF大矩阵框架，提高了引线框的利用率，有效地降低了成本。

IDF型高密度大矩阵引线框技术的应用成倍地提高了芯片排列的密度，减少了单只芯片所占材料的面积，使公司的原材料耗用相比较改进前大幅降低，塑封、切筋环节的生产效率有效提高，同时相应降低了人工成本，公司就上述技术申请

取得了专利。

2、塑封模具流道优化技术

公司在模具设计环节对传统流道进行了创新设计，普通塑封流道，每模的树脂用量较少，但每模封装的产品数量也少。公司改进了塑封过程中增加了树脂用量，每模封装的产品数量更多，从而节约了单个产品上树脂的用量，大大降低封装成本。

3、大电流低饱和压降Trench MOS生产工艺

公司开发了Trench MOS封装技术，通过大电流的粗铜线连接技术、低电阻的芯片粘结技术、低应力的薄芯片封装技术、高可靠性的低漏电流技术等先进的封装工艺技术，有效地保证Trench MOS集成电路的可靠性、稳定性等。该技术已在实际生产过程中应用，确保公司在为客户提供生产高性价比优质产品的同时提升自身盈利空间。

4、铜制程技术

在集成电路封装中，金丝作为主结构材料占据成本比重较高，且金价市场波动会对产品成本造成很大影响。公司在2007年小批量生产时就着手开发研究铜线焊接工艺，采用铜线代替金线进行焊接具有性价比优势，且电学性能、热学性能以及机械性能好等特性，但是铜线易被氧化且其硬度和屈服强度等物理参数高于金和铝，键合时需要更大的超声能量和键合压力，因此对焊点铝层厚度及表面结构有一定的要求。公司攻克了铜球硬、可焊性差的难点，成功开发了粗铜线生产工艺。

5、银合金线制程技术

虽然公司已经在规模生产中进行铜线焊接技术，为了进一步减少金线的用量，公司决定开发银线焊接技术。由于引线框架大部分都是镀银框架，合金线主要成分是银，与镀银框架的第二焊点性能比较好，银线的性能虽然很好，但是一直没有被用在集成电路封装焊线上，原因如下：一方面银线焊接时和芯片的铝垫形成的金属化合物，在电流的作用下会产生电迁移现象而形成空洞，影响可靠性；另一方面，银线在电火花的作用下形成银球，会发生氧化反应，降低了可焊性。为此，公司将纯银线改成银合金线，有效解决了银-铝合金元素的迁移问题，并在焊接时使用惰性混合气体，解决了氧化问题。公司在保证产品质量的前提下，

有效提高了键合效率、降低了生产成本。

（二）正在从事的产品研发项目情况

公司正在从事的研发项目情况如下表所示：

序号	项目名称	进展状况
1	QFN 新产品开发	批量生产阶段
2	SOT23 12R 产品开发	小批量试产阶段
3	TSOT23 12R 新产品开发	试产阶段
4	DFN 新产品开发	批量试产阶段
5	BGA 新产品开发	掌握相关生产技术及工艺并完成打样
6	高功率平板显示驱动 IC 封装技术解决方案	批量生产阶段
7	Flip- chip 封装技术	已掌握相关技术

（三）研发经费占营业收入的比例

公司每年投入研究开发费用进行新产品、新技术的开发，以下为公司报告期内投入的研发经费及占比情况：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
销售收入	12,904.61	28,395.48	26,039.82	19,437.91
研发费用	605.99	1,229.34	1,187.50	1,246.15
研发费用占比	4.70%	4.33%	4.56%	6.41%

（四）技术创新机制

公司设有研发中心，主导新技术、新产品的研究和开发。为提高开发部门的主动性，公司建立了研发创新的奖励制度，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新活动，取得了显著的成效。

公司项目研发主要流程如下：（1）研发中心根据市场需求确立研发项目；（2）研发项目立项前，设立项目组，项目组由项目负责人和成员组成，主要包含研发、制程、设计工程师；（3）项目负责人项目作市场和技术的调研，与客户沟通，了解客户的要求，确定项目的可行性；立项后，给出技术方案，制订进度表；（4）工艺开发完成后，由小批量逐渐过渡到量产，最终完成项目的研发。

（五）合作研发情况

2014年6月3日，公司与香港应用科技研究院有限公司（以下简称“香港应科院”）签署《技术合作开发及许可协议》，约定由香港应科院与公司在集成电路封

装测试领域进行研发合作，并以开发BGA和Flip-chip产品及研发相关技术作为双方合作的起点。香港应科院向公司提供10项交付技术及合作开发成果及服务，许可公司及其子公司广东气派科技有限公司在中国内地使用许可技术进行产品生产和销售；前述10项交付技术及合作开发成果中第3项三维封装技术（含有嵌入式主动和被动元器件并以BGA的形式进行封装）和第6项三维封装技术（含有嵌入式主动和被动元器件并以Flip-chip的形式进行封装）相关的知识产权为香港应科院所有，其余第1、2、4、5、7-10项技术（包含基于仿真芯片、功能芯片以BGA形式的先进封装技术以及基于仿真芯片、功能芯片以Flip-chip形式的先进封装技术及样品等）相关的知识产权为公司所有。公司应向香港应科院支付许可费、使用费和服务费，其中：许可费总额为人民币50万元，根据第3项和第6项技术项目进程分三期支付；使用费=每项最终产品“封装加工费”单价×每项最终产品封装加工数量×该项相应使用费收费率（使用费收费率根据第3项和第6项技术最终产品的累计封装加工净额确定）；服务费总额为人民币90万元，根据第1、2、4、5、7-10项技术项目进程分五期支付。本协议自签订之日起生效，有效期为五年。

八、发行人主要产品的质量控制情况

（一）质量控制标准

公司主营业务为集成电路封装测试，赢得客户的基础是可靠的产品质量、较低的成本和便捷的服务，公司将质量视为企业的立足之本，并通过严格质量标准、有效执行质量控制措施等手段建立和完善质量控制体系。本公司在企业内部推行国际质量认证，2010年分别通过了ISO14001:2008环境管理体系和ISO9001：2008质量体系认证。

（二）质量控制措施

为确保公司芯片封装测试质量符合要求，公司严格按照GB/T19001-2008ISO-9001:2008质量管理体系的标准要素要求，并结合公司的实际工作情况，制定有效保证质量体系运行的程序文件作业标准/指导书和管理规范，包括《材料规范》、《不合格品标准》、《芯片进料检验规范》、《DB参数稽核表（工艺标准）》、《装片作业指导书》、《键合作业指导书》等。公司将ISO9001国际标准规定的管理原则和方法贯穿于公司质量管理体系的整个过程，通过有效执行质量体系文

件，使已建立的质量管理体系有效运行并得到持续改进。公司还成立了专门的质量管理部门—品质部，负责产品生产的全过程质量控制。

1、供应商管理的质量控制

公司严格选择供应商管理，制定了《供应商评比管理程序》，每季度对公司供应商进行一次评价，并提供《供应商评比表》，由采购部将供应商评估资料备档，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的产品及获得来自供应商满意的综合服务。

2、来料检验的质量控制

公司对原材料及辅助性材料、外协加工半成品进行检验或测试，确保产品符合规定的品质要求。公司品质部按《进料检验程序》负责制定物料检验清单，完成原物料的进料检查、测试及结果判定，检验物料状态标识，如果出现异常产品则将情况反馈给供应商，并跟踪供应商改善状况。

3、生产过程的质量控制

各生产车间负责生产过程中自检与互检,对生产过程中的半成品、成品进行检验和试验，以确保生产工艺和产品符合性得到有效控制，并及时识别不良品，避免流入下道工序或非预期交付。工艺工程部负责工艺文件及工艺参数的制定，并对产线品质异常原因分析和品质改善跟进；品质部负责进料检验、生产过程中产品首检、巡检、批检及入库检验，制程品质异常问题的处理，对产品制程进行质量控制。

4、出厂前的质量控制

公司在成品出厂前按规定进行检验测试，确保经检验测试的成品满足规定的质量要求。品质部依据OQC检验规范进行检验，并填写OQC抽检记录表。品质部OQC对检验合格产品，在内外包装箱上指定位置盖章，对库存安全周期大于6个月的成品，必须进行再次OQC检验，并填写OQC抽检记录表，合格后方可办理出货；检验不合格的，需通知生产部进行返工处理。

5、售后服务过程的质量控制

公司通过定期的客户走访，了解客户需求和期望，关注客户动向；通过顾客

满意度调查，对客户反馈的信息进行统计分析，确定客户满意度趋势，找出差距，针对存在的问题采取适当的纠正措施，更好地满足客户要求。

（三）质量纠纷情况

报告期内，公司不存在因为产品违反质量和技术方面的标准而受到政府部门处罚的情形。

九、境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在通过子公司等方式从事境外经营的情况。

十、冠名“科技”的依据

公司为国家级高新技术企业，据中国半导体行业协会的数据显示，在2013年中国境内封测业收入排名中，公司封测业务收入排名第29，在内资封装测试企业中排名第5，公司业已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业，是我国内资集成电路封装测试服务商中少数具备较强的质量管理、工艺创新控制能力的技术应用型企业之一。公司在技术创新和产品开发上取得了多项成果，目前拥有获得国家知识产权局授权的专利56项，因此公司名称含有“科技”字样。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

公司主营业务为集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案。截至招股说明书签署日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况。

（一）同业竞争情况

公司控股股东梁大钟及其控制的企业目前未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

实际控制人梁大钟、白瑛夫妇及其控制的企业目前未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

（二）避免同业竞争的承诺及约束措施

为避免未来发生同业竞争，维护公司的利益并保证公司的长期稳定发展，从而更好地维护中小股东的利益，公司实际控制人梁大钟、白瑛分别出具了《关于避免同业竞争与利益冲突的承诺及约束措施》。具体承诺内容详见本招股书“第五节 公司基本情况”之“十、（五）、关于避免同业竞争的承诺”部分。

二、关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所颁布的相关业务规则中的有关规定，截至本招股说明书签署日，公司的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东和实际控制人

公司控股股东为梁大钟，持有本公司70.07%的股份。公司的实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇，直接持有本公司股份合计占公司总股本的84.86%。

（二）控股股东、实际控制人控制的除本公司以外的其他企业

实际控制人梁大钟、白瑛夫妇于2001年4月9日投资设立了深圳市天光集成电

路有限公司，该公司于2012年12月12日注销。公司注销前的基本情况如下：

公司名称	深圳市天光集成电路有限公司		
成立日期	2001.4.9		
法定代表人	梁大钟		
注册资本	300 万元		
公司住所	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道 165 号恒顺厂区 1 栋 3 楼 301、303 房		
经营范围	集成电路的设计及销售，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）		
股东及持股比例	梁大钟	270.00 万元	占比 90.00%
	白瑛	30.00 万元	占比 10.00%
	合计	**300.00 万元**	**占比 100%**

（三）公司的子公司

气派科技于2013年5月22日投资设立了全资子公司广东气派，截至本招股说明书签署日，广东气派情况如下：

公司名称	广东气派科技有限公司
成立日期	2013.5.22
法定代表人	梁大钟
注册资本	6,100 万元
住所	东莞市石排镇福隆第二工业区二路
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：集成电路的研发、测试封装、设计、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及与其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的具体情况详见“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

（五）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

公司监事周建斌持有深圳市乐智康电子有限公司60%的股权，并担任该公司的董事长及总经理。截至本招股说明书签署日，深圳市乐智康电子有限公司目前的基本情况如下：

企业名称	深圳市乐智康电子有限公司
住所	深圳市南山区西丽街道松坪街 3 号松坪村竹苑 9 栋 508

法定代表人	周建斌
认缴注册资本总额	50 万元
实缴注册资本总额	0 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电子产品的销售，国内贸易，经营电子商务。
成立日期	2014 年 2 月 11 日
注册号	440301108782476
登记机关	深圳市市场监督管理局
股东情况	周建斌持有 60%的股权；夏祥富持有 25%的股权；刘鲜花持有 15%的股权

三、关联方交易

（一）经常性关联交易

报告期内，公司及其前身气派有限与关联方经常性关联交易主要为向关联方销售货物，定价原则为按市场价格定价。

报告期内，公司与关联方发生的销售情况如下：

单位：万元

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
天光集成	-	-	-	-	41.06	0.16%	-	-

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司及其前身气派有限与关联方发生的偶发性关联交易如下：

1、关联租赁

2011年6月9日，气派有限与天光集成签署《房屋租赁合同》，约定将其位于深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道165号恒顺厂区1栋3楼301、303房（房屋编码为：4403070010121100019）出租给天光集成使用，租赁面积为60平方米，租金为1,080元/月，租赁期限自2011年6月5日至2015年5月31日。天光集成已于2012年12月办理注销登记，该租赁合同实际履行期限为2011年6月5日至2012年8月31日。

2、采购二手车

2012年6月25日，气派有限与天光集成签署《车辆转让协议》，约定天光集成将其自有的一辆车牌号为粤BLW792的富迪牌小汽车转让给气派有限，转让价

格为10,000元。

3、关联担保

报告期内，公司关联方为公司的银行借款等债务提供担保，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保合同	担保金额	主合同	主债权人	备注
梁大钟	公司	《保证担保合同》深发上步保字第20100903001 号	600	《贷款合同》深发上步贷字第20100903001 号	深圳发展银行股份有限公司深圳上步支行	担保责任已解除
梁大钟	公司	《保证担保合同》深发上步保字第20110322001-1 号	1,000	《贷款合同》深发上步贷字第20110322001 号	深圳发展银行股份有限公司深圳上步支行	担保责任已解除
白瑛	公司	《保证担保合同》深发上步保字第20110322001-2 号	1,000	《贷款合同》深发上步贷字第20110322001 号	深圳发展银行股份有限公司深圳上步支行	担保责任已解除
白瑛	公司	《最高额不可撤销担保书》2011 年龙字第0011608910-1 号	2,300	《授信协议》2011 年龙字第0011608910 号	招商银行股份有限公司深圳横岗支行	担保责任已解除
梁大钟	公司	《最高额不可撤销担保书》2011 年龙字第0011608910-2 号	2,300	《授信协议》2011 年龙字第0011608910 号	招商银行股份有限公司深圳横岗支行	担保责任已解除
白瑛	公司	《保证担保合同》深发上步保字第20111213001-1 号	800	《贷款合同》深发上步贷字第20111213001 号	深圳发展银行股份有限公司深圳上步支行	担保责任已解除
梁大钟	公司	《保证担保合同》深发上步保字第20111213001-2 号	800	《贷款合同》深发上步贷字第20111213001 号	深圳发展银行股份有限公司深圳上步支行	担保责任已解除
梁大钟、白瑛	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	《保证反担保合同》深担（2011）年反担字（1069-1）号	800	《贷款合同》深发上步贷字第20111213001 号	深圳发展银行股份有限公司深圳上步支行	担保责任已解除
梁大钟、白瑛	公司	《保证合同》深担（2011）年委贷保字（0901-1）号	250	《委托借款合同》深担（2011）年委借字（0901）号	兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	担保责任已解除
梁大钟、白瑛	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	《保证反担保合同》深担（2012）年反担字（0308-1）号	3,000	《人民币资金借款合同》44033955020120 60405	国家开发银行股份有限公司	担保责任已解除

梁大钟	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	《抵押反担保合同》深担（2012）年反担字（0308-2）号	3,000	《人民币资金借款合同》4403395502012060405	国家开发银行股份有限公司	担保责任已解除
梁大钟	公司	《最高额不可撤销担保书》2012年龙字第0012633010-1号	4,000	《授信协议》2012年龙字第0012633010号	招商银行股份有限公司深圳横岗支行	担保责任已解除
白瑛	公司	《最高额不可撤销担保书》2012年龙字第0012633010-2号	4,000	《授信协议》2012年龙字第0012633010号	招商银行股份有限公司深圳横岗支行	担保责任已解除
梁大钟	公司	《最高额保证合同》40000928-2014横岗（自保）字0005号	2,000	《银行承兑协议》40000928-2014(承兑协议)00004号	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	担保责任已解除
梁大钟	公司	《最高额保证合同》2014年圳中银布保额字第0027号	2,000	《授信额度协议》2014圳中银布额协字第0000527号	中国银行股份有限公司深圳布吉支行	正在履行
梁大钟、白瑛	公司	《最高额不可撤销担保书》2014年龙字第0014633002-01号、《最高额不可撤销担保书》2014年龙字第0014633002-02号	4,000	《授信协议》2014年龙字第0014633002号	招商银行股份有限公司深圳横岗支行	正在履行

4、关联方资金拆借

报告期内，公司与关联方之间资金占用具体如下：

单位：万元

项目	关联方	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
借款	天光集成	-	-	-	180.92
归还	天光集成	-	-	180.92	-

因业务发展需要，2011年公司向关联方借入资金180.92万元，该笔款项于2012年归还。该笔借款未支付利息，由于借款金额较小，其对发行人报告期内经营利润影响很小。

5、代收房租

报告期内，股东梁大钟、白瑛将个人房产出租给其他企业，因该等企业公账无法直接将租金转账给个人，故委托气派科技代收房租。

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
梁大钟	-	-	40.73	7.29
白瑛	3.70	29.62	3.70	-

6、应收应付关联方款项余额

单位：万元

项目	关联方	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
其他应付款	天光集成	-	-	-	180.92

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，交易金额占公司资产总额、净资产、营业收入、净利润的比例均较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

（四）独立董事对关联交易发表的意见

2014年8月28日，公司独立董事针对公司近三年及一期关联交易发表独立意见：“公司近三年及一期的关联交易均参照市场价格定价，没有以明显不合理的条款及条件限制公司的权利或加重公司的义务或责任，该等关联交易符合公平、公正、公允原则，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，亦未对公司的独立性产生不利影响。”

四、公司关联交易的决策权限与程序

（一）关联交易决策权限的规定

《公司章程》第七十六条规定：公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司《关联交易管理办法》第十一条至第十三条规定：

（一）总经理的审批权限

1、公司与关联法人达成的关联交易总额不满300万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值不满0.5%的关联交易；

2、公司与关联自然人发生的交易金额不满30万元的关联交易。

（二）董事会的审批权限

1、公司与关联法人发生的金额在300万元以上（含300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%之间的关联交易；

2、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上（含30万元）的关联交易。

（三）股东大会的审批权限

1、公司与关联人发生的金额在3,000万元以上（含3,000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易（获赠现金或提供担保除外）；

2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）关联交易回避制度

《公司章程》第一百零九条规定：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

有关联关系的董事回避和表决程序为：

（一）公司董事会秘书或关联关系董事或其他董事根据相关规定提出关联董

事回避申请并进行回避；

（二）关联关系董事不得参与审议有关关联交易事项，也不得代理其他董事行使表决权；

（三）董事会对有关关联交易事项进行表决时，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《公司章程》第一百二十一条第二款规定：独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。

《关联交易管理办法》第十四条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

《关联交易管理办法》第十五条规定：公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

《关联交易管理办法》第十六条规定：对于股东没有主动说明关联关系并回避、或董事会在公告中未注明的关联交易，其他股东可以要求其说明情况并要求其回避。

五、公司关联交易制度的执行情况及独立董事意见

（一）关联交易制度的执行情况

公司关联交易的决策程序遵循了《公司章程》规定的决策权限，关联交易合同的签署以及董事会和股东大会对关联交易的表决遵循了关联董事或关联股东的回避制度。公司关联交易符合公司关联交易决策权限与程序的相关规定。

（二）独立董事对关联交易发表的意见

2014年8月28日，公司独立董事针对公司近三年及一期关联交易发表独立意

见：“公司近三年及一期的关联交易均参照市场价格定价，没有以明显不合理的条款及条件限制公司的权利或加重公司的义务或责任，该等关联交易符合公平、公正、公允原则，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，亦未对公司的独立性产生不利影响。”

六、公司规范和减少关联交易的措施

（一）完善制度并严格执行

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》等相关制度都完善了关联交易决策权限和程序。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按制度规范操作，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。

（二）注销关联方天光集成

注销了同一实际控制人控制的天光集成，消除了关联销售和关联采购。

（三）实际控制人和控制股东出具了减少和规范关联交易的承诺

除上述措施外，公司控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺：“1、在本人作为气派科技控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业将尽量避免与气派科技发生关联交易。2、如与气派科技发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为，并按相关规定履行信息披露义务和配合办理审批程序，保证不通过关联交易损害气派科技及其他股东的合法权益。”

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名；公司有高级管理人员5名；核心技术人员3名。截至招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的情况如下：

（一）董事会成员

1、**梁大钟**：董事长、总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1959年2月，本科，毕业于电子科技大学固体器件专业；1984年至1990年任华越微电子有限公司工程师；1990年至1997年在深圳电子市场从事业务工作；1997年至2008年任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理；2001年至2012年任天光集成执行董事、总经理；2006年11月至2013年6月任气派有限执行董事、总经理；2011年至今任平湖街道商会（工商联）第五届理事会（执委会）常务理事（常务委员）；2013年至今任深圳市龙岗区电子行业联合会副会长；2013年6月至今任公司董事长、总经理；2013年5月至今任广东气派执行董事、总经理。作为公司核心技术人员，梁大钟主导并参与了公司35项专利技术的研发。

2、**白瑛**：董事，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年5月，高中；1983年至1992年就职于华越微电子有限公司；1992年至1997年在深圳电子市场从事业务工作；1997年至2008年任深圳市天光微电子有限公司副总经理，2004年至2012年任天光集成监事；2006年至2013年6月任气派有限监事；2013年6月至今，任公司董事。

3、**施保球**：董事、副总经理、研发中心主任，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年9月出生，本科，毕业于电子科技大学固体器件专业，半导体物理高级工程师；1984年至1989年任江南无线电器材厂工程师；1989年至2000年任中国华晶电子集团主管工程师；2000年至2006年任华润安盛科技有限公司主管工程师；2006年至2013年6月任气派有限副总经理；2013年6月至今任公司董事、副总经理、研发中心主任。作为公司核心技术人员，施保球参与了公司22项专利技术的研发。

4、**孟宇：**董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年1月出生，硕士研究生，清华大学光学工程硕士学位，北京大学工商管理硕士学位；2003年至2005年任日立（中国）研究开发有限公司副主任研究员，2005年至2007年任成都托胜科技开发有限公司总经理；2007年至2008年任北京华科力扬会计有限公司产品总监；2008年至今任创新投投资经理；2014年1月至今，任公司董事。

5、**魏云海：**独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年2月出生，本科，高级工程师，1998年至1999年任电子部53研究所所长助理；1999年至2004年任中国深圳彩电总公司总裁助理；2004年至2014年任中电智能卡有限责任公司总工程师、副总经理；现任公司独立董事；魏云海先生曾获北京市科学技术奖三等奖，中国电子学会科学技术奖二等奖，中国电子信息产业集团公司科技进步二等奖，中国电子信息产业集团公司2012年度“突出贡献科技工作者”称号。

6、**陈贤：**独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1945年12月出生，本科，高级工程师，毕业于北京大学大气物理专业；1970年至1986年任北京大学微电子学研究所室主任；1986年至1988年任国家电子工业部副处长；1988至1993年任国家机械电子工业部处长；1993年至1996年任中国电子信息产业集团有限公司部门经理；1996年至2002年任华越微电子有限公司董事长、总经理；2002年至2006年任中国电子信息产业集团有限公司信息技术研究院战略部主任；2002年至2006年任中国华大集成电路设计集团有限公司董事；2002年至2006年任上海华虹（集团）有限公司董事；2006年至2009年任中国半导体行业协会副秘书长；2009年至2013年任中国半导体行业协会秘书长；现任中国半导体行业协会副理事长，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事，气派科技独立董事。

7、**吴战篪：**独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，博士研究生，副教授，注册会计师，广东省财政厅专家库专家，毕业于西南财经大学会计专业；1997年至1999年任湖南中兴会计师事务所审计师；1999年至2000年任湖南英特会计师事务所审计师；2006年至今在暨南大学管理学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师、副教授、硕士生导师；2012年至2013年任暨南大学MPAcc教育中心执行主任；2012年至2013年任深圳市雅视科技股份有限公司独立董事；2013年至2014年任恒立实业发展股份有限公司独立董事；现任暨南

大学副教授，广东艾科技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）监事会成员

1、**周建斌：**监事会主席，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，硕士研究生；2003年至2010年历任中兴通讯股份有限公司采购员、北部非洲区域采购总代表、供应商认证部部长；2010年至今任中兴创业投资基金管理有限公司投资总监；2014年2月至今任深圳市乐智康电子有限公司董事长、总经理；2014年至今任公司监事会主席。

2、**赵红：**监事，女，中国国籍，无永久境外居留权，1968年7月出生，本科，毕业于兰州大学半导体物理专业，电仪中级工程师；2007年至2011年任华越微电子有限公司品质部副经理；2012年2-6月，任PALYBUTTON环球供应链质量经理；2012年至今任气派科技品质部副经理；2013年6月至今任公司监事。

3、**孙少林：**职工代表监事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年2月出生，大专，助理人力资源管理师；2006年至2010年历任深圳赛意法微电子有限公司技术员、助理工程师；2010年至2011年任深圳金丽豪科技有限公司工程经理；现任公司助理经理、职工代表监事、党支部书记。

（三）高级管理人员

1、**梁大钟：**详见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

2、**施保球：**详见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

3、**林忠：**副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年4月出生，EMBA，毕业于中山大学；1990年至1991年任长沙电子材料二厂助理工程师；1991年至1995年任深圳市深匀电子有限公司工程师、技术部部长；1995年至2010年任深圳市赛意法微电子有限公司高级运营经理、品质部高级经理；2010年至今任公司副总经理，其中2013年6月至2014年1月任公司董事。

4、**文正国：**副总经理、董事会秘书，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，本科，具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格；2002

年至2008年在云南马龙产业集团股份有限公司工作，其中2006年至2008年任证券事务代表；2008年至2011年任云南罗平锌电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2011年至2012年任云南煤业能源股份有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任；现任公司董事会秘书、副总经理。

5、**谭云烽：**财务总监，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年2月出生，大专，注册会计师，注册税务师；1991年至1997年任湖南省湘潭市半导体厂会计主管；1997年至2002年任新美亚科技（深圳）有限公司财务主任；2002年至2007年任建辉塑胶电子实业（深圳）有限公司财务经理；2007年至2010年任深圳中洲会计师事务所有限公司项目经理；2010年至2012年任福群电子（深圳）有限公司财务经理；现任公司财务总监。

（四）核心技术人员

1、**梁大钟：**详见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况“之“（一）董事会成员”。

2、**施保球：**详见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况“之“（一）董事会成员”。

3、**饶锡林：**运营总监、研发中心副主任，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年2月出生，硕士，毕业于电子科技大学信息工程专业；1996年至1999年任四川东风电机厂工艺技术员；1999年至2010年历任乐山菲尼克斯半导体有限公司技术员、主管、区域经理；2010年至今任公司运营总监、研发中心副主任，其中2013年6月至2014年1月任公司监事会主席；2013年5月至今任广东气派监事。作为公司核心技术人员，饶锡林主导并参与了公司18项专利技术的研发。

（五）董事、监事的提名与董事、监事、高级管理人员的选聘情况

职务类别	姓名	具体职务	提名与选聘情况		
			任期	提名人	会议名称
董事会成员	梁大钟	董事长	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	创立大会暨第一次股东大会；第一届董事会第一次会议
	白瑛	董事	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	创立大会暨第一次股东大会

	施保球	董事	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	创立大会暨第一次股东大会
	孟宇	董事	2014 年 1 月-2016 年 6 月	创新投	2014 年第一次（临时）股东大会
	魏云海	独立董事	2014 年 8 月-2016 年 6 月	梁大钟	2014 年第三次（临时）股东大会
	陈贤	独立董事	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	创立大会暨第一次股东大会
	吴战篪	独立董事	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	创立大会暨第一次股东大会
监事会成员	周建斌	监事会主席	2014 年 1 月-2016 年 6 月	中和春生	2014 年第一次（临时）股东大会；第一届监事会第一次会议
	赵红	监事	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	创立大会暨第一次股东大会
	孙少林	职工代表监事	2013 年 5 月-2016 年 6 月	职工代表大会	2013 年 5 月职工代表大会
高级管理人员	梁大钟	总经理	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	第一届董事会第一次会议
	施保球	副总经理	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	第一届董事会第一次会议
	林忠	副总经理	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	第一届董事会第一次会议
	文正国	副总经理、董事会秘书	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	第一届董事会第一次会议
	谭云烽	财务总监	2013 年 6 月-2016 年 6 月	梁大钟	第一届董事会第一次会议

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况

单位：万股

姓名	公司主要任职	持股情况							
		2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
梁大钟	董事长、总经理	5,100	69.86%	5,100	69.86%	5,100	77.27%	5,100	85%
白瑛	董事	1,080	14.79%	1,080	14.79%	1,080	16.36%	900	15%
施保球	董事、副总经理、研发中心主任	200	2.74%	200	2.74%	200	3.03%	-	-
孟宇	董事	-	-	-	-	-	-	-	-
魏云海	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-
陈贤	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-
吴战篪	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-
周建斌	监事会主席	-	-	-	-	-	-	-	-
赵红	监事	9	0.12%	9	0.12%	9	0.14%	-	-
孙少林	职工代表监事	-	-	-	-	-	-	-	-

林忠	副总经理	35	0.48%	35	0.48%	35	0.53%	-	-
文正国	副总经理、董事会秘书	28	0.38%	28	0.38%	28	0.42%	-	-
谭云烽	财务总监	23	0.32%	23	0.32%	23	0.35%	-	-
饶锡林	运营总监、研发中心副主任	28	0.38%	28	0.38%	28	0.42%		

2014年10月，原股东周幸福因个人原因离职，将其持有15万股的公司股份转让给控股股东梁大钟。截至本招股说明书签署日，梁大钟的持股数为5,115万股，占发行前总股本的70.07%。

公司董事长梁大钟与公司董事白瑛为夫妻关系，梁大钟姐姐的女儿梁晓英为公司股东，持股8万，占公司总股本0.11%。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在近亲属持股情况。

除上述披露情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持有的股份未发生变化，且不存在质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

姓名	公司主要任职	其他对外投资情况		
		企业名称	注册资本（万元）	出资比例
梁大钟	董事长、总经理	嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	34,600.00	2.89%
白瑛	董事	--	--	--
施保球	董事、副总经理、研发中心主任	--	--	--
孟宇	董事	--	--	--
魏云海	独立董事	--	--	--
陈贤	独立董事	--	--	--
吴战篪	独立董事	--	--	--
周建斌	监事会主席	深圳市乐智康电子有限公司	50.00	60.00%
赵红	监事	--	--	--
孙少林	职工代表监事	--	--	--
林忠	副总经理	--	--	--
文正国	副总经理、董事会秘书	--	--	--
谭云烽	财务总监	--	--	--
饶锡林	运营总监、研发中心副主任	--	--	--

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬及兼职情况

（一）薪酬情况

2013年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况如下：

姓名	公司主要任职	薪酬（万元）	备注
梁大钟	董事长、总经理	21.90	--
白瑛	董事	18.32	自 2013 年 6 月起领专职董事薪酬
施保球	董事、副总经理、研发中心主任	17.12	--
孟宇	董事	--	未在本公司领薪
魏云海	独立董事	--	2014 年 8 月聘任，2013 年度未在公司领薪
陈贤	独立董事	3.50	自 2013 年 6 月起领薪
吴战篪	独立董事	3.50	自 2013 年 6 月起领薪
周建斌	监事会主席	--	未在本公司领薪
赵红	监事	11.15	--
孙少林	职工代表监事	8.11	--
林忠	副总经理	18.31	--
文正国	副总经理、董事会秘书	24.31	--
谭云烽	财务总监	19.50	--
饶锡林	运营总监、研发中心副主任	17.58	--

（二）兼职情况

姓名	公司主要任职	兼职情况		兼职单位与公司的关系
		兼职单位名称	兼职职务	
梁大钟	董事长、总经理	平湖街道商会（工商联）第五届理事会（执委会）	常务理事（常务委员）	无关联
		深圳市龙岗区电子行业联合会	副会长	无关联
		广东气派科技有限公司	执行董事、总经理	子公司
白瑛	董事	--	--	--
施保球	董事、副总经理、研发中心主任	--	--	--
孟宇	董事	创新投	投资经理	公司股东
魏云海	独立董事	中国科学研究生院	硕士研究生导师	无关联
陈贤	独立董事	中国半导体行业协会	副理事长	无关联
		扬州扬杰电子科技股份有限公司	独立董事	无关联

		嘉兴斯达半导体股份有限公司	独立董事	无关联
		佛山市蓝箭电子股份有限公司	独立董事	无关联
吴战篪	独立董事	暨南大学	副教授	无关联
		广东艾科技术股份有限公司	独立董事	无关联
周建斌	监事会主席	深圳市中兴创业投资基金管理有限公司	投资总监	股东中和春生的普通合伙人
		深圳市乐智康电子有限公司	董事长、总经理	无关联
赵红	监事	--	--	--
孙少林	职工代表监事	--	--	--
林忠	副总经理	--	--	--
文正国	副总经理、董事会秘书	--	--	--
谭云烽	财务总监	--	--	--
饶锡林	运营总监、研发中心副主任	广东气派科技有限公司	监事	子公司

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间除本节“二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况”所披露的内容外，不存在其他亲属关系。

六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议、作出的承诺及其履行情况

（一）聘任合同和劳动合同

公司与梁大钟、施保球分别签订了《董事聘任合同》、《劳动合同》，与白瑛、孟宇、吴战篪、魏云海、陈贤分别签订了《董事聘任合同》，与赵红、孙少林分别签订了《监事聘任合同》、《劳动合同》，与周建斌签订了《监事聘任合同》，与林忠、文正国、谭云烽、饶锡林分别签订了《劳动合同》。

（二）保密协议

公司与全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《保密合同》，就上述人员在公司任职期间及离职后承担的商业秘密保密义务作出了约定。

（三）作出承诺及其履行情况

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出承诺情况详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”

七、公司与董事、监事、高级管理人员任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的提名和选聘均严格履行了相关的法律程序，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况

（一）董事变动情况

年度		董事
2011 年-2013 年 6 月	有限公司阶段	梁大钟
2013 年 6 月-2014 年 1 月	股份公司阶段	梁大钟、白瑛、施保球、林忠、贾和亭、陈贤、吴战篪
2014 年 1 月-2014 年 8 月		梁大钟、白瑛、施保球、孟宇、贾和亭、陈贤、吴战篪
2014 年 8 月至今		梁大钟、白瑛、施保球、孟宇、魏云海、陈贤、吴战篪

公司报告期内新增了6名董事（其中3名独立董事），变更了2名董事，新增董事目的是充实和加强公司董事会，优化董事成员结构，同时也为了符合股份公司及上市公司的相关规定，变更董事的原因是2名董事因个人原因辞职：1、公司因引进投资者需要，亦为了原董事林忠集中精力管理生产经营，更好地履行副总经理职责，同意林忠辞去董事职务，选举孟宇为董事；2、贾和亭因个人原因辞去独立董事职务，选举魏云海为独立董事。从新增及变更董事的任职经历及董事会的运行情况来看，报告期内增加的董事增强了董事会的实力，完善了公司的治理结构。

（二）监事变动情况

年度		监事
2011 年-2013 年 6 月	有限公司阶段	白瑛
2013 年 6 月-2014 年 1 月	股份公司阶段	饶锡林、赵红、孙少林
2014 年 1 月至今		周建斌、赵红、孙少林

公司报告期内新增了2名监事，变更了1名监事，新增监事的目的是为了符合

股份公司及上市公司的相关规定，优化监事成员结构，变更监事的原因是引进机构投资者需要，亦为使原监事饶锡林集中精力管理生产经营和研发工作。

（三）高级管理人员变动情况

年度		高级管理人员
2011 年	有限公司阶段	梁大钟、施保球、林忠
2012 年-2013 年 6 月	有限公司阶段	梁大钟、施保球、林忠、文正国、谭云烽
2013 年 6 月至今	股份公司阶段	梁大钟、施保球、林忠、文正国、谭云烽

报告期内新增了2名高级管理人员，主要目的是为了完善公司治理结构、充实、完善经营管理团队，满足公司经营发展的需求。从新增高级管理人员任职经历及管理层的运行情况来看，报告期内新增的高级管理人员使公司的管理层分工更明确，效率更高。公司经营稳健、业务发展良好。

第九节 公司治理

一、公司法人治理制度建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，规范了内部组织结构，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计工作制度》等治理文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。

公司成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全，目前公司已建立了比较科学和规范的法人治理结构。

二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责情况

法人治理结构相关制度制订以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书一贯依法规范运作履行职责，未出现任何违法违规现象，公司法人治理结构的功能不断得到完善。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会职权

根据《公司章程》的规定，股东大会是本公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、

解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第三十九条规定的担保事项；（13）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会运行情况

2013年6月3日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，会议选举产生了公司董事会、监事会，并审议通过了《公司章程》。《公司章程》对股东大会、董事会和监事会的职责及运行进行了规定。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署之日止，共召开10次股东大会，历次股东大会均严格按照有关法律法规对公司章程的订立和修改、重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配、董事人员调整等进行了决议。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会职权

董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施；（10）决定公司内部管理机构的设置；（11）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（12）制订公司的基本管理制度；（13）制订《公司章程》的修改方案；（14）管理公司信息披露事项；（15）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（16）根据公司股东大会决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会

并制定相应的工作规则；（17）听取关于董事、总经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；（18）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（19）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

2、董事会的运行情况

董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。公司制订了《董事会议事规则》，董事会运行规范。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署之日止，共召开15次董事会会议，历次董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会职权

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

2、监事会的运行情况

公司制订了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署之日止，共召开5次监事会会议，历次监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的职权

公司于2013年6月3日聘请了陈贤、吴战篪、贾和亭为独立董事，其中吴战篪为会计专业人士，并建立了《独立董事工作制度》。

2014年7月18日，独立董事贾和亭由于个人原因提出辞职。经提名委员会资格审查，控股股东梁大钟提名魏云海为独立董事候选人，2014年8月16日召开的2014年第三次（临时）股东大会通过了增补魏云海为公司独立董事的议案。

独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于人民币300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员薪酬的确定；（4）公司董事会未作出现金利润分配预案；（5）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（6）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（7）《公司章程》规定的其它事项。

2、独立董事的运行情况

2014年1月2日，公司第一届董事会第七次（临时）会议审议决议《关于增补孟宇先生为公司第一届董事会董事的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2014年7月31日，公司第一届董事会第十二次（临时）会议审议决议《关于增补公司第一届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2014年8月28日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议审议决议《关于公司近三年及一期关联交易情况的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本招股说明书签署日，公司独立董事的履行职责情况良好。

（五）董事会秘书

1、董事会秘书职责

董事会秘书履行以下职责：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（2）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（3）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；（5）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；（6）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（7）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向董事会报告；（8）法律、法规、规范性文件及公司章程要求履行的其他职责。

2、董事会秘书的履职情况

公司董事会秘书为文正国先生，其为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责。本公司董事会秘书自被聘任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定，认真履行了各项职责。

（六）董事会专门委员会设置情况

2013年6月3日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了关于设立董事会审计、薪酬与考核、战略、提名委员会的提案及董事会审计、薪酬与考核、战略、提名专门委员会议事规则。

1、董事会专门委员会的构成及职责

审计委员会由3人组成，本届董事会审计委员会成员为吴战篪、魏云海、白瑛，其中吴战篪担任主任。审计委员会的主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）提请董事会对重大关联交易进行审计；（6）审查公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；（7）审查公司各子公司、分公司及各职能部门贯彻执行公司经营目标、预算以及有关投资、财务、资产管理等规章制度的情况；（8）对内部审计人员及其工作进行考核、评价；（9）检查、评估公司存在的或潜在的各种风险；（10）检查公司遵守法律、法规的情况；（11）负责组织对公司经营管理中的重大问题或非常事件进行审计；（12）调查公司内部的经济违法行为；（13）提名公司审计部门的负责人；（14）公司董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会由3人组成，本届董事会薪酬与考核委员会成员为魏云海、吴战篪、梁大钟，其中魏云海担任主任。薪酬与考核委员会的主要职责：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（5）董事会授权的其他事项。

战略委员会由3人组成，本届董事会战略发展委员会成员为梁大钟、施保球、陈贤，其中梁大钟担任主任。战略委员会的主要职责：（1）对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议；（2）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；（3）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；（4）对公

司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（5）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（6）对以上事项的实施进行跟踪检查；（7）根据公司中长期发展战略规划，审议决定董事会批复的年度投资计划之外的单项金额500万以上，1000万元以下（含1000万元）的固定资产投资，在董事会闭会期间受托进行决策；（8）公司董事会授予的其他事宜。

提名委员会由3人组成，本届董事会提名委员会成员为陈贤、魏云海、梁大钟，其中陈贤担任主任。提名委员会的主要职责：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）根据公司章程规定的范围研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）提名审计委员会委员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的人选并审查该等人选的任职资格；（4）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（5）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（6）对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议；（7）拟定高级管理人员及关键后备人才的培养计划，对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

2、董事会专门委员会的议事规则

审计委员会的议事规则如下：（1）审计委员会会议由主任委员召集并主持。在公司中期财务报告和年度财务报告公布前应召开审计委员会会议，并于会议召开前3日通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后10日内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他任一委员主持。（2）审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有1票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。（3）审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。（4）董事会秘书列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。（5）审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。（6）审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席审计委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（7）如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。（8）审计委员会会议的召开程序、表决方式和

会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。（9）审计委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由董事会秘书保存。保存期限至少为10年。（10）审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

薪酬与考核委员会的议事规则如下：（1）薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后10天内召集会议，并于会议召开前3天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。（2）薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。（3）薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。（4）薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。（5）董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。（6）出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。（7）薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（8）如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。（9）薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。（10）薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。（11）薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

战略委员会的议事规则如下：（1）战略委员会委员可以提议召开会议，主任委员于收到提议后10日内召集会议。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。（2）战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。战略委员会每一委员有1票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。（3）战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的方式召开。（4）董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。（5）战略委员会委员及列席战

略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。（6）战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（7）战略委员会委员与审议的事项存在关联关系时，战略委员会应将该事项提交董事会审议。（8）如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。（9）战略委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限至少为10年。（10）战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

提名委员会的议事规则如下：（1）提名委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后10天内召集会议，并于会议召开前3天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。（2）提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。（3）提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。（4）提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。（5）董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。（6）出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。（7）提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。（8）如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。（9）提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。（10）提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。（11）提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

3、董事会专门委员会的运行情况

2013年7月4日，第一届董事会战略委员会召开第一次会议，审议通过关于《公司全资子公司广东气派科技有限公司购置土地投资建设新厂房》的议案。

2013年12月6日，第一届董事会战略委员会召开第二次会议，审议通过关于《公司增资扩股》的议案。

2014年2月26日，第一届董事会战略委员会召开第三次会议，审议通过关于2013年利润分配预案。

2013年12月27日，第一届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过关于《提名孟宇先生为公司第一届董事会董事》的议案。

2014年7月25日，第一届董事会提名委员会召开第二次会议，审议通过关于《提名魏云海先生为公司第一届董事会独立董事候选人》的议案。

2013年10月14日，第一届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过关于《聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构》的议案。

2014年2月26日，第一届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过2013年度公司内部控制自我评价报告等报告并审议通过关于《聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

2014年8月20日，第一届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过关于《公司2014半年度财务报表（经审计）》的议案。

2014年8月25日，第一届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过公司近三年及一期关联交易情况、公司近三年及一期财务报告。

截至本招股说明书签署日，本公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会运行情况良好。

三、公司近三年违法违规行为情况

公司严格遵守国家的有关法律与法规，报告期内，不存在违法违规的行为，也未受到国家行政及行业主管部门的处罚。

四、公司近三年资金占用和对外担保的情况

公司2011年存在向关联方天光集成借款的情形，该项借款于2012年归还。详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、（二）4、关联方资金拆借”部分。

除此之外，公司近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、公司内部控制情况

（一）公司管理层对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理当局的责任，故公司已建立了相应的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求对公司内部控制制度设计是否完整合理、执行是否有效进行了评估，评估分别按控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等要素进行，评估结果显示：公司内部控制制度的设计是完整合理的，并得到了有效执行。公司现有的内部控制严格遵循了《公司章程》，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷和重要缺陷。随着公司业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还将不断修订和完善。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天职业字[2014]10838-3号《内部控制鉴证报告》，其结论意见为：“我们认为，气派科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年6月30日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定之财务报表或据其计算而得。本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月经审计的会计报表及附注的主要内容，公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和报告全文，以获取完整的财务资料。

一、财务报表

（一）注册会计师意见

我们审计了后附的气派科技股份有限公司（以下简称气派科技）财务报表，包括2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，气派科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了气派科技2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日的财务状况及合并财务状况以及2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

（二）发行人最近三年及一期会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：				
货币资金	39,842,772.55	111,973,560.99	60,013,850.33	28,620,664.22
应收票据	12,362,326.63	11,870,268.66	837,469.39	-
应收账款	56,944,230.93	52,244,512.57	46,769,366.84	26,697,653.42
预付账款	1,533,521.65	2,453,401.09	-	-
应收利息	111,051.85	274,656.63	223,084.10	284,240.61
其他应收款	378,206.22	850,466.06	477,214.59	372,336.35
存货	32,023,751.33	27,128,358.93	19,157,341.99	9,976,679.99
其他流动资产	14,187.52	192,869.90	513,885.50	2,042,804.49
流动资产合计	143,210,048.68	206,988,094.83	127,992,212.74	67,994,379.08

非流动资产：				
固定资产	176,495,508.89	181,387,240.77	145,813,998.38	107,301,540.95
在建工程	4,466,336.95	2,986,155.77	-	-
无形资产	33,310,335.81	357,453.66	384,928.78	-
长期待摊费用	4,753,698.15	1,799,792.73	2,495,323.20	3,049,716.45
递延所得税资产	1,405,604.84	610,801.17	-	-
其他非流动资产	492,831.80	3,455,087.88	-	-
非流动资产合计	220,924,316.44	190,596,531.98	148,694,250.36	110,351,257.40
资产合计	364,134,365.12	397,584,626.81	276,686,463.10	178,345,636.48
流动负债：				
短期借款	-	-	12,100,000.00	18,206,142.21
应付票据	32,103,673.16	62,808,593.95	34,838,672.56	18,000,000.00
应付账款	74,260,311.34	60,606,447.28	53,806,564.35	41,509,796.39
预收款项	1,185,229.03	1,362,996.47	940,142.87	1,703,879.29
应付职工薪酬	4,119,240.92	3,594,998.65	3,049,981.35	3,025,529.30
应交税费	4,580,215.43	3,520,834.53	5,188,711.48	1,749,645.13
应付利息	-	46,301.37	68,097.53	69,243.08
其他应付款	755,625.49	152,331.79	137,287.10	1,964,163.10
流动负债合计	117,004,295.37	132,092,504.04	110,129,457.24	86,228,398.50
非流动负债：				
长期借款	-	25,000,000.00	28,000,000.00	-
其他非流动负债	3,011,499.98	-	-	
非流动负债合计	3,011,499.98	25,000,000.00	28,000,000.00	-
负债合计	120,015,795.35	157,092,504.04	138,129,457.24	86,228,398.50
所有者权益：				
实收资本(或股本)	73,000,000.00	73,000,000.00	66,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	129,846,931.33	129,846,931.33	5,760,000.00	-
盈余公积	3,906,119.89	3,906,119.89	8,629,700.58	3,911,723.79
未分配利润	37,365,518.55	33,739,071.55	58,167,305.28	28,205,514.19
归属于母公司股东权益合计	244,118,569.77	240,492,122.77	138,557,005.86	92,117,237.98
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	244,118,569.77	240,492,122.77	138,557,005.86	92,117,237.98
负债和所有者权益合计	364,134,365.12	397,584,626.81	276,686,463.10	178,345,636.48

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	129,046,055.07	283,954,787.98	260,398,202.79	194,379,086.50
减:营业成本	102,543,904.63	203,885,506.53	181,817,395.20	141,833,326.95
营业税金及附加	926,291.69	1,370,599.04	918,679.20	20,245.58
销售费用	1,628,393.00	2,642,923.00	1,689,681.34	949,891.85
管理费用	11,616,676.19	22,416,185.96	18,316,084.70	15,682,955.73
财务费用	-726,691.88	561,351.92	3,271,505.22	809,274.17
资产减值损失	512,192.98	441,549.58	1,094,074.72	452,083.39
二、营业利润（亏	12,545,288.46	52,636,671.95	53,290,782.41	34,631,308.83

损以“－”号填列）				
加:营业外收入	193,767.07	1,460,124.05	971,189.51	1,228,953.49
减：营业外支出	-	123,380.50	36,550.27	1,627.36
其中:非流动资产处置损失	-	-	8,675.30	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,739,055.53	53,973,415.50	54,225,421.65	35,858,634.96
减：所得税费用	1,812,608.53	7,688,298.59	7,045,653.77	4,355,153.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,926,447.00	46,285,116.91	47,179,767.88	31,503,481.54
归属于母公司所有者的净利润	10,926,447.00	46,285,116.91	47,179,767.88	31,503,481.54
少数股东损益	-	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	106,695,192.19	217,839,376.45	195,874,819.79	159,993,566.32
收到其他与经营活动有关的现金	30,048,200.57	3,006,263.42	1,415,695.81	3,778,281.92
经营活动现金流入小计	136,743,392.76	220,845,639.87	197,290,515.60	163,771,848.24
购买商品、接受劳务支付的现金	61,334,055.15	66,847,481.50	83,165,003.99	69,268,240.09
支付给职工以及为职工支付的现金	25,739,567.03	43,844,620.20	29,111,605.52	18,821,574.07
支付的各项税费	10,253,593.34	22,722,040.20	12,089,913.00	3,159,734.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,484,547.93	15,774,962.13	18,533,519.88	22,686,033.85
经营活动现金流出小计	100,811,763.45	149,189,104.03	142,900,042.39	113,935,582.88
经营活动产生的现金流量净额	35,931,629.31	71,656,535.84	54,390,473.21	49,836,265.36
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	392,000.00	170,940.18	7,083,013.52
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	392,000.00	170,940.18	7,083,013.52
购建固定资产、无形资产和其他长期	54,014,708.35	60,854,157.00	49,986,867.50	58,975,993.54

资产支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,000,000.00		
投资活动现金流出小计	54,014,708.35	63,854,157.00	49,986,867.50	58,975,993.54
投资活动产生的现金流量净额	-51,014,708.35	-63,462,157.00	-49,815,927.32	-51,892,980.02
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	54,860,000.00	11,760,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	46,100,000.00	22,706,142.21
筹资活动现金流入小计	-	54,860,000.00	57,860,000.00	22,706,142.21
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	15,100,000.00	24,206,142.21	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,351,771.04	1,982,379.66	14,632,491.87	4,864,340.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	400,000.00	1,396,000.00	985,966.63
筹资活动现金流出小计	32,351,771.04	17,482,379.66	40,234,634.08	15,850,307.46
筹资活动产生的现金流量净额	-32,351,771.04	37,377,620.34	17,625,365.92	6,855,834.75
四、汇率变动对现金的影响			-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-47,434,850.08	45,571,999.18	22,199,911.81	4,799,120.09
期初现金及现金等价物的余额	75,666,513.19	30,094,514.01	7,894,602.20	3,095,482.11
六、期末现金及现金等价物余额	28,231,663.11	75,666,513.19	30,094,514.01	7,894,602.20

（三）母公司最近三年会计报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：				
货币资金	34,648,481.29	70,799,786.17	60,013,850.33	28,620,664.22
应收票据	12,362,326.63	11,870,268.66	837,469.39	-
应收账款	57,452,162.83	52,244,512.57	46,769,366.84	26,697,653.42
预付帐款	2,903,162.88	2,417,351.09	-	-
应收利息	111,051.85	241,695.53	223,084.10	284,240.61
其他应收款	359,505.98	1,488,159.99	477,214.59	372,336.35
存货	31,673,064.47	27,091,006.57	19,157,341.99	9,976,679.99

其他流动资产	14,187.52	116,043.19	513,885.50	2,042,804.49
流动资产合计	139,523,943.45	166,268,823.77	127,992,212.74	67,994,379.08
非流动资产：				
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00		
固定资产	168,899,915.02	177,885,938.17	145,813,998.38	107,301,540.95
在建工程	299,400.00	320,000.00	-	-
无形资产	355,347.49	357,453.66	384,928.78	-
长期待摊费用	1,404,849.53	1,784,452.73	2,495,323.20	3,049,716.45
递延所得税资产	973,498.80	444,528.26	-	-
其他非流动资产	492,831.80	3,455,087.88	-	-
非流动资产合计	222,425,842.64	234,247,460.70	148,694,250.36	110,351,257.40
资产合计	361,949,786.09	400,516,284.47	276,686,463.10	178,345,636.48
流动负债：				
短期借款	-	-	12,100,000.00	18,206,142.21
应付票据	32,103,673.16	62,808,593.95	34,838,672.56	18,000,000.00
应付账款	71,422,408.99	60,654,741.52	53,806,564.35	41,509,796.39
预收款项	1,185,229.03	4,280,725.33	940,142.87	1,703,879.29
应付职工薪酬	2,807,147.30	2,960,692.17	3,049,981.35	3,025,529.30
应交税费	4,230,543.67	3,501,566.97	5,188,711.48	1,749,645.13
应付利息	-	46,301.37	68,097.53	69,243.08
其他应付款	1,648,252.35	145,532.95	137,287.10	1,964,163.10
流动负债合计	113,397,254.50	134,398,154.26	110,129,457.24	86,228,398.50
非流动负债：				
长期借款	-	25,000,000.00	28,000,000.00	-
其他非流动负债	3,011,499.98	-	-	-
非流动负债合计	3,011,499.98	25,000,000.00	28,000,000.00	-
负债合计	116,408,754.48	159,398,154.26	138,129,457.24	86,228,398.50
所有者权益：				
股本	73,000,000.00	73,000,000.00	66,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	129,846,931.33	129,846,931.33	5,760,000.00	-
盈余公积	3,906,119.89	3,906,119.89	8,629,700.58	3,911,723.79
未分配利润	38,787,980.39	34,365,078.99	58,167,305.28	28,205,514.19
所有者权益合计	245,541,031.61	241,118,130.21	138,557,005.86	92,117,237.98
负债和所有者权益合计	361,949,786.09	400,516,284.47	276,686,463.10	178,345,636.48

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	129,046,055.07	283,954,787.98	260,398,202.79	194,379,086.50
减:营业成本	102,748,961.33	203,696,048.06	181,817,395.20	141,833,326.95
营业税金及附加	878,506.63	1,366,768.10	918,679.20	20,245.58
销售费用	1,628,393.00	2,642,021.00	1,689,681.34	949,891.85
管理费用	10,113,668.39	21,630,106.94	18,316,084.70	15,682,955.73
财务费用	-446,020.58	753,103.55	3,271,505.22	809,274.17
资产减值损失	514,970.31	437,788.03	1,094,074.72	452,083.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,607,575.99	53,428,952.30	53,290,782.41	34,631,308.83

加:营业外收入	193,767.07	1,460,124.05	971,189.51	1,228,953.49
减：营业外支出	-	123,380.50	36,550.27	1,627.36
其中:非流动资产处置损失		-	8,675.30	-
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	13,801,343.06	54,765,695.85	54,225,421.65	35,858,634.96
减：所得税费用	2,078,441.66	7,854,571.50	7,045,653.77	4,355,153.42
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	11,722,901.40	46,911,124.35	47,179,767.88	31,503,481.54

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	106,695,192.19	218,022,517.05	195,874,819.79	159,993,566.32
收到其他与经营活动有关的现金	31,283,315.66	2,812,316.95	1,415,695.81	3,778,281.92
经营活动现金流入小计	137,978,507.85	220,834,834.00	197,290,515.60	163,771,848.24
购买商品、接受劳务支付的现金	70,128,237.86	69,007,088.67	83,165,003.99	69,268,240.09
支付给职工以及为职工支付的现金	20,219,577.09	42,179,475.31	29,111,605.52	18,821,574.07
支付的各项税费	10,002,645.51	22,693,771.70	12,089,913.00	3,159,734.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,846,660.31	15,959,689.26	18,533,519.88	22,686,033.85
经营活动现金流出小计	103,197,120.77	149,840,024.94	142,900,042.39	113,935,582.88
经营活动产生的现金流量净额	34,781,387.08	70,994,809.06	54,390,473.21	49,836,265.36
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,392,000.00	170,940.18	7,083,013.52
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00			
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	5,392,000.00	170,940.18	7,083,013.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,884,982.56	56,366,205.04	49,986,867.50	58,975,993.54
投资支付的现金	-	50,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	16,884,982.56	109,366,205.04	49,986,867.50	58,975,993.54

投资活动产生的现金流量净额	-13,884,982.56	-103,974,205.04	-49,815,927.32	-51,892,980.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	54,860,000.00	11,760,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	46,100,000.00	22,706,142.21
筹资活动现金流入小计		54,860,000.00	57,860,000.00	22,706,142.21
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	15,100,000.00	24,206,142.21	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,351,771.04	1,982,379.66	14,632,491.87	4,864,340.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	400,000.00	1,396,000.00	985,966.63
筹资活动现金流出小计	32,351,771.04	17,482,379.66	40,234,634.08	15,850,307.46
筹资活动产生的现金流量净额	-32,351,771.04	37,377,620.34	17,625,365.92	6,855,834.75
四、汇率变动对现金的影响：	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-11,455,366.52	4,398,224.36	22,199,911.81	4,799,120.09
期初现金及现金等价物的余额	34,492,738.37	30,094,514.01	7,894,602.20	3,095,482.11
期末现金及现金等价物余额	23,037,371.85	34,492,738.37	30,094,514.01	7,894,602.20

二、合并报表范围及变化情况

（一）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

（二）合并报表的编制方法

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

（三）合并报表范围

公司名称	纳入合并报表年份
广东气派科技有限公司	2013年5-12月、2014年1-6月

三、采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则和计量方法

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体收入确认政策为公司将货物运至客户指定地点，经客户验收，并经双方对账后确认收入。

2、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具的计量方法

1、金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

2、金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确

认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则--收入》确定的累计摊销额后的余额。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资

产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

（2）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新的金融负债方式替换现有金融负债，且新的金融负债与现有金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现有金融负债，并同时确认新的金融负债。

对现有金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现有金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新的金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4、金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产减值核算方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

（7）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

（8）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

6、金融资产减值损失的计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

（2）持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；

（3）可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下跌，且其下跌属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

7、金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

（3）对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（三）存货的计量方法

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。

公司根据存货类别和管理要求，对存货实行永续盘存制。存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按全月加权平均法。

低值易耗品领用时按一次转销法核算。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货

的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

（四）长期股权投资的计量方法

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

（5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3、本公司对以下的长期股权投资按照采用成本法核算：

（1）公司对实施控制的子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时，按照权益法进行调整；

（2）公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；

（3）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

（4）长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定确定。

（5）公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。

（6）公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（7）长期股权投资减值按照 “（十）资产减值损失的核算方法”。

（8）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（五）固定资产的计量方法

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

本公司固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与预计情况有差异的，则作相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机械设备	10	5	9.50
通用设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
运输工具	5	5	19.00

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩

余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

固定资产的减值按照“（十）资产减值损失的核算方法”所述的方法处理。

（六）在建工程的计量方法

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值按照“（十）资产减值的核算方法”所述的方法处理。

（七）无形资产的计量方法

本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。于每年年度终了时对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

公司无形资产项目的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证

明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

（2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

2、坏账准备的计提方法

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄分析组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
个别认定组合	如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别，导致该应收款项如果按照账龄组合计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，则将该类应收款项确定为个别认定组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	按账龄分析法计提坏账准备
个别认定组合	个别认定法，根据实际情况确定是否计提坏账准备及其计提比例

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（九）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十）资产减值损失的核算方法

1、资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

2、可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常

使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3、资产可收回金额的计量

（1）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

（2）资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

（3）预计的资产未来现金流量包括：

①资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

②为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于

或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

③资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

4、资产减值损失的确定

（1）可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（2）资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

5、资产组的认定及减值处理

（1）有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

（2）资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债

金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

6、商誉减值的处理

（1）企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

（2）公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，按照与本条前款规定相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。

（3）在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值损失。

（十一）借款费用的核算

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到整体完工后才

可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（十二）政府补助

1、政府补助的计价

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在公司能够收到，且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十三）主要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内公司无需披露的重要会计政策变更。

2、会计估计变更

报告期内公司无需披露的重要会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期内公司无需披露的前期会计差错更正。

四、公司适用的税率及享受的税收优惠政策

1、主要税种

税种	计税依据	适用范围	税率
增值税	按应纳税销售额的 17%扣除当期允计抵扣的进项税	公司、广东气派	17%
营业税	租金收入	公司	5%
企业所得税	应纳税所得额	公司	15%
		广东气派	25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额加上免征的增值税税额	公司	7%
		广东气派	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额加上免征的增值税税额	公司、广东气派	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额加上免征的增值税税额	公司、广东气派	2%
堤围费	当期营业收入	公司	0.01%
		广东气派	0.08%

根据《深圳市科技创新委员会关于公示2014年深圳市拟通过复审国家高新技术企业名单的通知》（深科技创新[2014]178号），公司为2014年拟通过复审国家高新技术企业。因此，公司2014年度企业所得税税率暂按15%执行。

2、税收优惠的说明

公司是深圳市龙岗区注册成立的生产性企业，根据全国人民代表大会常务委员会于1980年8月26日颁发的《广东省经济特区条例》第14条规定：“特区企业所得税税率为15%”。深圳市政府于1993年1月21日颁布的《关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》第2条规定：“设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，按照深圳经济特区的规定，一律按15%的税率征收企业所得税，免征地方所得税和地方附加”。

公司于2008年4月1日取得深圳市龙岗区国家税务局平湖税务分局下发的“深国税龙平减免[2008]0009号”《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》：根据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定同意本公司从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税。第3年至第5年减半征收所得税。

公司2011年10月被“深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局”评为“高新技术企业”。依据《中华人民共和国企业所得税法》享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）：自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行。

综上，公司选择2008年、2009年免征企业所得税，2010年-2012年减半征收企业所得税的优惠政策，2010年税率为11%，2011年税率为12%，2012年税率为12.5%，2013年开始按高新技术企业15%的税率缴纳企业所得税。

公司在2008-2012年享受的上述“两免三减半”和“企业所得税优惠过渡政策”的税收优惠系深圳市人民政府的规定，该等规定在深圳普遍适用，但其并无国家法律上的依据，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。针对可能被追缴所享受企业所得税优惠的风险，本公司控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛承诺：若公司因享受深圳市地方政府规定的企业所得税优惠政策而被国家税务主管机关要求补缴相关企业所得税差额的，本人将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受经济损失。如本人违反上述承诺导致公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

五、经注册会计师核验的非经常性损益

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了本公司报告期内的非经常性

损益明细表，出具了《非经常性损益明细表审核报告》【天职业字（2014）10838-1号】，发表意见如下：“我们认为，气派科技管理层编制的2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定。”

公司报告期内发生的非经常性损益情况如下表：

单位：元

非经常性损益明细	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
（一）非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	5,803.98	-8,675.30	560,094.59
（二）越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-	-	1,409,130.76	1,088,788.35
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	187,500.02	1,400,488.00	937,250.00	660,000.00
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
（六）非货币性资产交换损益	-	-	-	-
（七）委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
（九）债务重组损益	-	-	-	-
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
（十三）与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，	-	-	-	-

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
(十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
(十六)对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
(十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
(十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
(十九)受托经营取得的托管费收入；	-	-	-	-
(二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,267.05	-69,548.43	6,064.54	7,231.54
(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-790,000.00	-	-
非经常性损益合计	193,767.07	546,743.55	2,343,770.00	2,316,114.48
减：所得税影响金额	29,065.06	200,511.53	116,829.91	147,279.14
扣除所得税影响后的非经常性损益	164,702.01	346,232.02	2,226,940.09	2,168,835.34
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	164,702.01	346,232.02	2,226,940.09	2,168,835.34
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-

六、最近一期末主要资产的情况

（一）固定资产

截至2014年6月30日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限（年）	原值	净值	成新率
机械设备	10	21,580.00	15,988.18	74.09%
通用设备	5	2,244.26	1,132.33	50.45%
其他设备	5	552.11	426.57	77.26%
运输工具	5	198.64	102.47	51.59%
合　计		24,575.02	17,649.55	71.82%

（二）对外投资

截至2014年6月30日，公司合并报表后无长期股权投资。

（三）无形资产

截至2014年6月30日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	取得方式	摊销年限	初始金额	摊余价值
软件	购买	10 年	42.22	35.53
土地使用权	出让	50 年	3,301.00	3,295.50
合　计			3,343.22	3,331.03

七、主要负债

（一）银行借款

截至2014年6月30日，公司无银行借款。

（二）应付票据

截至2014年6月30日，公司应付票据为3,210.37万元，全部为银行承兑汇票，主要是公司支付原材料采购款形成。

（三）应付账款

截至2014年6月30日，公司应付账款为7,426.03万元，主要为应付供应商的货款及设备工程款。

（四）预收款项

截至2014年6月30日，公司预收款项为118.52万元，主要为部分客户的预付货款。

（五）应付职工薪酬

截至2014年6月30日，公司应付职工薪酬为411.92万元，公司职工当月工资下月支付，期末工资余额为计提的尚未发放的工资、奖金、津补贴等。

八、所有者权益情况

报告期各期末，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
股本	7,300.00	7,300.00	6,600.00	6,000.00
资本公积	12,984.69	12,984.69	576.00	-
盈余公积	390.61	390.61	862.97	391.17
未分配利润	3,736.55	3,373.91	5,816.73	2,820.55
所有者权益合计	24,411.86	24,049.21	13,855.70	9,211.72

（一）股本

公司股本参见本招股说明书第五节之“三、公司股本结构的形成及变化情况”的相关内容。

（二）资本公积

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
股本溢价	12,905.69	12,905.69	576.00	-
其他	79.00	79.00	-	-
合计	12,984.69	12,984.69	576.00	-

2013年末资本公积-股本溢价远高于2012年末，一方面是由于公司2013年5月进行股份制改革，经审计的净资产超过股本的部分合计为8,119.69万元，全部计入“资本公积-股本溢价”；另一方面，公司2013年进行两次增资，新增股东认购款项超过新增注册资本的金额4,786.00万元全部计入“资本公积-股本溢价”。

公司2013年11月吸收高管入股20万股，公司按照与外部投资者同期相同的每股价格确认高管股份支付金额79万元，分别计入当期管理费用和“资本公积-其他”。

（三）盈余公积

2013年末盈余公积较2012年末减少472.36万元，主要原因是公司于2013年5月整体进行股份制改革，将原企业经营形成的盈余公积转入实收资本和资本公积949.37万元以及计提当期法定盈余公积金477.01万元所致。

（四）未分配利润

2013年末未分配利润低于2012年，主要原因是公司于2013年5月整体进行股份制改革，将原企业经营形成的未分配利润全部转入实收资本和资本公积所致。

九、现金流情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及影响

报告期内，公司现金流情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	35,931,629.31	71,656,535.84	54,390,473.21	49,836,265.36
投资活动产生的现金流量净额	-51,014,708.35	-63,462,157.00	-49,815,927.32	-51,892,980.02
筹资活动产生的现金流量净额	-32,351,771.04	37,377,620.34	17,625,365.92	6,855,834.75
现金及现金等价物净增加额	-47,434,850.08	45,571,999.18	22,199,911.81	4,799,120.09

报告期内，公司没有发生不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本招股书签署日，公司无重大的资产负债表日后非调整事项。

（二）或有事项

1、未决诉讼事项

截至本招股书签署日，公司不存在重大的未决诉讼事项。

2、其他或有事项

截至本招股书签署日，公司不存在其他或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股书签署日，公司不存在其他重要事项。

十一、财务状况分析

（一）主要财务指标

主要财务指标	2014年1-6月/2014-6-30	2013 年度/2013-12-31	2012 年度/2012-12-31	2011 年度/2011-12-31
流动比率（倍）	1.22	1.57	1.16	0.79
速动比率（倍）	0.95	1.36	0.99	0.67
应收账款周转率（次）	2.24	5.44	6.73	8.93
存货周转率（次）	3.45	8.81	12.48	17.76

资产负债率（母公司）	32.16%	39.80%	49.92%	48.35%
息税折旧摊销前利润（万元）	2,616.49	7,815.48	7,337.38	4,810.70
利息保障倍数（倍）	2,330.04	28.53	24.15	44.02
每股经营活动的现金流量（元）	0.49	0.98	0.82	0.83
每股净现金流量（元）	-0.65	0.62	0.34	0.08
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.15%	0.15%	0.28%	0.00%
归属于公司股东的每股净资产（元）	3.34	3.29	2.10	1.54

计算公式说明如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

（4）存货周转率=营业成本/存货平均余额

（5）资产负债率=负债总额/资产总额

（6）息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用

（7）利息保障倍数=（利润总额+（利息支出+资本化利息支出））/（利息支出+资本化利息支出）

（8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（10）无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/净资产

（11）归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司报告期内主要指标如下：

1、净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率（%）			
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.51%	28.61%	42.30%	39.45%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	28.43%	40.71%	37.24%

注：加权平均净资产收益率计算公式如下：

加权平均净资产收益率=$P_0/(E_0+NP\div2+E_i\times M_i\div M_0-Ej\times Mj\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0)$

其中：P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E_0 为归属于公司普通股股东

的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M_0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、每股收益

单位：元

项目	年度	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2014 年 1-6 月	0.15	0.15
	2013 年度	0.70	0.70
	2012 年度	0.79	0.79
	2011 年度	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2014 年 1-6 月	0.15	0.15
	2013 年度	0.70	0.70
	2012 年度	0.75	0.75
	2011 年度	0.49	0.49

注：基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=$P_0 \div S$

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$

其中：P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S_0 为期初股份总数；S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M_0 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P_1/（$S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司不存在稀释性潜在普通股。

十二、资产评估情况

2013年5月15日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估有限公司出具了沃克森评报字[2013]第0145号《深圳市气派科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告书》，对气派有限的全部资产和负债在2013年3月31日的市场价值进行了评估。经评估，净资产账面值14,719.69万元，评估值15,785.15

万元，评估增值1,065.46万元，增值率7.24%，评估结果如下：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100
流动资产	1	12,394.91	12,650.03	255.12	2.06
非流动资产	2	15,321.32	16,131.66	810.34	5.29
固定资产	3	15,054.98	15,865.32	810.34	5.38
无形资产	4	37.51	37.51	-	-
长期待摊费用	5	228.83	228.83	-	-
资产总计	6	27,716.23	28,781.69	1,065.46	3.84
流动负债	7	10,271.54	10,271.54	-	-
非流动负债	8	2,725.00	2,725.00	-	-
负债总计	9	12,996.54	12,996.54	-	-
净资产	10	14,719.69	15,785.15	1,065.46	7.24

十三、历次验资情况

公司历次验资情况详见本招股说明书第五节之“三、公司股本结构的形成及变化情况”的相关内容。

第十一节 管理层讨论与分析

公司董事会提请投资者注意，以下讨论分析应结合公司经审计的财务报表及附注和本招股说明书披露的其他财务信息一并阅读。

公司管理层围绕公司主营业务发展目标和盈利前景，结合经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近三年及一期财务报告，对本公司财务状况和经营成果及其影响因素和未来变动趋势进行如下讨论和分析。以下分析中的数据如未有特别说明，均为合并会计报表口径。

一、财务状况分析

（一）资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	3,984.28	10.94%	11,197.36	28.16%	6,001.39	21.69%	2,862.07	16.05%
应收票据	1,236.23	3.39%	1,187.03	2.99%	83.75	0.30%	-	-
应收账款	5,694.42	15.64%	5,224.45	13.14%	4,676.94	16.90%	2,669.77	14.97%
预付账款	153.35	0.42%	245.34	0.62%	-	-	-	-
应收利息	11.11	0.03%	27.47	0.07%	22.31	0.08%	28.42	0.16%
其他应收款	37.82	0.10%	85.05	0.21%	47.72	0.17%	37.23	0.21%
存货	3,202.38	8.79%	2,712.84	6.82%	1,915.73	6.92%	997.67	5.59%
其他流动资产	1.42	0.00%	19.29	0.05%	51.39	0.19%	204.28	1.15%
流动资产合计	14,321.00	39.33%	20,698.81	52.06%	12,799.22	46.26%	6,799.44	38.13%
固定资产	17,649.55	48.47%	18,138.72	45.62%	14,581.40	52.70%	10,730.15	60.16%
在建工程	446.63	1.23%	298.62	0.75%	-	-	-	-
无形资产	3,331.03	9.15%	35.75	0.09%	38.49	0.14%	-	-
长期待摊费用	475.37	1.31%	179.98	0.45%	249.53	0.90%	304.97	1.71%
递延所得税资产	140.56	0.39%	61.08	0.15%	-	-	-	-
其他非流动资产	49.28	0.14%	345.51	0.87%	-	-	-	-
非流动资产合计	22,092.43	60.67%	19,059.65	47.94%	14,869.43	53.74%	11,035.13	61.87%
资产总计	**36,413.44**	**100%**	**39,758.46**	**100%**	**27,668.65**	**100%**	**17,834.56**	**100%**

伴随着集成电路产业的快速发展，公司业务规模不断扩大，经营情况持续向好，资产规模快速增长。报告期内，公司资产规模从2011年末的17,834.56万元增加至2014年6月末的36,413.44万元，增幅为104.17%。公司主营业务集成电路封装测试为资金密集型行业，需要投入大量先进机器设备，故此非流动资产占比较高。但是，随着生产经营规模逐步扩大，公司流动资金、应收账款和存货呈现一定程度的上升。报告期内，公司流动资产占总资产的比例逐年提升，显示公司具有良好的资产变现能力。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为3,984.28万元、11,197.36万元、6,001.39万元和2,862.07万元，占总资产的比例分别为10.94%、28.16%、21.69%和16.05%，货币资金占比总体呈现增加的情况，主要原因是由于公司生产经营规模扩大、增加注册资本所致。

2012年12月31日，公司货币资金余额为6,001.39万元，主要是由于为了满足公司扩大生产规模、筹集募投项目土地购买资金以及日常运营资金的需求，同时基于公司长远发展考虑，部分管理层对公司进行货币增资所致。

2013年12月31日，公司的货币资金为11,197.36万元，较2012年末增加5,195.97万元，主要原因是公司计划在通过子公司在东莞建设生产基地扩大生产引入机构投资者所致。

2014年6月30日，公司的货币资金为3,984.28万元，较2013年末减少主要原因是公司考虑到增资后现金相对充裕，偿还银行贷款及广东气派购买东莞的厂房用地所致。

截至2014年6月末，货币资金1,161.11万元为所有权受到限制的资产，根据与银行签订的授信协议，公司应将不低于票据本金30%的金额存入指定账户作为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

报告期各期末，公司应收票据余额分别为1,236.23万元、1,187.03万元、83.75万元和0万元，全部为银行承兑汇票。应收票据金额逐年增加主要是受宏观经济影响，下游客户采用银行承兑汇票的方式支付货款所致。此外，公司会根据采购付款

情况将银行承兑汇票背书转给供应商，亦会导致各期末应收票据余额发生变化。

3、应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5,694.42万元、5,224.45万元、4,676.94万元和2,669.77万元。由于公司生产经营规模不断扩大，销售收入持续增长，应收账款随之相应增加。报告期各期末公司应收账款账面价值占总资产比例较为稳定，基本维持在13%-16%之间，应收账款状况良好。

（1）应收账款余额分析

公司通常给予客户月结30天的销售信用期，具体时间根据客户的采购量和客户以往付款情况而定。报告期各期末，公司应收账款余额与销售额的比较如下：

单位：万元

日期	应收账款余额（A）	当期最后 2 个月销售额（B）	占比（A/B）
2011 年末	2,810.97	2,785.81	100.90%
2012 年末	4,925.27	5,009.07	98.33%
2013 年末	5,509.19	6,176.05	89.20%
2014 年 6 月末	6,011.92	6,364.43	94.46%

注：销售额=销售收入×1.17

报告期各期末，公司应收账款余额与当期最后2个月销售额基本相匹配，占比稳定在90%-100%左右。公司应收账款逐年增加主要原因是当期最后两个月市场需求旺盛，销售额增加所致。

2014年6月末，公司应收账款余额为6,011.92万元，较以前年度期末应收账款余额增加，主要原因是由于公司将部分生产设备搬迁至东莞子公司导致前期生产效率下降所致。随着生产员工熟练程度的提升以及生产线的不断磨合，2014年第二季度生产效率提升使得订单交付数量增加，销售额和应收账款亦相应增加。

（2）应收账款质量分析

报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,817.11	96.76%	5,385.08	97.75%	4,889.62	99.28%	2,797.82	99.53%
1-2 年	177.95	2.96%	113.74	2.06%	34.22	0.69%	13.15	0.47%
2-3 年	11.45	0.19%	8.95	0.16%	1.42	0.03%	-	0.00%
3 年以上	5.41	0.09%	1.42	0.03%	-	-	-	-
合计	6,011.92	100%	5,509.19	100%	4,925.27	100%	2,810.97	100%

公司应收账款95%以上都在一年以内，应收账款质量较高。

2014年6月末，公司应收账款前5名客户情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	占应收账款余额比例（%）
深圳市励创微电子有限公司	600.67	1 年以内	9.99%
上海普芯达电子有限公司	377.53	1 年以内	6.28%
深圳市爱矽电子有限公司	329.83	1 年以内	5.49%
深圳市华芯邦科技有限公司	238.67	1 年以内	3.97%
深圳市南翔科技有限公司	238.57	1 年以内	3.97%
合计	1,785.26	--	29.70%

公司应收账款前五名客户合计欠款额占公司应收账款的比例为29.70%，均在1年之内，且长期与公司合作，应收账款回收的风险很小。

（3）应收账款坏账计提分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
应收账款账面余额	6,011.92	5,509.19	4,925.27	2,810.97
计提坏账准备	317.50	284.74	248.33	141.20
应收账款账面价值	5,694.42	5,224.45	4,676.94	2,669.77
坏账准备计提比例	5.28%	5.17%	5.04%	5.02%

报告期内公司坏账准备占应收账款余额的比例分别为5.28%、5.17%、5.04%和5.02%，计提比例基本维持在5%左右。

与同行业上市公司比较，公司采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例在行业内企业中偏谨慎：

账龄	气派科技	长电科技	华天科技
1 年以内（含 1 年）	5%	5%	5%
1-2 年	10%	10%	10%
2-3 年	30%	20%	30%
3-4 年	100%	50%	50%
4-5 年	100%	50%	80%
5 年以上	100%	100%	100%

4、预付账款

报告期各期末，公司预付账款金额分别为153.35万元、245.34万元、0万元和0万元。2013年末预付款大幅增加，主要原因是公司预付货款、担保融资顾问费、

中介费用等所致。

截至2014年6月末，公司预付账款前五大情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	时间	未结算原因
股改上市费用	141.86	1 年以内/1-2 年	合同未执行完毕
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	4.02	1 年以内	预付油费
华南国际经济贸易仲裁委员会	3.38	1 年以内	合同未执行完毕
东莞市居峰环保科技有限公司	3.11	1 年以内	合同未执行完毕
深圳国家知识产权局专利代办处	0.65	1 年以内	合同未执行完毕
合计	**153.02**		

公司预付账款质量较好，坏账风险较低。

5、应收利息

报告期各期末，公司应收利息金额分别为11.11万元、27.47万元、22.31万元和28.42万元，主要为银行存款的应收利息。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为37.82万元、85.05万元、47.72万元和37.23万元，主要为厂房押金等。

报告期各期末，公司其他应收款的账龄情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	18.89	46.01%	70.83	73.98%	29.06	55.93%	39.19	100%
1-2 年	21.83	53.19%	1.60	1.67%	22.90	44.07%	-	
2-3 年	0.33	0.80%	23.31	24.35%	-	-	-	
合计	**41.05**	**100%**	**95.74**	**100%**	**51.96**	**100%**	**39.19**	**100%**

公司其他应收款主要是租赁厂房付给房东的押金以及员工因工向公司提前支借的备用金。

截至2014年6月末，公司其他应收款前五大情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	时间	内容
东莞市华盛音响制品有限公司	15.00	1-2 年	租赁厂房押金，未到期
谭石周	10.00	1 年以内	租赁厂房押金，未到期

深圳市万盛富投资有限公司	5.00	1-2 年	用电押金，未到期
石楚良	4.49	1 年以内	员工备用金
深圳市金涛物业管理有限公司	2.88	1 年以内	宿舍押金，未到期
合计	**37.37**		

其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为3,202.38万元、2,712.84万元、1,915.73万元和997.67万元，呈现不断增加的趋势，主要系公司经营规模持续扩大所致。

公司实行以销定产的经营模式，公司产成品主要为按订单生产。低值易耗品主要是生产过程中机器设备的配件，配件会因长时间生产磨损而损坏，为了不影响生产流水线运转，公司需要根据生产设备规模及损坏频率准备一定数量的零配件。

（1）存货余额变动分析

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例	余额	比例
原材料	894.82	27.71%	991.87	36.54%	675.62	35.27%	507.43	50.86%
在产品	584.16	18.09%	384.42	14.16%	219.74	11.47%	189.87	19.03%
产成品	1,203.54	37.27%	931.18	34.31%	1,003.81	52.40%	104.71	10.50%
低值易耗品	547.08	16.94%	406.66	14.98%	16.57	0.86%	195.66	19.61%
合计	**3,229.60**	**100%**	**2,714.14**	**100%**	**1,915.73**	**100%**	**997.67**	**100%**

公司根据销售、生产和采购情况对存货数量实行动态管理，存货账面余额构成比例存在一定的波动性：2011年公司受设备限制，产能比较紧张，考虑到市场需求非常旺盛，公司加大了原材料储备力度确保生产顺利运转，在产品生产完毕后公司及时向客户交付货物，由此原材料占比较高，为50.86%；为了缓解产能紧张、提高客户满意度，公司在2011年和2012年采购机器设备扩大生产能力，从而使得产成品占比得到较大提升，此外鉴于设备供应商赠送的机器配件增加较多，公司在2012年末降低了低值易耗品的采购数量，从而导致其占比过低。2013年和2014年6月末，公司存货构成总体保持较为稳定的态势。

（2）存货规模分析

报告期内，公司存货账面价值在流动资产中的占比情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
存货账面价值	3,202.38	2,712.84	1,915.73	997.67
流动资产合计	14,321.00	20,698.81	12,799.22	6,799.44
存货占流动资产比例	22.36%	13.11%	14.97%	14.67%

2011年-2013年末，公司存货占流动资产的比例比较稳定地维持在14%左右；2014年6月末，公司存货占流动资产的比例上升至22.36%，主要原因是公司归还银行贷款导致流动资产减少所致。

公司存货占流动资产比例与同行业公司比较如下：

项目	存货账面价值/流动资产		
	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
气派科技	13.11%	14.97%	14.67%
长电科技	25.38%	26.78%	31.10%
华天科技	20.03%	20.64%	15.01%

与同行业上市公司相比，公司存货占流动资产的比例较低，主要是公司的客户主要集中在珠三角区域，公司具有较好的区位优势，在对存货实行严格管理和控制同时，能够在产成品完工后及时发货并与客户结算。

（3）存货跌价准备计提

报告期各期末，公司计提存货跌价准备分别为27.22万元、1.30万元、0万元和0万元。公司存货周转率较高，从原材料备货、接订单到产品交付客户的时间约为40-50天左右，存货跌价的可能性相对较低；公司的业务模式为受客户委托对客户提供芯片封装测试服务，生产出来的产品都有相应订单，产品无法实现销售的风险较低。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
待抵扣的增值税进项税额	1.42	19.29	51.39	204.28
合计	**1.42**	**19.29**	**51.39**	**204.28**

公司的其他流动资产为待抵扣的增值税进项税额，2011年末待抵扣的增值税

进项税额较高，主要是为了缓解产能紧张、提高客户满意度，公司在2011年采购机器设备扩大生产能力，导致增值税进项税额较高所致；2012年末待抵扣的增值税进项税额较高，主要原因是供应商提供的发票未能在当期期末到达，导致公司无法及时认证。

9、固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值的主要情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
机械设备	15,988.18	16,421.17	13,351.28	9,984.31
通用设备	1,132.33	1,243.05	996.87	656.24
其他设备	426.57	355.56	91.79	68.63
运输工具	102.47	118.94	141.46	20.97
合计	**17,649.55**	**18,138.72**	**14,581.40**	**10,730.15**

公司属于资金密集型行业，随着经营规模扩大对生产设备的需求也逐步加大，因此报告期内公司不断添置新的机器设备以扩充产能，导致固定资产期末余额逐年增加。

按照生产工艺划分，公司各生产环节的关键固定资产情况如下：

单位：万元、台

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	账面净值	数量	账面净值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量
键合设备	6,978.10	267	7,433.83	267	5,721.21	197	4,184.59	139
装片设备	3,677.27	65	3,593.63	61	3,044.56	49	2,261.92	36
塑封设备	795.02	31	822.29	30	878.2	30	774.49	22
切筋成型设备	1,417.13	31	1,514.57	31	1,379.18	29	1,200.91	26
测试设备	348.04	25	368.66	25	267.62	17	169.74	10
合计	**13,215.57**	**419**	**13,732.98**	**414**	**11,290.77**	**322**	**8,591.65**	**233**

制约公司产能的主要是键合设备和装片设备，因此这两类设备随着公司产能扩充，金额和数量呈现较快的增长态势。

截至2014年6月末，公司用于抵押的固定资产账面净值为5,128.31万元，资产所有权受到限制的原因为公司2014年3月10日与招商银行股份有限公司深圳横岗支行签订最高额抵押合同，招商银行在2014年3月10日至2015年3月9日的授信期间内向公司提供人民币肆仟万元的授信额度，公司将一批固定资产用于抵押。

10、在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
待安装机器设备	29.94	116.31	-	-
租赁厂房装修工程	4.37	182.31	-	-
自建厂房	412.32	-	-	-
合计	**446.63**	**298.62**	**-**	**-**

2013年末，公司在建工程为298.62万元，主要原因是子公司广东气派租赁的厂房装修所致；2014年6月末在建工程为446.63万元，主要为子公司广东气派厂房开工建设所致。

11、无形资产

公司无形资产为软件使用权，报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
软件	35.53	35.75	38.49	-
土地使用权	3,295.50	-	-	-
合计	**3,331.03**	**35.75**	**38.49**	**-**

2014年6月末，公司无形资产账面价值为3,331.03万元，主要原因是广东气派购买土地使用权所致。

12、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
装修费用	463.76	166.46	245.39	299.41
消防工程	11.61	13.52	4.14	5.56
合计	**475.37**	**179.98**	**249.53**	**304.97**

公司长期待摊费用中装修费用为厂房的装修费用。

13、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为140.56万元、61.08万元、0万元和0万元。

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
可抵扣亏损	43.19	16.53	-	-
坏账准备	48.12	44.35	-	-
存货跌价准备	4.08	0.19	-	-
递延收益	45.17	-	-	-
合计	**140.56**	**61.08**	-	-

由于公司子公司广东气派经营前期处于亏损阶段，根据企业会计准则，公司分别在2013年度末和2014年6月末确认了递延所得税资产16.53万元和43.19万元；2014年6月末递延所得税资产大幅增加主要原因是公司获得工业中小企业技术改造项目政府补助确认相应的递延所得税资产。

（二）负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	-	-	1,210.00	8.76%	1,820.61	21.11%
应付票据	3,210.37	26.75%	6,280.86	39.98%	3,483.87	25.22%	1,800.00	20.87%
应付账款	7,426.03	61.88%	6,060.64	38.58%	5,380.66	38.95%	4,150.98	48.14%
预收款项	118.52	0.99%	136.30	0.87%	94.01	0.68%	170.39	1.98%
应付职工薪酬	411.92	3.43%	359.50	2.29%	305.00	2.21%	302.55	3.51%
应交税费	458.02	3.82%	352.08	2.24%	518.87	3.76%	174.96	2.03%
应付利息	-	-	4.63	0.03%	6.81	0.05%	6.92	0.08%
其他应付款	75.56	0.63%	15.23	0.10%	13.73	0.10%	196.42	2.28%
流动负债合计	11,700.43	97.49%	13,209.25	84.09%	11,012.95	79.73%	8,622.84	100%
长期借款	-	-	2,500.00	15.91%	2,800.00	20.27%	-	-
其他非流动负债	301.15	2.51%	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	301.15	2.51%	2,500.00	15.91%	2,800.00	20.27%	-	-
负债合计	**12,001.58**	**100%**	**15,709.25**	**100%**	**13,812.95**	**100%**	**8,622.84**	**100%**

报告期内，随着公司经营规模扩大，对供应商的应付票据和应付账款也相应增加，公司负债规模逐渐增加，由2011年末8,622.84万元增加至2013年末15,709.25万元。公司负债主要以流动负债为主，为了调整负债结构、降低偿债风险。2014年公司考虑到引入机构投资者后资金相对充裕，归还了部分银行贷款，负债降低至12,001.58万元。

1、短期借款

公司短期借款主要为银行借款，报告期内随着公司经营规模不断扩大，对流动资金的需求也呈上升趋势。公司在股东对公司增资后，2013年开始偿还短期借款以降低财务费用。

2、应付票据

报告期各期末，应付票据余额分别为3,210.37万元、6,280.86万元、3,483.87万元和1,800.00万元。

公司应付票据为银行承兑汇票，为了提高资金使用效率和降低财务费用，公司使用银行承兑汇票支付供应商的货款。2012年末和2013年末应付票据余额较高，主要是生产经营规模扩大，公司采购量及采购金额增长，故此加大了承兑汇票支付采购款项的力度。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为7,426.03万元、6,060.64万元、5,380.66万元和4,150.98万元，应付账款主要是公司采购原材料和设备的款项。

目前，公司销售和回款情况良好，盈利能力较强，应付账款主要集中在一年以内，且应付账款较采购规模呈现持续下降趋势，公司还款情况正常，不存在偿付风险。报告期各期末，公司应付账款余额的账龄结构如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,246.08	97.58%	5,956.91	98.29%	5,360.20	99.62%	4,150.98	100%
1-2年	179.95	2.42%	103.74	1.71%	20.46	0.38%	-	-
合计	**7,426.03**	**100%**	**6,060.64**	**100%**	**5,380.66**	**100%**	**4,150.98**	**100%**

截至2014年6月30日，应付账款期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项，前五大具体情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	时间	未结算原因
先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司	1,522.45	1年以内	设备款，未到付款期
宁波康强电子股份有限公司	865.09	1年以内	货款，未到付款期
铜陵三佳山田科技股份有限公司	681.39	1年以内/1-2年	设备款，未到付款期
进峰贸易（深圳）有限公司	456.90	1年以内	货款，未到付款期

宁波埃斯科光电有限公司	246.45	1 年以内	货款，未到付款期
合计	**3,772.28**		

报告期内，公司应付账款虽然随着经营规模扩大而增加较快，但公司资产负债率较低，2014年6月末母公司资产负债率仅为32.16%。

4、预收款项

报告期各期末，公司预收款项余额分别为118.52万元、136.30万元、94.01万元和170.39万元，主要为客户预先支付的货款。

公司预收款项余额的账龄结构如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	118.52	100%	136.30	100%	93.83	99.80%	170.39	100%
1-2 年			-	-	0.19	0.20%		-
合计	**118.52**	**100%**	**136.30**	**100%**	**94.01**	**100%**	**170.39**	**100%**

截至2014年6月30日，预收款项绝大部分在1年以内，且无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

5、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为411.92万元、359.50万元、305.00万元和302.55万元，呈现逐年增长态势，主要是由于员工数量和工资水平逐年增加所致。

6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费金额分别为458.02万元、352.08万元、518.87万元和174.96万元，主要为企业所得税和增值税，详细情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
企业所得税	247.04	206.46	294.67	173.56
增值税	177.82	120.25	196.12	-
代扣代缴个人所得税	4.30	3.60	1.74	1.26
堤围费	0.44	0.44	0.29	0.15
教育费附加	8.98	6.10	9.84	-
城建税	12.04	8.50	13.78	-
印花税	2.40	6.73	2.43	-
土地使用税	5.00	-	-	-

合计	458.02	352.08	518.87	174.96

2011年末公司应交增值税金额为0，主要是因为随着经济复苏，下游电子行业对封装测试产品的需求回暖，公司抓住市场机遇，2010年和2011年大规模增加固定资产投资从而快速扩大产能。根据税法相关规定，购买固定资产产生的增值税可以进行抵扣，但是由于公司2011年销售收入规模相对有限，导致期末留存尚未抵扣的增值税额204.28万元，2011年应纳增值税为0。

2012年末公司应交企业所得税相比2011年末增幅较大，一是2012年公司收入增长使得税前利润比2011年增加1,836.68万元，二是2012年公司所得税率为12.5%，较2011年高0.5%，两项因素共同导致公司2012年应缴纳企业所得税金额增加。

7、应付利息

报告期各期末，公司应付利息余额分别为0万元、4.63万元、6.81万元和6.92万元，应付利息是由于公司计提年底结息日至年终银行贷款利息所产生。

8、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额为75.56万元、15.23万元、13.73万元和196.42万元。2011年末公司其他应付款金额较高，主要是当年末公司存在应付关联方天光集成款项180.92万元，该笔款项已于2012年归还。

2014年6月末，公司其他应付款为75.56万元，主要为子公司广东气派厂房建设承包方东莞市建工集团有限公司交付的履约保证金50万元。

9、长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为0万元、2,500.00万元、2,800.00万元和0万元。

为了优化公司负债结构，公司2012年4月从国家开发银行取得期限为三年的长期借款3,000万元，2014年公司考虑到引入投资者后的资金储备相对充裕，提前归还了该笔银行贷款。

10、其他非流动负债

报告期内各期末，公司其他非流动负债余额的变动及分类如下表所示：

单位：万元

项目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
递延收益	301.15	-	-	-
合计	**301.15**	**-**	**-**	**-**

公司2014年3月取得的工业中小企业技术改造项目补助资金317万元，该政府补助是与资产有关的政府补助，公司按照资产的折旧期间分期摊销计入各期的营业外收入。

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

2011年-2013年，公司偿债能力主要指标情况如下：

项目	2014.06.30/ 2014 年 1-6 月	2013.12.31/ 2013 年	2012.12.31/ 2012 年	2011.12.31/ 2011 年
资产负债率（母公司）	32.16%	39.80%	49.92%	48.35%
流动比率	1.22	1.57	1.16	0.79
速动比率	0.95	1.36	0.99	0.67
息税折旧摊销前利润（万元）	2,616.49	7,815.48	7,337.38	4,810.70
利息保障倍数（倍）	2,330.04	28.53	24.15	44.02

报告期内，公司资产负债率比较稳定，财务状况较好。公司流动比率和速动比率不断提高，流动比率、速动比率分别由2011年的0.79、0.67增加到2013年的1.57、1.36，呈现逐年递增的趋势，显示了公司具有较好的资产流动性和偿债能力。2014年6月末，公司流动比率和速动比率略有下降，主要原因是公司考虑到引入投资者后资金相对充裕，归还了银行长期借款，使得流动资产出现一定程度的下降。

报告期内，公司利息保障倍数较高，还本付息能力强，公司拥有良好的资信状况，报告期内不存在债务到期未偿付的情况。

从整体上看，母公司资产负债率由2011年末的48.35%下降到2014年6月末的32.16%，速动比率和流动比例等指标总体呈现上升趋势，利息保障倍数处于较高水平，公司偿债能力较强且不断提升。

2、同行业公司偿债能力指标对比

2011-2013年，公司与同行业上市公司偿债能力主要指标比较情况如下：

项目	资产负债率（母公司）			流动比率		
	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
气派科技	39.80%	49.92%	48.35%	1.57	1.16	0.79
长电科技	65.62%	64.33%	57.41%	0.63	0.57	0.61
华天科技	40.23%	37.28%	33.55%	1.89	1.18	1.85

与同行业上市公司相比，公司资产负债率和流动比率均处于中等水平。此外，公司经营活动净现金流一直维持在较高水平，银企关系良好，银行授信额度充足，为公司债务的偿付提供了有力的保障。

（四）资产周转能力分析

2011-2013年，公司与同行业上市公司资产周转能力主要指标比较情况如下：

项目	公司名称	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
应收账款周转率（次）	气派科技	5.44	6.73	8.93
	长电科技	8.83	9.16	8.46
	华天科技	6.32	5.40	5.25
存货周转率（次）	气派科技	8.81	12.48	17.76
	长电科技	6.67	6.80	6.50
	华天科技	8.14	8.28	8.39
总资产周转率（次）	气派科技	0.84	1.14	2.18
	长电科技	0.70	0.68	0.70
	华天科技	0.80	0.67	0.65

2011-2013年，公司应收账款周转率分别为8.93次、6.73次和5.44次，公司应收账款周转率与同行业上市公司相比处于中等水平，与公司给予客户的信用期基本匹配。

由于公司对存货管理严格，以及重视不断提升生产过程中的效率，公司存货周转率和总资产周转率均略高于同行业上市公司。2011-2013年，公司存货周转率分别为17.76次、12.48次和8.81次。2011年公司存货周转率远高于其他年度，主要原因2011年公司受设备限制，产能比较紧张，考虑到市场需求非常旺盛，公司在产品生产完毕后公司及时向客户交付货物，从而使得存货周转率较高。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2014.06.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例	余额	比例
主营业务收入	12,375.49	95.90%	27,308.18	96.17%	24,251.26	93.13%	18,965.00	97.57%
其他业务收入	529.11	4.10%	1,087.30	3.83%	1,788.56	6.87%	472.91	2.43%
合计	**12,904.61**	**100%**	**28,395.48**	**100%**	**26,039.82**	**100%**	**19,437.91**	**100%**

公司营业收入90%以上来源于主营业务集成电路封装测试，公司主营业务突出。

公司其他业务收入主要为晶圆（芯片）贸易收入和废品处置收入。晶圆贸易收入主要是公司应部分客户要求为其采购通用规格的晶圆所致。该类客户因单次采购量较小等因素导致其采购价格较高，而公司与晶圆制造企业具有长期的合作关系，能够获得较优惠价格，公司帮助该类客户采购晶圆，有利于降低客户产品成本，巩固双方合作关系。

2、主营业务收入构成分析

（1）按产品类别构成分析

通过加大研发力度以及与科研机构的合作，报告期内公司产品线不断丰富拓展延伸，公司已经具备了批量生产国内技术比较先进的QFN/DFN产品的能力，并且研制出了BGA样品、掌握了Flip-Chip技术，目前正在进行BGA前期生产的准备工作。2011-2014年1-6月，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
DIP	3,479.98	28.12%	7,157.57	26.21%	7,954.26	32.80%	9,767.02	51.50%
SOP	6,670.10	53.90%	14,308.72	52.40%	12,693.55	52.34%	7,968.03	42.01%
SOT	1,815.47	14.67%	5,225.84	19.14%	3,510.97	14.48%	1,229.95	6.49%
QIPAI	356.57	2.88%	596.75	2.19%	92.49	0.38%	-	-
LQFP	53.13	0.43%	19.30	0.07%	-	-	-	-
QFN	0.24	0.00%	-	-	-	-	-	-
总计	**12,375.49**	**100%**	**27,308.18**	**100%**	**24,251.26**	**100%**	**18,965.00**	**100%**

2012年和2013年，公司主营业务收入分别较上年增加27.87%和12.61%，主

要原因是公司在产能紧张的情况下，抓住市场对表面贴装产品需求量大的机遇，调整战略进行产品结构升级，减少对DIP产品的依赖，加大SOP、SOT等中高端系列产品的生产、研发和销售投入，因此该类产品的销售收入增幅较大：2012年和2013年，SOP销售收入分别较上年增加59.31%和12.72%，SOT销售收入分别较上年增加185.46%和48.84%。SOP、SOT产品为表面贴装，其封装形式能大幅减少封装产品的体积，符合电子产品轻薄化的趋势，又适合大规模机械化操作，因此市场对表面贴装封装形式的产品需求巨大。

2014年1-6月公司主营业务收入为12,375.49万元，下降的主要原因是公司无自有生产厂房，2013年公司开始在东莞购买土地进行募投项目建设，为了避免厂房建成后集中搬迁导致的生产中断、人员大幅流失等不利影响，公司在募投项目用地附近租赁厂房并将部分生产工序逐步搬迁。由于公司需要进行跨地区生产管理，以及存在设备安装调试、老员工流失以及新聘员工技能培训等问题，导致短期内部分订单无法及时完成，产能利用率由2013年的89.95%降低至2014年1-6月的74.37%，销售收入随之下降。

（2）按销售区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北	284.84	2.30%	382.71	1.40%	111.45	0.46%	1,428.16	7.53%
华东	3,007.67	24.30%	4,679.46	17.14%	2,349.23	9.69%	3,113.76	16.42%
华南	8,750.56	70.71%	21,844.28	79.99%	21,697.26	89.47%	14,382.11	75.84%
华中	142.85	1.15%	229.62	0.84%	56.04	0.23%	25.82	0.14%
西南	121.60	0.98%	96.50	0.35%	11.94	0.05%	4.41	0.02%
西北	29.22	0.24%	25.88	0.09%	20.74	0.09%	10.74	0.06%
韩国	38.75	0.31%	49.74	0.18%	4.60	0.02%	-	-
合计	**12,375.49**	**100%**	**27,308.18**	**100%**	**24,251.26**	**100%**	**18,965.00**	**100%**

公司产品主要以内销为主，外销占比很低，并且集中在以深圳为主的华南地区，一方面是由于我国是目前全球最大的半导体消费市场，我国半导体市场需求额在2012年已突破全球50%的比重，达到54.1%；另一方面，以深圳为核心的珠三角地区是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，集成电路设计公司将封装和销售环节放在深圳，通过销售环节的快速反应能力，能够更紧密的与客户联系。

（3）按销售季节分析

报告期内，公司主营业务收入按季度构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	4,511.65	36.46%	5,408.58	19.81%	3,762.48	15.51%	3,384.43	17.85%
二季度	7,863.85	63.54%	7,511.38	27.51%	6,143.73	25.33%	5,210.45	27.47%
三季度			7,456.80	27.31%	6,966.47	28.73%	5,518.11	29.10%
四季度			6,931.41	25.38%	7,378.59	30.43%	4,852.00	25.58%
合计	**12,375.49**	**100%**	**27,308.18**	**100%**	**24,251.26**	**100%**	**18,965.00**	**100%**

注：以上数据来源于公司内部统计

总体而言，公司一季度受春节放假等因素影响销售收入占比略低，其余季度销售波动性不是非常显著。

（二）利润来源分析

1、主要利润来源

报告期内，公司的主要利润来源于主营业务集成电路的封装测试，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
DIP	417.89	17.21%	1,107.61	14.65%	1,791.60	23.56%	2,239.09	43.47%
SOP	1,469.97	60.54%	4,402.80	58.24%	4,408.66	57.97%	2,546.33	49.44%
SOT	449.73	18.52%	1,856.99	24.57%	1,364.76	17.95%	365.11	7.09%
QIPAI	65.06	2.68%	181.90	2.41%	39.60	0.52%	-	-
LQFP	25.06	1.03%	10.03	0.13%	-	-	-	-
QFN	0.20	0.01%	-	-	-	-	-	-
合计	**2,427.91**	**100%**	**7,559.33**	**100%**	**7,604.61**	**100%**	**5,150.54**	**100%**

公司的利润主要来源于DIP、SOP、SOT等系列的封装测试，其中SOP、SOT系列产品的毛利在报告期中逐年增加，主要原因是上述封装形式符合电子产品轻薄化的趋势，市场对其需求巨大。报告期内公司抓住市场机遇，主动调整产品结构，加大对该类产品研发和销售的投入，销量增加导致毛利大幅增加。

2、影响公司盈利能力的主要因素

公司管理层认为，影响公司主要盈利能力的主要因素有：

（1）技术工艺创新能力

集成电路封装测试行业属于技术密集型行业，企业需要不断进行技术创新、开发新产品才能适应市场变化，公司的核心技术团队和管理团队大部分拥有15年以上集成电路技术研发和生产管理经验。公司不断对封装测试工艺进行创新性改进，具体表现在对原材料改良和应用技术，采用高密度封装工艺，最终实现原材料利用率提高、生产效率提升、人员工时减少，能耗降低等，降低公司生产成本。

技术工艺创新是公司近年来快速发展、保持成本优势的关键因素，未来公司能否持续地进行技术工艺创新以保证公司的成本领先优势，对保持公司盈利能力的连续性和稳定性至关重要。

（2）行业周期波动

近年来，以智能手机、平板电脑等为主的移动终端产品爆发式增长，成为产业发展的重要支撑；新一代网络通信、物联网、云计算、节能环保等新兴产业的快速发展，将成为推动行业发展的新动力。据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》预计，到“十二五”末集成电路产业规模将再翻一番以上，集成电路产量超过1,500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，因此未来我国集成电路产业依然具有广阔的市场前景。

但是集成电路的发展基本上按照摩尔定律演进，产业技术、市场也呈现周期性的波动。作为全球电子产品制造大国和消费大国，近年来我国集成电路产业规模虽快速增长，但自2007年以来受国际经济形势影响而在宏观环境不景气的年份出现过下滑。

作为行业内具有成本领先优势的企业，公司的盈利能力会随着行业前景不断向好而持续增强。但如果集成电路行业遭遇到比较大的外部冲击，导致整个行业增速放缓甚至下降，公司的盈利也将受行业影响而出现不利情况。

（三）利润表项目分析

1、营业收入

营业收入分析详见本节之“（一）营业收入分析”。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本分别为10,254.39万元、20,388.55万元、18,181.74万元和14,183.33万元，随着公司营业收入增加而增长。其中，主营业务成本情况如下：

（1）主营业务成本按产品类型分析

报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
DIP	3,062.09	30.78%	6,049.96	30.63%	6,162.66	37.02%	7,527.93	54.49%
SOP	5,200.09	52.28%	9,905.93	50.16%	8,284.89	49.77%	5,421.70	39.25%
SOT	1,365.74	13.73%	3,368.85	17.06%	2,146.21	12.89%	864.84	6.26%
QIPAI	291.51	2.93%	414.85	2.10%	52.89	0.32%	-	-
LQFP	28.06	0.28%	9.27	0.05%	-	-	-	-
QFN	0.04	0.00%	-	-	-	-	-	-
合计	**9,947.53**	**100%**	**19,748.85**	**100%**	**16,646.65**	**100%**	**13,814.46**	**100%**

报告期内，公司主营业务成本占比较大的为DIP、SOP、SOT产品，与其收入占主营业务收入的比例基本相符。

（2）主营业务成本按生产要素分析

报告期内，公司营业成本按生产要素构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	4,630.03	46.54%	10,334.94	52.33%	9,372.74	56.30%	8,548.20	61.88%
人工	1,849.27	18.59%	2,986.74	15.12%	1,808.74	10.87%	1,151.98	8.34%
制造费用	3,468.23	34.87%	6,427.17	32.54%	5,465.17	32.83%	4,114.28	29.78%
合计	**9,947.53**	**100%**	**19,748.85**	**100%**	**16,646.65**	**100%**	**13,814.46**	**100%**

报告期内，公司成本中原材料占成本的比例逐年减少，主要是公司产品结构调整所致。DIP系列产品从2011年占营业收入的51.50%下降到2014年1-6月的28.12%，SOP、SOT产品则从2011年占营业收入的48.50%上升到2014年1-6月的68.57%，SOP、SOT系列产品的体积远小于DIP系列产品，生产单个产品所需的原材料也远少于DIP系列产品，也导致公司成本中原材料占比逐年下降。

报告期内，公司成本中人工和制造费用的占比逐年提高，其中2013年和2014年1-6月占比较高，主要原因是子公司广东气派投产需要增加设备和人员，此外

由于设备搬迁导致生产效率和产能利用率下降亦使得人工和制造费用部分提升。

（3）主要原材料价格波动

报告期内，公司主要原材料引线框、丝材和塑封树脂，价格总体呈稳定态势：①公司原材料引线框主要由铜组成，其价格受铜价的影响较大，报告期内价格波动与铜价的走势基本一致；②公司原材料丝材分金丝、合金丝和铜丝，其中金丝价格波动与金价的走势相关，合金丝和铜丝则因为其制造过程中工艺比较复杂，其金属材料占比较低，价格波动与金属材料价格关联度不大；③公司原材料塑封树脂在报告期内其价格呈现较为稳定的趋势。

3、期间费用

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	162.84	1.26%	264.29	0.93%	168.97	0.65%	94.99	0.49%
管理费用	1,161.67	9.00%	2,241.62	7.89%	1,831.61	7.03%	1,568.30	8.07%
财务费用	-72.67	-0.56%	56.14	0.20%	327.15	1.26%	80.93	0.42%
合计	**1,251.84**	**9.70%**	**2,562.05**	**9.02%**	**2,327.73**	**8.94%**	**1,744.21**	**8.97%**
营业收入	**12,904.61**		**28,395.48**		**26,039.82**		**19,437.91**	

报告期内，公司期间费用金额变动不大，占营业收入的比例较为稳定，公司费用控制能力较强，具体分析如下：

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用分别为162.84万元、264.29万元、168.97万元和94.99万元，销售费用逐年递增，主要原因是随着公司生产经营规模和产能不断增加，销售人员工资和运输费用增加所致。

报告期内，公司销售费用详情如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
工资	97.39	152.66	101.41	53.52
汽车费用	18.03	16.33	11.24	16.52
折旧及摊销	1.62	7.25	7.99	5.89
广告费用	0.93	23.48	20.44	0.55
运输费用	26.85	64.56	27.89	18.50
其他	18.03	-	-	-
合计	**162.84**	**264.29**	**168.97**	**94.99**

公司销售费用整体规模较小，一方面是由于公司采用订单模式生产，客户主要集中在深圳及附近地区且相对稳定，销售机构精简，销售人员的差旅费用较低；另一方面是公司通过自有车辆送货、客户自提或者快递的方式配送货物，深圳地区主要以公司自有车辆配送或客户自提为主，其余地方主要以快递配送为主，从而使得运输费用也较低。

2013年公司运输费用较2012年增加36.67万元，主要原因是2013年公司为了保证货物准时安全送达将快递公司更换为顺丰速运所致。此外，华南地区以外的销售收入增长亦使得运输费用部分增加。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用分别为1,161.67万元、2,241.62万元、1,831.61万元和1,568.30万元，占营业收入的比例比较稳定地维持在8%左右。公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
研究开发费用	605.99	1,229.34	1,187.50	1,246.15
职工薪酬及劳务费	296.86	599.04	240.93	173.83
办公、差旅应酬费等	29.88	117.40	104.78	23.34
折旧、摊销费等	27.19	44.62	28.14	60.74
中介机构费用	64.54	32.18	89.36	-
印花税	10.54	30.76	14.35	3.55
股份支付	-	79.00	-	-
其他	126.67	109.27	166.55	60.69
合计	**1,161.67**	**2,241.62**	**1,831.61**	**1,568.30**

报告期内公司管理费用随着经营规模扩大而增加，但其占营业收入的比例逐年下降，公司有较强的费用控制机制。

2013年11月，公司高管入股20万股，价格4元/股，高于每股净资产金额；12月吸收外部投资者入股680万股，入股价格7.95元。因高管与外部投资者入股均在同期，且相隔时间很短，为此，公司按照与外部投资者相同的每股价格确认高管的股份支付金额79万元，分别计入2013年管理费用和资本公积。

（3）财务费用

报告期内，公司财务费用分别为-72.67万元、56.14万元、327.15万元和80.93万元，占营业收入的比例较小，财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出	0.55	196.06	234.25	83.36
减：利息收入	81.24	142.53	61.28	40.44
手续费	2.61	11.96	4.43	8.15
汇兑损益	0.84	-25.69	-0.45	-68.73
其他	4.58	16.34	150.20	98.60
合计	**-72.67**	**56.14**	**327.15**	**80.93**

2012年公司财务费用大幅增加至327.15万元，主要原因是公司在2012年增加国家开发银行长期贷款3,000万元所致。

2013年和2014年1-6月公司财务费用大幅降低，主要原因是投资者增资入股后利息收入增加以及归还银行贷款后利息支出降低所致。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要为坏账准备和存货跌价准备，具体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
坏账损失	25.30	42.86	109.41	45.21
存货跌价损失	25.92	1.30	-	-
合计	**51.22**	**44.15**	**109.41**	**45.21**

5、营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
处置非流动资产利得小计	-	0.58	-	56.01
其中：处置固定资产利得	-	0.58	-	56.01
政府补助	18.75	140.05	93.73	66.00
其他	0.63	5.38	3.39	0.89
合计	**19.38**	**146.01**	**97.12**	**122.90**

报告期内，除2011年处置机器设备获得56.01万元外，公司营业外收入主要来自于政府补助，政府补助情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
工业中小企业技术改造（技术创新成果转化应用）项目中央预算内投资	15.85	-	-	-
深圳市龙岗区科技资金补助款	2.90	-	1.60	50.00
深圳市支持骨干企业加快发展奖励基金	-	31.00		16.00

科技型中小企业技术创新基金贷款贴息	-	-	48.00	-
进口设备贴息资金	-	51.31	29.13	-
科技研发资金贷款贴息	-	27.04	15.00	-
产学研结合引导项目资金补贴	-	30.00	-	-
专利申请资助补贴	-	0.70	-	-
合计	**18.75**	**140.05**	**93.73**	**66.00**

6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失小计	-	-	0.87	-
其中：固定资产处置损失	-	-	0.87	-
公益性捐赠支出	-	12.28	2.00	-
其他	-	0.06	0.79	0.16
合计	**-**	**12.34**	**3.66**	**0.16**

报告期内，公司营业外支出每年金额均很小，主要为公益性捐赠支出。

（四）毛利率分析

1、综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	12,904.61	28,395.48	26,039.82	19,437.91
营业成本	10,254.39	20,388.55	18,181.74	14,183.33
营业毛利	2,650.22	8,006.93	7,858.08	5,254.58
综合毛利率	20.54%	28.20%	30.18%	27.03%

2011年-2013年，公司综合毛利率分别为27.03%、30.18%和28.20%，保持在27%-30%左右，比较稳定。2014年1-6月，由于公司将部分生产设备搬迁至东莞子公司导致生产效率下降，产能利用率由2013年的89.95%大幅降低至2014年1-6月的74.37%，单位制造费用上升，使得综合毛利率下降至20.54%。

2、主营业务毛利率构成分析

公司主营业务为集成电路封装测试，各类产品毛利金额及其比重情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
DIP	417.89	17.21%	1,107.61	14.65%	1,791.60	23.56%	2,239.09	43.47%

SOP	1,470.02	60.55%	4,402.80	58.24%	4,408.66	57.97%	2,546.33	49.44%
SOT	449.73	18.52%	1,856.99	24.57%	1,364.76	17.95%	365.11	7.09%
QIPAI	65.06	2.68%	181.90	2.41%	39.60	0.52%	-	-
LQFP	25.06	1.03%	10.03	0.13%	-	-	-	-
QFN	0.20	0.01%	-	-	-	-	-	-
合计	**2,427.96**	**100%**	**7,559.33**	**100%**	**7,604.61**	**100%**	**5,150.54**	**100%**

从上表可以看出，报告期内SOP、SOT和DIP系列产品的毛利和占比的变动对公司综合毛利率影响较大。其余产品由于其收入占比很小，对公司综合毛利率变动的影响有限。

3、毛利率变动分析

毛利率变动主要受销售单价、单位成本和产品结构的影响。报告期内，公司产品销售单价、单位成本以及分产品毛利率情况如下：

单位：元/颗

产品/项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
DIP	12.01%	28.12%	15.47%	26.21%	22.52%	32.80%	22.93%	51.50%
SOP	22.04%	53.90%	30.77%	52.40%	34.73%	52.34%	31.96%	42.01%
SOT	24.77%	14.67%	35.53%	19.14%	38.87%	14.48%	29.69%	6.49%
QIPAI	18.25%	2.88%	30.48%	2.19%	42.82%	0.38%	-	-
LQFP	47.18%	0.43%	51.98%	0.07%	-	-	-	-
QFN	83.84%	0.00%	-	-	-	-	-	-
综合单价		0.0956		0.0937		0.1032		0.1239
综合单位成本		0.0768		0.0678		0.0708		0.0902
综合毛利率		19.62%		27.68%		31.36%		27.16%

（1）2012年与2011年变动分析

公司2012年毛利率比2011年提高4.20个百分点，其原因：一方面是由于产品销售结构调整所致，毛利率较高的SOP、SOT系列销售占比从2011年48.50%提升至2012年66.82%；另一方面是由于公司通过生产工艺改进，提升了生产效率，降低了单位生产成本所致。如IDF型高密度大矩阵引线框技术在SOP产品中的应用以及铜制程工艺在SOT产品中应用，极大地提高了产品的生产效率，降低了产品成本单位，从而提升了该类产品毛利率。

（2）2013年与2012年变动分析

公司2013年毛利率比2012年下降3.68个百分点，其主要原因是由于2013年下半年公司对部分生产线进行搬迁导致生产效率下降所致。

集成电路封装涉及的产品种类繁多，对封装企业的生产组织能力和质量管理要求很高。2013年下半年将部分生产线从深圳迁至公司东莞募投项目厂区附近，一方面将原本紧凑型生产管理团队一分为二，导致生产管理能力有所下降，另一方面部分生产熟练工随迁后流失，导致生产效率下降。上述原因导致公司产能利用率由2012年度的95.07%下降至2013年的89.95%。

（3）2014年1-6月与2013年变动分析

尽管2014年上半年公司完成了位于深圳无房产证厂房的生产线整体搬迁，但短期内厂房搬迁对生产经营的影响依然存在。

公司2014年1-6月毛利率比2013年下降8.06个百分点，其主要是由于公司对生产线进行搬迁，生产效率下降，产能利用率由2013年的89.95%下降至2014年1-6月的74.37%所致。

4、同行业上市公司毛利率对比分析

报告期内，同行业上市公司与公司综合毛利率比较情况如下：

公司名称	综合毛利率			
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
气派科技	20.54%	28.20%	30.18%	27.03%
长电科技	20.68%	19.80%	14.24%	17.91%
华天科技	22.60%	21.53%	18.87%	18.79%

从上表可以看出，2011年、2012年、2013年公司产品毛利率明显高于同行业上市公司，其原因主要是由于公司产品单位成本较低所致；2014年1-6月公司产品毛利率与同行业上市公司相当，其主要是由于公司厂房搬迁导致生产效率下降，从而使得公司产品毛利率下滑所致。

封装行业企业的产品成本主要为封装芯片的原材料成本、单位人工以及单位制造成本，因此用于封装芯片的原材料耗用以及单位产品的生产效率高低直接决定着封装企业的产品毛利率。

近几年来，集成电路的发展基本上按照摩尔定律演进，同等性能的芯片每隔18个月尺寸大幅缩小。在此技术更新背景下，发行人作为封装行业后入者，适时根据芯片尺寸缩小的发展趋势，经过不断研发，在产品生产上进行了IDF型高密度大框架矩阵引线框、塑封模具流道设计优化等工艺创新和改进，使得封装芯片

原材料耗用大幅减少，以及生产效率提升所带来的单位人工、单位制造费用的降低，从而降低了公司产品单位成本，提升了公司产品毛利率水平。

5、毛利率敏感性分析

（1）产品销售价格对公司利润影响的敏感性分析

报告期内，若产品成本、销售量等其他因素均不变，则产品的销售价格对公司利润影响的敏感性分析如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
销售价格增加 1%	0.80%	0.72%	0.68%	0.72%

（2）原材料对公司利润影响的敏感性分析

公司产品的主要原材料为引线框、丝材和塑封树脂，若销售价格和其他生产要素价格不变，公司原材料、制造费用对公司利润影响的敏感性分析如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
原材料增长 1%，其他保持不变	-0.37%	-0.38%	-0.39%	-0.45%
制造费用、人工增长 1%，其他保持不变	-0.43%	-0.34%	-0.30%	-0.28%

（五）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益的具体构成详见本招股说明书“第十节财务会计信息”之“五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表”。

报告期内，公司非经常性损益及其对净利润的影响情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
（一）非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	0.58	-0.87	56.01
（二）越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-	-	140.91	108.88
（二)计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	18.75	140.05	93.73	66.00
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.63	-6.95	0.61	0.72
（四）其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-79.00	-	-
非经常性损益合计	19.38	54.67	234.38	231.61

减：所得税影响金额	2.91	20.05	11.68	14.73
扣除所得税影响后的非经常性损益	16.47	34.62	222.69	216.88
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	16.47	34.62	222.69	216.88
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-

报告期内，归属于公司股东非经常性损益分别为19.38万元、54.67万元、234.38万元和231.61万元，其占利润总额比重较低，不会对公司盈利的持续性和稳定性造成重大不利影响。

三、现金流量分析

（一）现金流量情况

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动流入现金小计	13,674.34	22,084.56	19,729.05	16,377.18
经营活动流出现金小计	10,081.18	14,918.91	14,290.00	11,393.56
经营活动产生的现金流量净额	3,593.16	7,165.65	5,439.05	4,983.63
投资活动流入现金小计	300.00	39.20	17.09	708.30
投资活动流出现金小计	5,401.47	6,385.42	4,998.69	5,897.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,101.47	-6,346.22	-4,981.59	-5,189.30
筹资活动流入现金小计	-	5,486.00	5,786.00	2,270.61
筹资活动流出现金小计	3,235.18	1,748.24	4,023.46	1,585.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,235.18	3,737.76	1,762.54	685.58
现金及现金等价物净增加额	-4,743.49	4,557.20	2,219.99	479.91
期末现金及现金等价物余额	2,823.17	7,566.65	3,009.45	789.46

由于处于发展时期，公司目前经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量符合自身的经营状况。报告期内，公司在主要依靠内部留存收益的基础上较好地实现了可持续发展，现金流基本能满足生产和投资活动对资金的需求。

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为3,593.16万元、7,165.65万元、5,439.05万元和4,983.63万元，分别占对应期间实现净利润的328.85%、154.82%、115.28%和158.19%。

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	1,092.64	4,628.51	4,717.98	3,150.35
加：资产减值准备	51.22	44.15	109.41	45.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,265.95	2,133.97	1,599.21	1,092.24
无形资产摊销	7.55	3.99	0.65	-
长期待摊费用摊销	68.54	84.12	80.73	49.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-0.58	0.87	-56.01
财务费用（收益以“－”号填列）	0.55	196.06	358.85	113.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-79.48	-61.08	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-515.46	-809.54	-918.07	-397.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,149.36	-2,995.38	-2,977.25	-2,076.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-447.69	3,862.43	2,466.67	3,063.65
其他	-	79.00	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,593.16	7,165.65	5,439.05	4,983.63

报告期内，公司经营活动现金流量净额均大于净利润，主要原因是公司固定资产金额很大，因此每年产生的折旧也较多，而折旧只影响净利润，不影响现金流量，此外应付款项亦增加较多，导致经营活动现金流量净额与净利润差别较大。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,101.47万元、-6,346.22万元、-4,981.59万元和-5,189.30万元，均为负数且金额较大，主要是公司为了扩大产能，购买机器设备产生的投资支出。因为集成电路封装测试属于资金密集型行业，生产设备大部分为价值较高的先进精密设备，导致公司每年购买设备的支出较多。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-3,235.18万元、3,737.76万元、1,762.54万元和685.58万元。2011年筹资活动现金流量净额较低，主要是当年公司偿还银行借款1,200万元和向公司股东发放现金股利410.00万元所致；2012年和2013年筹资活动现金流量净额较高，主要是该两年公司进行了增资，收到股东投资款导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

（二）资本性支出

1、报告期内资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出分别为5,401.47万元、6,085.42万元、4,998.69元和5,897.60万元，公司的资本性支出主要用于购置生产设备、土地和建设厂房，与公司的主营业务有关。

随着进一步开拓国际市场以及客户对交货期、装备水平等方面要求的提高，目前公司紧张的产能已经不能满足公司客户越来越高的要求，未来必须加大机器设备、厂房等资本支出，通过购买先进精密设备，降低公司生产对人工的依赖，提高生产效率，缩短生产周期，从而有效降低库存商品的数量，提高存货周转率和应收账款周转率，提高企业的产品竞争力和经营效益。

2、未来可预见的重大资本性支出

截至本招股书签署日，除本次股票发行募集资金投资项目外，本公司未计划进行其他的重大资本性支出。

四、其他事项说明

（一）重大会计政策及会计估计差异或变更

报告期内，公司重大会计政策及会计估计未发生变更，与同行业上市公司基本一致，不存在较大差异。

（二）重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至本招股书签署日，发行人不存在为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债，无未决诉讼或仲裁形成的或有负债，也无其他或有事项和重大期后事项。

五、财务状况和盈利能力未来趋势分析

（一）财务状况未来趋势分析

1、公司财务优势

（1）公司主营业务突出，盈利能力强

公司主营业务收入主要来源于集成电路封装测试，主营业务突出。公司净资

产收益率较高，具有较强的持续盈利能力和获取经营性现金流的能力，收入和盈利具有连续性和稳定性。

（2）公司成本控制能力强，保障盈利水平

公司具有较强的成本控制意识，一方面采取工艺创新降低原材料成本，另一方面加强提升机器设备利用效率，为公司保持较高的毛利率提供了保障。公司生产设备技术先进，设备成新率较高，为公司持续稳定发展提供了有力保证。

（3）公司信用良好，资产周转效率高

公司资信良好，资产负债率较低，未发生过逾期偿还银行借款和拖欠供应商货款的情况，在银行和供应商拥有良好的信用信誉。公司流动资产的周转率较高，偿债能力较强，财务风险较低。

2、公司财务困难

由于国家对集成电路行业多项支持性政策，以及我国集成电路产业市场前景广阔，公司自设立以来发展速度一直较快，投入大量资金用于添置新的机器设备以扩大经营规模。随着公司未来调整产品结构，逐步转向更为高端的QFN/DFN、BGA等封装形式产品，公司对固定资产投资的资金需求将会更加强烈。公司主要依靠银行贷款、留存利润和股东投入资金，融资渠道较少，无法早日实现产品结构升级，资金瓶颈制约了公司生产、销售规模的进一步扩大。此外，面对日益激烈的市场竞争，公司的规模和抗风险能力需要进一步增强，因此公司急需向资本市场直接融资，满足公司未来发展，增强公司盈利能力。

（二）盈利能力未来趋势分析

经过多年发展，公司生产规模不断扩大，品牌知名度逐步提高，新开发产品持续增加，为公司未来良好发展奠定了扎实的基础。公司将充分利用现有的技术、人才、创新、质量、管理、服务和地域等方面优势，通过加大工艺创新、开发新产品等措施，针对客户对集成电路封装测试的需求变化，培育公司新的利润增长点。

公司未来将充分利用国家鼓励集成电路发展的政策，抓住行业发展机遇，立足主业，不断进行工艺创新，降低产品生产成本，扩大生产规模，进一步增强公司的盈利能力。通过本次募投项目的实施，公司产品结构将更趋完善，研发和创

新能力将进一步提高，市场竞争能力和盈利能力将进一步增强。随着我国对集成电路产业的大力支持，集成电路封装测试行业将面临广阔的发展机遇，公司本次募投项目实施后，公司将紧随集成电路封装测试行业的发展步伐，实现产品升级，拓展盈利空间。

六、未来分红回报规划

（一）分红规划的决策程序

1、公司分红回报规划

在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的20%，且在任何3个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。

2、公司分红回报规划制定原则及制定时已考虑的因素

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。公司上市后的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，并优先选择有利于投资者分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策。公司上市后的现金分红应当与公司上市的招股说明书载明的股东回报规划、现金分红政策和现金分红承诺保持一致，维持现金分红的连续性和稳定性。

公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求。

3、制定未来分红回报规划已履行的决策程序

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性，增加股利分配政策透明度和可操作性，2014年9月13日，气派科技召开了2014年第四次（临时）股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》，对利润分配的原则、利润分配的形式和期间间隔、利润分配的具体内容和条件、利润分配政策

及其调整的决策程序和机制，以及其他规范性要求。公司董事会还制定了《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》并经2014年第四次（临时）股东大会通过。

（二）未来分红回报规划的合理性

公司目前已经成为国内集成电路封装测试行业的先进内资企业之一，盈利能力较强，现金流量状况良好、稳定，同时公司资产负债率合理，银行信用良好，预计通过募集资金或适度债务融资能够满足目前规划的重要资本性支出。

近几年，公司发展速度较快，本次发行上市后，通过募集资金建设将进一步提升产能、提升研发能力，预计未来公司仍将能够实现良好的业绩，为全体股东创造更多的效益。

综合以上因素以及未来公司不断发展对流动资金需求的变化、研发项目产业化等各种可能面临的风险与新的机遇，公司以谨慎的态度，制定了未来分红回报规划，并确定现金分红比例。

（三）未来三年分红回报计划的依据和可行性

根据公司目前经营情况和未来发展规划，预计公司上市后三年内尚需要一定规模的资金支持进行产能扩张、实施募投项目等，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。公司未来利润分配计划将以全体股东利益最大化为基础，着眼于企业长远和可持续发展，在兼顾公司快速发展的同时，重视对股东尤其是中小股东的合理投资回报。

综合上述因素分析，公司制定的利润分配计划具有可行性，公司经营发展状况和未来发展目标能够保证利润分配计划的顺利实施。

七、财务状况和盈利能力未来趋势的分析

（一）主要财务优势

公司应收帐款周转率、存货周转率和总体资产周转率与可比上市公司基本持平，公司的盈利水平较高，报告期内公司的综合毛利率分别为20.54%、28.20%、30.18%和27.03%。

报告期内，公司资产质量较高，不存在高风险资产和非生产经营资产，且公

司资产减值准备计提充分、合理，与资产质量实际情况相符，符合谨慎性原则。

本次发行后，有利于公司扩大产能，降低资产负债率，增强抗财务风险能力，有利于进一步扩大债务融资规模，利用财务杠杆，提高资本收益率。

（二）主要财务困难

报告期内，公司资金需求主要依靠银行借款、留存收益和股东投入等方式，缺少融资渠道，这在一定程度上制约了公司主营业务规模的进一步扩张。公司负债大部分为流动负债，资本结构不够合理，公司需要进一步拓宽融资渠道，通过首发上市直接融资，建立长期资金来源，优化资本结构，支撑业务不断发展的需求。

（三）公司未来发展趋势

目前公司依靠制造技术和质量管理优势、品牌优势、区位优势等，获得了下游客户的认同。公司拟申请公开发行股票并上市，通过实施募投项目，扩大公司产能，提高公司的研发设计能力，加强公司营销网络建设，有利于更好地满足客户需求、提升市场份额、优化公司财务结构，提高企业的盈利能力。

第十二节 业务发展目标

一、公司总体发展目标和战略

公司秉承“严谨、高效、创新、发展”的经营理念，紧跟市场需求，积极扩充产能，加强市场开拓，加强自有创新工艺技术、领先成本和质量管理优势；积极展开与高等科研院校、国际知名企业的合作，全面提升公司的研发实力。致力于在3-5年内把公司打造成“中国一流的封装测试服务商”。

二、未来三年的发展规划

公司作为半导体封装测试企业，紧贴全球的网络通信、消费电子、自动化设备、家用电器等生产中心，恪守“质量为先，信誉为重；管理为本，服务为诚；精益求精，客户满意”的质量方针，以“严谨、高效、创新、发展”的理念，提升品质管理体系；立足目前已有的Qipai、DIP、SOP、ESOP、TSSOP、SSOP、SOT、LQFP等优势产品系列，积极拓展QFN/DFN、BGA等中高端封装市场。

（一）生产规模扩张计划

公司已启动用地面积66,670.09平方米、房产规划总建筑面积为171,239.06平方米的生产和研发建设项目，其中一期工程9.5万平方米拟于2015年上半年完工，2017年全部建成后新增产能30亿只/年，届时公司年封装能力超70亿只，产销规模大幅提升。

（二）产品结构提升完善计划

公司将继续巩固SOT、SOP、Qipai等系列产品的高性价比优势，加大QFN/DFN等技术先进性产品的生产比重，并拓展Flip-chip、BGA、CSP、WLCSP、SIP等中高端市场，在保持工艺技术创新及应用和成本领先优势的基础上，不断提高公司产品的技术层级，完善产品结构，提升盈利水平。

（三）研发中心建设计划

为顺应行业发展趋势、进一步提升公司的技术工艺创新及应用、新产品开发和原材料改良技术，公司拟建设研发中心。规划新建5000平方米的研发办公场地及封装测试技术实验室，添置研发所需的国内外先进设备，引进和培养优秀人才，

以进一步增强公司的研发实力，巩固公司在行业内的技术优势。

人才引进和技术创新：公司计划引进一定数量的研发技术人才，对关键技术工艺进行攻关，解决Flip-Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP和TSV的关键技术和工艺难题，逐步形成批量生产能力。

研发设备购置：新增超薄减薄机、超薄划片机、SMT、植球机、自动塑封机、测试机等系列先进的研发设备，规划研发设备购置金额3,264.90万元，为公司的技术攻关和工艺创新打下较为坚实的基础。

（四）市场开拓及品牌建设计划

目前公司的主要客户群集中于华南区域，未来3-5年公司将在继续巩固华南区营销优势的基础上，采取以下市场开拓策略：

在国内市场，公司将在华东设立办事处，大力开发华东集成电路产业集聚区的客户，并有针对性地开发北京、西安、成都等IC设计企业密集的区域，采用集中拜访、专项突破的策略抢占市场。

在国际市场，借助深圳总部毗邻香港、台湾的地理优势，成立专门的海外销售团队，大力拓展台湾、香港地区客户，发掘当地经销商，与优质经销商展开合作，借助其资源优势逐步打开韩国、日本及欧美市场。

同时，对外宣传方面，公司将加大平面媒体、互联网宣传力度，同时参加有影响力的行业展会、行业论坛及研讨会，以提升公司品牌形象和市场知名度。

（五）人力资源发展计划

公司重点招聘和任用经营管理人才和专业技术人才，充实公司研发、生产、营销和管理等部门，促使内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展和提高的技能要求，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。

公司将不断调整人才结构，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的要求。

公司将积极探索和不断完善具有竞争力的绩效评价体系和激励机制，实现人力资源的可持续发展，为公司的快速发展提供人才保障。

（六）管理体系优化和效率提升计划

公司已全方位导入全面质量管理体系，提升质量管理水平以满足客户更高层次需求。未来几年，公司将本着“以客户为中心、管理层支持、实事求是、全员参与”的原则，更加有针对性的满足客户要求，继续推行全面质量管理和建立内部持续改进机制，细化公司的管理制度、质量目标和岗位职责，加强过程控制及供应商管理，提升品质管控及测量能力，及时改善品质问题，从而提升整体管理水平、提高客户服务能力和客户满意度。

（七）再融资计划

本次募集资金到位后，将基本解决公司近期发展所需的资金缺口，优化财务结构，降低资产负债率。公司将根据未来的发展需要和公司财务状况，选择合适的方式进行融资。

三、拟定上述规划所依据的假设条件及面临的主要困难

（一）拟定上述规划所依据的假设条件

本公司实现上述规划所依据的假设条件为：

1、公司所遵循的国家和地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大改变；

2、国家宏观经济继续平稳发展；

3、本次公司股票发行上市能够成功，募集资金顺利到位；

4、募集资金投资项目能够顺利实施和完工，并取得预期收益；

5、公司所处行业与市场环境未发生重大恶化；

6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动；

7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。

（二）实施上述规划将面临的主要困难

实施上述发展战略和规划主要面临两方面的困难：

1、资金瓶颈

上述规划的实施，需要投入大量的资金购买相关的机器设备。目前，公司主要通过股东增资方式、留存收益以及银行贷款方式进行融资，渠道比较单一，无法帮助公司迅速壮大和发展；且债务融资成本过高，还本付息的压力大，容易产生财务风险。因此，本次首次公开发行股票对公司持续、快速的发展具有重要的战略意义，能够帮助公司迅速募集大量的资金从而实现上述业务目标。如果本次股票发行不能成功，将影响公司计划项目的顺利实施及战略目标的实现。

2、人才约束

随着生产和销售规模的扩大，公司需要大量的研发、管理和销售人才，尤其是具有国际背景的销售人员，这对公司成功开拓国外市场具有重要的作用。公司必须不断丰富和加强人才储备，持续提升行业地位。

四、上述业务发展规划与现有业务的关系

上述业务发展规划是在本公司现有业务的基础上，通过技术改造、产业升级和规模化生产，进一步提升市场份额和可持续发展能力。业务发展规划扩大了生产规模，提高了产品的技术含量和附加值，优化了产品结构，拓展了市场的深度和广度，有利于巩固并进一步提升行业地位。因此，公司现有业务是发展规划的基石，发展规划是现有业务的深化、完善和提高。

五、本次募集资金对实现上述业务目标的作用

本次募集资金的运用对于公司实现上述业务目标具有关键作用。通过本次股票公开发行，公司不仅解决了快速发展过程中所面临的资金瓶颈问题，同时建立了直接融资渠道，改变单一依靠间接融资的局面。

本次募投项目的顺利实施，将提升公司产品的技术含量，扩大公司的生产规模，增强业务利润增长能力，提高研发水平，增加市场份额，巩固公司核心竞争力，为实现公司的战略目标奠定良好基础。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）预计募集资金总量及拟投资项目

2014年9月13日，公司召开2014年第四次（临时）股东大会，全体股东一致同意本次募集资金将用于以下2个项目，项目总投资基本情况如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	建设期	项目的审批、核准或备案情况
1	先进集成电路封装测试扩产项目	36,527.83	4 年	已在广东省发改委备案（备案号：141900405319004）
2	研发中心建设项目	4,921.51	2.5 年	已在广东省发改委备案（备案号：141900405319005）

其中，先进集成电路封装测试扩产项目建设期为4年，研发中心建设项目建设期为2.5年。项目所需资金将根据实施进度分期投入使用，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	T+12	T+24	T+36	T+48	合计
1	先进集成电路封装测试扩产项目	10,986.85	11,864.11	8,286.96	5,389.91	36,527.83
2	研发中心建设项目	1,973.84	1,271.72	1,675.95	-	4,921.51

项目的实施主体均为公司全资子公司广东气派，公司拟通过增资等合法方式将本次发行募集资金投入广东气派。

（二）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金少于投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷款予以解决。

（三）募集资金专户存储安排和使用制度

公司2014年9月13日召开的2014年第四次（临时）股东大会审议通过了《气派科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，募集资金到位后，公司董事会将在银行开设专门的募集资金管理账户，专户存储和管理募集资金，并在募集资金到位后规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管

协议，按照证监会和交易所的相关规定进行资金使用和管理。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）先进集成电路封装测试扩产项目

1、项目概况

本项目为先进集成电路封装测试扩产项目，项目的实施将优化公司产品结构，改善公司现有产能不足的生产状况，提升公司的市场占有率，增强公司的竞争优势，对公司的长远发展具有重要的意义。

本项目实施主体为本公司的全资子公司广东气派，项目建设周期为4年，建设地点为广东省东莞市石排镇福隆第二工业区二路。项目建成后，公司将新增年封装产能SOT5亿只、SOP13亿只、QFN/DFN5亿只和BGA3,500万只的加工能力。项目预计总投资36,527.83万元，其中建设投资31,888.40万元。

2、项目相关产品概述

公司募投项目围绕封装产品主要市场需求开展的，为SOT、SOP、QFN/DFN和BGA等表面贴装型封装产品的扩产，上述产品在未来3-5年内为封装行业主流技术产品，市场需求空间巨大，具体情况如下：

（1）SOT

SOT（Small Outline Transister小型晶体管封装）具有引脚少、体积小、批量化生产成本低等特点，适用于微小型分立器件（二三极管、MOS管等）及外形尺寸极小、厚度薄的IC芯片封装，其产品广泛应用于电脑、手机、家用电器、汽车、便携式电子产品等领域。

（2）SOP

SOP（Small Outline Package小外形封装）是目前普及最广的表面贴装封装，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L字形），引脚中心距1.27mm。SOP封装技术开发成功以后逐渐派生出SOJ（J型引脚小外形封装）、TSOP（薄小外形封装）、VSOP（甚小外形封装）、SSOP（缩小型SOP）、TSSOP（薄的缩小型SOP）及SOT（小外形晶体管）、SOIC（小外形集成电路）等。

SOP是目前国内集成电路市场的主流产品之一，具有体积相对较小、速度快等特点，非常适合工业化生产，其产品主要应用于便携消费电子、小家电、智能玩具等领域。

（3）QFN/DFN

QFN（Quad flatnon-leaded package四侧无引脚扁平封装）四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比QFP小，高度比QFP低。

QFN具有生产效率更高、体积更小、信号传输好、引脚短、焊线长度短、延时性短等特点，更易于规模化生产，可用于笔记本电脑、数码相机、平板电脑、智能手机等便携式消费电子产品。

DFN是一种与QFN类似的双边无引脚扁平封装，封装出来的IC比SOP更小。

（4）BGA

BGA（Ball Grid Array Package球栅阵列封装），在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚，在印刷基板的正面装配LSI芯片，然后用模压树脂或灌封方法进行密封，也称为凸点陈列载体（PAC）。引脚可超过200，是多引脚LSI用的一种封装，封装本体也可做得比QFP（四侧引脚扁平封装）小。采用BGA技术封装的内存，可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍，BGA与TSOP相比，具有更小的体积，更好的散热性能和电性能，其产品主要应用于各类存储器、电脑用晶片组、数字相机、数字摄像机、掌上电脑、笔记本电脑等领域。

3、项目建设必要性和可行性分析

（1）项目建设的市场前景分析

作为全球电子产品制造大国和消费大国，过去几年，我国集成电路产业规模虽快速增长，但产品自给率较低，大量产品仍需要依靠进口，未来无论是国内需求增长潜力还是进口替代空间都非常大。近年来，以智能手机、平板电脑等为主的移动终端产品爆发式增长，成为产业发展的重要支撑。而新一代网络通信、物联网、云计算、节能环保等新兴产业的快速发展，成为推动集成电路产业发展的新动力。

集成电路封装市场容量情况及发展趋势详见本招股说明书“第六节业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）公司所处行业发展情况”之“2、封装测试行业发展概况”。

（2）项目建设的必要性分析

①有利于推动国内集成电路产业的发展

从整个半导体行业来看，美、日、欧等发达国家和地区仍然占据了绝对的优势地位，上述国家和地区的厂商占据了全球半导体销售市场80%左右的份额。就集成电路封装产业而言，目前已逐步从欧美发达国家向亚太地区转移，亚洲各国占集成电路封装产业市场的70%左右。中国是近年来集成电路市场成长最快的地区之一。我国集成电路产业销售规模占全球产业销售收入比重呈逐年上升的态势，2013年占全球总产业的13.25%，国内集成电路产业的发展对全球产业的影响越来越突出。

作为全球电子产品制造大国和最大的需求市场，过去几年，我国集成电路产业规模虽快速增长，但产品自给率只有20%左右，大量产品仍需要依靠进口，未来无论是国内市场需求增长潜力还是进口替代空间都非常大。

目前，集成电路产业越来越显示出产业链细分和模式多元化的发展趋势，已形成了集成电路设计业、芯片制造业、封装测试业协调互动发展的格局。在我国，封装测试业作为起步最早和规模最大的环节，为产业链积累了丰富的技术和市场资源，对本地集成电路设计、制造业的发展起到了基础性、支撑性的作用。

本项目通过建设先进集成电路封装测试扩产基地，顺应全球集成电路封装测试产业向中国等亚太地区转移的发展趋势，利用公司现有技术和管理优势发展我国封装测试产业，进而推动我国集成电路产业链的健康发展，提高我国集成电路的全球份额。

②有利于提高集成电路封装的国产率，提升内资品牌市场份额

我国集成电路封装测试业成立之初主要是作为IDM的内部封测工序来实现，由于技术基础薄弱，一直发展较慢。到1995年，国内才出现了第一家专业封装代工企业，随后由于我国政府对集成电路产业的大力扶持，出台了对外商投资的优惠政策，吸引全球大型IDM和专业封装厂商纷纷在国内投资建厂，目前全球大型

半导体企业大都已在我国大陆建立了生产基地，致使外资企业在我国集成电路封装测试业市场占比很高，在技术方面也占据领先优势。

2011年，国内经过集成电路企业认定的封装测试企业有82家，其中内资或内资控股企业45家，其余均为外资或合资企业。2012年IC封装测试前十大企业中，我国内资企业仅占据2席。以MCM、MEMS、TSV等为代表的封装测试前沿技术也主要掌握在欧美日及中国台湾等外资、合资企业手中，只有少数内资企业掌握了部分技术。

本项目通过引进国内外先进设备，整合公司资源，扩大国产集成电路封装测试量，逐步提高内资企业的市场份额。

③有利于确保销售规模持续增长

气派科技自成立以来发展迅速，2011-2013年销售收入同比分别增长90.28%、33.96%和9.05%。从产销比率来看，2011-2012年的产销率都超过90%。

气派科技2011-2012年产能利用率接近100%，公司原先所租赁厂房使用已经饱和，没有足够的空间容纳生产所需的新设备和厂务设施的更新，大大限制了公司产能的扩充。为满足日益增长的市场需要，公司2013年搬至租用的东莞新厂房，购置新的设备以扩大现有的封装产能，使公司产能不足的问题暂时得到了缓解。

本项目建成后，将新增年封装产能SOT5亿只、SOP13亿只、QFN/DFN5亿只及BGA3,500万只，可以从根本上解决公司面临的产能不足与销售规模快速增长之间的矛盾。

④有利于公司的可持续发展，实现战略目标

公司致力于打造成具有先进技术水平、领先的产销规模和完善管理体系的“中国一流的集成电路封装测试服务商”。

本项目通过引进先进的生产工艺和设备，进一步提高公司的生产效率、完善产品质量；通过生产车间及仓储设施的建设，扩大集成电路封装测试的产销规模，优化公司产品结构，提高盈利能力。

本项目有利于进一步扩大公司规模经济效应和技术创新优势，整合公司积累的技术成果、生产经验和客户资源。最终从整体上大幅提升公司的综合实力，是

公司向“中国一流的集成电路封装测试服务商”战略目标前进而迈出的重要一步。因此，为满足公司整体规划和战略发展的需要，本项目的实施十分必要。

⑤完善公司产品种类，优化产品结构

公司的目前主要封装产品包括DIP、HDIP、Qipai、SOP、ESOP、SSOP、TSSOP、SOT、TO、MSOP、EMSOP、LQFP、HSOP、QFN、DFN等。

通过本项目的建设，公司将继续巩固SOT、SOP等系列产品的高性价比优势，同时，加大QFN/DFN、BGA等技术先进性产品的生产比重，在保持工艺技术创新及应用和成本领先优势的基础上，进一步丰富公司产品种类，使公司产品从传统优势产品延伸至技术先进性较高的产品，优化产品结构，增强公司产品的整体市场竞争能力。

⑥有利于提高公司的盈利能力

本项目为先进集成电路封装测试扩产项目，项目完全达产后，预计将为公司平均每年带来33,936.73万元的营业收入和4,479.16万元的净利润。通过公司先进集成电路封装测试生产基地的建设，有利于提高公司的整体盈利能力。

公司作为封装技术应用型企业，具备较强的工艺创新、成本控制和质量管理能力，在行业内建立了成本领先优势。未来通过持续的技术应用、工艺创新和经验积累，以及对技术先进型新产品的逐步开发和量产，公司未来几年主要产品毛利率仍能维持较高的水平。

通过本项目的建设，扩大公司封装测试的加工能力，提升设备先进性和工艺管理水平，有利于提高公司的整体盈利能力。

⑦把握市场机遇，提升市场地位

从国内来看，从事半导体封装测试的企业集中在长三角、环渤海及珠三角地区。长三角地区是目前我国集成电路设计、制造和封装测试企业最密集的区域，产业基础较好，产业链完善；珠三角地区由于是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，目前其在区域产值的比重具有提升的潜力；中西部地区由于成本优势、当地政府大力扶持和产业环境得到持续改善，对于集成电路产业的投资吸引力也明显提高。

以深圳为核心的珠三角地区由于是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，有助于大大节约运输时间和成本，方便企业与客户的交流和反馈。目前，珠三角地区受益于本地芯片设计企业迅猛增长和强劲市场需求带动，是我国集成电路产业增长最快的区域，随着珠三角地区集成电路发展潜力的逐步释放，产业配套的逐步完善，区域的发展优势将进一步突显。

气派科技地处深圳，电子元器件配套市场的迅速崛起以及半导体设计为气派科技提供了快速发展的沃土。通过本项目的建设，有利于公司把握市场机遇，扩大集成电路封装生产规模，提高公司市场占有率。

（3）项目建设的可行性分析

公司成熟的技术和工艺、设计及制造优势和项目引进的先进生产设备能确保本项目批量化生产的可行性。

① 成熟的技术和工艺

自2006年成立以来，公司业务增长迅猛，2013年公司集成电路封装测试达到29.10亿只的年产量，销售额达到2.84亿元人民币，已发展成为华南地区技术工艺领先、产品系列相对齐全、产销量规模最大的内资集成电路封装测试企业。

公司拥有IDF型高密度大矩阵引线框技术、塑封模具流道优化技术、大电流低饱和压降TrenchMOS生产工艺、铜制程技术、银合金线制程技术等重要工艺技术创新，在保证或提高封装产品性能的同时，大大提高了封测效率，降低了生产成本，各项指标符合国际认证及环保标准。

② 雄厚的设计及研发实力

公司的核心技术团队和管理团队多数拥有15年以上集成电路技术研发和生产管理经验，尤其是公司研发中心主任及创始人拥有近30年的集成电路技术研发和市场营销经验，公司已经建立了一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队。截至2014年6月底，公司拥有研发技术人员237人，占比25.82%。

自成立以来，公司持续加大研发投入和工艺创新，不断引进国际先进的生产设备，凭借核心管理团队丰富的技术研发和生产管理经验，取得了一系列创新成果。截至招股说明书签署日，已取得授权专利56项，其中发明专利1项，实用新

型专利55项。

③ 先进的生产设备

公司在封装设备选择方面，向国际一流公司看齐，配备了ASM（新加坡）、KOTAKI（日本）、Carton（日本）、ESPEC（日本）、三佳山田（中日合资）、YXLON（德国）、Agilest (美国)、GPM（台湾)等国际知名企业的设备，先进的封装设备为确保公司产品的高品质提供了可靠保证。

④ 广泛的客户群体确保产能消化

自2006年成立以来，公司业务增长迅猛，目前公司的主要客户群集中于华南区域，未来公司将在继续巩固华南区营销优势的基础上，采取以下市场开拓策略：

在国内市场，公司将在华东设立办事处，大力开发华东集成电路产业集聚区的客户，并有针对性地开发北京、西安、成都等IC设计企业密集的区域，采用集中拜访、专项突破的策略抢占市场。

在国际市场，借助深圳总部毗邻香港、台湾的地理优势，成立专门的海外销售团队，大力拓展台湾、香港地区客户，发掘当地经销商，与优质经销商展开合作，借助其资源优势逐步打开韩国、日本及欧美市场。

同时，对外宣传方面，公司将加大平面媒体、互联网宣传力度，同时参加有影响力的行业展会、行业论坛及研讨会，以提升公司品牌形象和市场知名度。

4、项目投资概算及投资计划

单位：万元

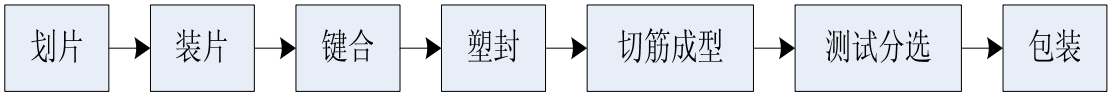
序号	工程或费用名称	T+1	T+2	T+3	T+4	投资额	占比
1	建设投资	10,062.33	10,527.50	6,458.78	4,839.79	31,888.40	87.30%
1.1	建筑工程及设备	8,407.04	9,135.07	6,014.50	4,691.70	28,248.31	77.33%
1.1.1	设备购置及安装费	4,983.90	4,120.00	6,014.50	4,691.70	19,810.10	54.23%
1.1.2	土建工程费	2,892.50	2,892.50			5,785.00	15.84%
1.1.3	装修工程费	530.64	2,122.57			2,653.21	7.26%
1.2	建设工程其它费用	1,062.91	1,096.24			2,159.16	5.91%
1.3	预备费	592.37	296.19	444.28	148.09	1,480.93	4.05%
2	铺底流动资金	924.52	1,336.62	1,828.18	550.12	4,639.43	12.70%
3	项目总投资	**10,986.85**	**11,864.11**	**8,286.96**	**5,389.91**	**36,527.83**	**100%**

5、工艺流程和设备选择情况

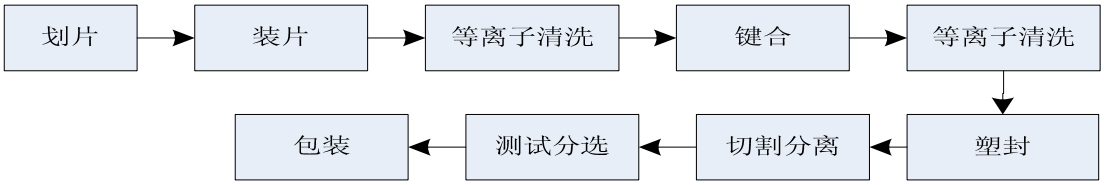
（1）生产工艺流程

公司在产品生产过程中，为保证产品质量，制定的集成电路封装生产工艺流程图如下：

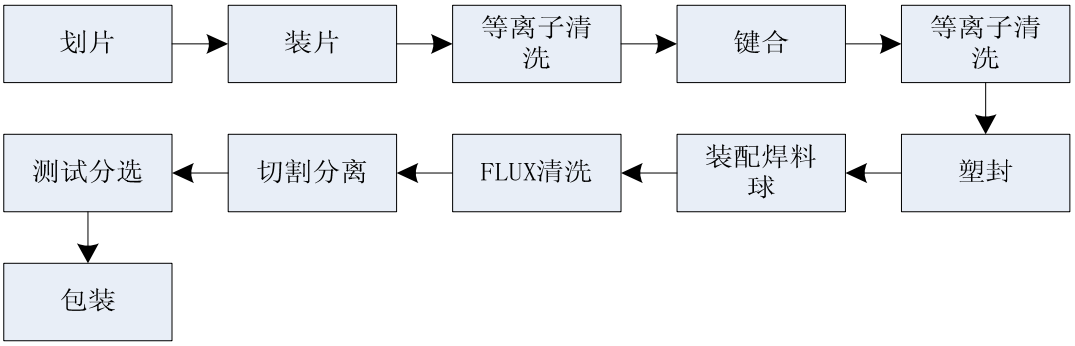
①SOT、SOP



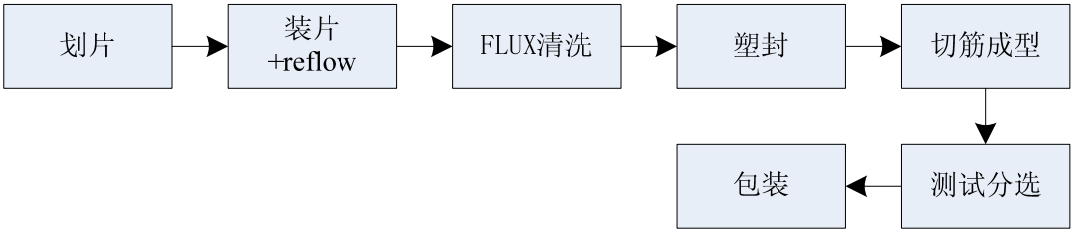
②QFN/DFN



③BGA



④Flip-Chip



（2）设备购置清单

本项目设备选择主要遵循保证产品质量、优化工艺流程、降低生产成本、减

少环境污染等原则。本项目设备购置与安装的总费用为19,810.10万元(不含税价格)。

①SOT主要生产设备

序号	设备名称	品牌	是否需要进口	不含税单价（万元）	数量（台）	总金额（万元）
1	芯片划片	DISCO 或同类	是	170.94	1	170.94
2	装片	ASM 或同类	是	77.78	6	466.67
3	键合	ASM 或同类	是	35.64	18	641.53
4	塑封	三佳或同类		42.74	2	85.47
5	塑封模具	三佳或同类		25.64	2	51.28
6	打印			10.26	6	61.54
7	切筋	ASM 或同类	是	72.65	1	72.65
8	切筋模具	ASM 或同类	是	21.37	2	42.74
9	测试机	长川或同类		15.38	6	92.31
10	分选机	ASM 或同类	是	62.39	6	374.36
合计					**50**	**2,059.49**

②SOP主要生产设备

序号	设备名称	品牌	是否需要进口	不含税单价（万元）	数量（台）	总金额（万元）
1	芯片划片	DISCO 或同类	是	170.94	2	341.88
2	装片	ASM 或同类	是	77.78	20	1,555.56
3	键合	ASM/KNS	是	35.64	61	2,174.10
4	塑封	国产		42.74	9	384.62
5	塑封模具	国产		25.64	9	230.77
6	打印	大族或同类		20.51	5	102.56
7	切筋	高柏斯或同类	是	85.47	4	341.88
8	切筋模具	高柏斯或同类	是	21.37	6	128.21
9	测试机	德率泰或同类		17.09	10	170.94
10	分选机			11.97	40	478.63
合计					166	**5,909.15**

③QFN&DFN主要生产设备

序号	设备名称	品牌	是否需要进口	不含税单价（万元）	数量（台）	总金额（万元）
1	减薄机	DISCO 或同类	是	512.82	1	512.82
2	芯片划片	DISCO 或同类	是	170.94	3	512.82
3	装片	ASM 或同类	是	77.78	8	622.22
4	清洗机	DAGE 或同类	是	48.72	2	97.44
5	键合	ASM 或同类	是	40.60	63	2,557.69
6	塑封	ASMAutoMolding 或同类	是	384.62	2	769.23
7	塑封模具	ASM 或同类	是	29.91	18	538.46
8	打印	大族或同类		20.51	5	102.57
9	JiaSaw	ASM 或同类	是	247.86	6	1,487.18

10	测试机	按照测试产品需求购买		42.74	10	427.35
11	分选机	ASM、SRM 或同类	是	62.39	13	811.11
合计					131	**8,438.89**

④BGA主要生产设备

序号	设备名称	品牌	是否需要进口	不含税单价（万元）	数量（台）	总金额（万元）
1	装片	ASM 或同类	是	77.78	1.00	77.78
2	键合	ASM 或同类	是	33.33	18.00	600.00
3	清洗机	DAGE 或同类	是	48.72	1.00	48.72
4	塑封	ASMAutoMolding 或同类	是	384.62	1.00	384.62
5	塑封模具	ASM 或同类	是	29.91	4.00	119.66
6	植球机	AMS 或同类	是	205.13	1.00	205.13
7	回流焊炉	HTC 或同类	是	30.77	1.00	30.77
8	打印	ASM 或同类	是	17.09	1.00	17.09
9	切割机	ASM 或同类	是	128.21	1.00	128.21
10	外观检测	ICOS 或同类	是	128.21	1.00	128.21
11	测试机	按照测试产品需求购买		119.66	3.00	358.97
12	分选机	AMS 或同类	是	239.32	3.00	717.95
合计					36	**2,817.09**

⑤主要公用设备

序号	设备名称	功率	不含税金额（万元）
1	变压器，电缆及电源交换机	2*2500KVA	256.41
2	塑封材料冻库	400 立方	42.74
3	制氮系统	100 立方	42.74
4	纯水系统	20 吨/小时	42.74
5	X-ray 系统		29.91
6	空压机系统	6*180 匹	170.94
合计			**585.48**

6、项目的原材料和能源供应

公司产品主要原材料包括引线框架、铜线、金丝、装片胶、塑封树脂等，引线框架的主要材料是金属铜，金丝主要材料为黄金，其成本与黄金和铜价格走势密切相关。

公司金线采购根据上海期货市场当日黄金现货交易开盘价作为交易计价标准。近年来，金线价格随黄金价格波动而波动较大，但是公司铜线、合金线焊接工艺技术成熟，应用金线的产品比重较少，低于20%，因此黄金价格波动对公司影响不大。尽管引线框的价格根据银和铜的价格有一定的浮动，但整体呈波动下

降的趋势，供货也比较稳定。

如果经营期内黄金和铜的价格大幅增长，将增加公司的生产成本，对公司业绩造成一定影响。

7、项目的环保情况

集成电路封装生产是轻污染性质的生产，主要污染源为器件引线框外引线镀锡所产生的酸性废水、排出的废气，晶圆划片后含少量硅悬浮物的清洗水，装片、包封工序产生含少量有机气体的废气，冷却剂、空压机、空调等动力设备所产生的噪声。

本项目建成后主要从事先进集成电路封装测试生产活动，电镀生产环节仍是外协式生产，不存在酸性废水污染。项目生产中使用的主要材料为芯片、引线框、铜线、金丝和塑封树脂等，这些材料基本为直接材料，材料消耗后形成产品，产品污染物极少。

本项目符合国家环保法律法规的规定，2014年2月19日，东莞市环境保护局出具了《关于广东气派科技有限公司先进集成电路封装测试扩产项目环境影响报告表的审批意见》【东环建（2014）0374号】的环保评估审核。

8、项目选址情况

本项目选址位于广东省东莞市石排镇福隆第二工业区二路，地块为公司已经购入的土地。东莞市地理位置优越，交通便利，供水、供电、供气等各项生活及市政公共基础设施完善，为新项目的建设及建成后的运行提供了良好的发展环境。

9、项目的组织方式及实施进展情况

本项目将以公司全资子公司广东气派科技有限公司为主体组织实施。

10、项目经济效益分析

项目	所得税前	所得税后
项目投资净现值(Ic=12%)（万元）	15,716.61	8,366.44
项目投资内部收益率(IRR)	24.59%	18.84%
静态投资回收期（年）	5.64	6.49
动态投资回收期（年）	6.99	8.96

本项目的税后内部收益率（IRR）是18.84%，税前是24.59%。考虑资金的时间价值后，税后投资净现值是8,366.44万元，项目的内部收益率较高，净现值为正，投资价值大。

本项目考虑资金的时间价值后，动态税后投资回收期是8.96年（含建设期4年），项目的投资回收期相对较短，风险较小。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为本公司的全资子公司广东气派，建设地点为广东省东莞市石排镇福隆第二工业区二路，项目建设期为2.5年。本项目总投资4,921.51万元，其中工程建设费800万元，装修费300万元，研发设备购置及安装费3,264.90万元。

2、项目建设的必要性

（1）行业发展趋势的必然要求

在过去几十年里，为适应集成电路向小型化、高速化、高频化、大功率发展的需要，集成电路封装技术得到了不断的提高和改进，呈现出向高密度、高脚位、薄型化、小型化发展，单芯片向多芯片发展，平面封装（MCM）向立体封装（3D）发展的趋势。在以手机、笔记本电脑、平板电脑等为代表的便携式电子产品快速增长的市场需求拉动下，达成IC封装轻薄短小的BGA、CSP、WLCSP和Flip-Chip技术、实现多芯片平面封装的MCM技术、具备系统级立体封装特点的SiP技术，实现3D堆叠封装的关键技术—TSV等先进的封装技术未来将得到更广泛的应用。

从市场需求角度来看，在国内电子信息产业需求拉动和全球集成电路产业链进一步向我国转移的共同作用下，未来我国集成电路产业持续向好。据《国家集成电路产业发展推进纲要》，到2015年我国集成电路产业销售收入将超过3,500亿元。

面对集成电路封装测试行业快速增长的市场需求和不断涌现的新技术、新产品，公司近年来一直加大研发投入并已取得一系列成果，但受资金限制，公司研发检测设备和研发经费的投入仍然难以满足集成电路封装测试市场的技术需求，严重影响了公司对集成电路封装测试市场的开拓。通过此次研发中心项目的实

施，公司不仅能够向研发中心投入更多先进的仪器和设备，还能引进更多的国内外尖端研发人才，加大研究经费的投入力度，增强公司的研发实力，本项目将致力于研发Flip-Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV等先进封装技术以满足公司和行业发展的需要。

（2）增强产品市场竞争力的需求

随着集成电路不断向小型化、高集成度、多功能等方向发展，对原材料的品质要求也在不断提高。集成电路封装用到的主要原材料包括丝材、框架、装片胶和塑封树脂，丝材在集成电路封装中起到导线连接的作用，将芯片表面电极和框架引脚连接起来。如何提高导电性、导热性、可靠性，并降低生产成本，是丝材的研发重点；框架在电路中主要起承载IC芯片的作用，同时起连接芯片与外部线路板电信号的作用，以及安装固定的机械作用等。优质的框架需具备良好的导电性、导热性、热匹配（即热膨胀）、强度、耐氧化性、耐热性和耐腐蚀性；装片胶用于将芯片固定在引线框或基板上，并提供导热或导电功能，因此良好的粘性、导热性和导电性是装片胶的发展方向；塑封树脂起到密封芯片、绝缘的作用，开发低粘度的塑封树脂可提升封装材料流动性、减少封装成型固化收缩和热收缩产生的热应力，达到节约原材料成本，减少开裂、导线松动和断裂等不良缺陷的目的。同时，随着封装器件的高性能化，要求塑封树脂同时具备高耐热和低吸水性。

新型材料应用研发不但要考虑如何提升封装器件的品质，而且由于集成电路封装测试环节原材料成本占比较高，如何节约成本也是新型材料应用研发的重点内容。目前公司在新型材料研发方面已取得一系列显著成果。公司已攻克了铜球硬、可焊性差的难点，解决了银-铝合金元素迁移问题，大大节约了封装成本。在框架方面，公司联合供应商开发IDF型高密度大矩阵引线框，并定制适合高密度引线框的生产设备，通过提高芯片排列密度，减少了单只芯片所占材料的面积。此外，公司在模具设计环节对传统流道进行了创新设计，使塑封树脂材料的利用率得到大幅提高。

本项目建成后，公司将通过引进封装材料领域的高端人才，组建新材料研发室，加强对高品质的新型塑封树脂、装片胶、框架以及高可靠性的合金线、铜带等新型材料的应用研发，达到降低生产成本、提升产品质量的目的，从而进一步提升公司产品的市场竞争力。

（3）提升公司科研创新能力的需求

集成电路封装测试行业正面临激烈的市场竞争，新产品新技术不断涌现，自主创新能力对企业显得尤为重要。为适应国家产业政策、行业发展以及企业发展的需要，公司通过在新产品开发、设备、模具、生产工艺方面的创新，掌握了DIP、SOP、ESOP、SSOP、TSSOP、MSOP、QFP、QFN、DFN等多种封装测试产品的核心技术，并创造性地开发了DIP10和Qipai系列这两大公司独有产品。公司产品可靠性高、性价比突出，但与国内外行业先进企业相比，在封装形式和封装种类方面仍存在一定的差距。

公司自成立以来一直十分重视技术创新，面对激烈的市场竞争，公司既需要对现有产品的材料、工艺、设备、模具等方面进行技术革新，进一步降低生产成本，也需要以行业发展和客户需求为导向，开发出更小、更轻薄、功能更强大的集成电路封装测试新产品，为公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。研发环境的优劣直接影响到公司的技术创新能力，以及公司的研发效率与产品质量，因此公司需要大量引进集成电路封装测试行业的科技人才，引入先进的研发设备，完善现有技术创新体系，不断充实公司的研发团队并优化研发环境。

本项目实施后，将有效解决公司的研发中心在研发场地、研发设备、研发人才等方面的不足，大幅改善研发中心的软硬件环境，提升公司在集成电路封装测试产业的技术研发水平，从而逐步缩小与国内外先进企业的技术差距。

（4）丰富产品种类，实现公司可持续盈利的需要

集成电路广泛用于计算机、通信、消费类电子、汽车电子、工业制造中，下游客户从电子产品的体积、功能、成本、可靠性等多方面考虑，需要选用不同的封装测试技术。为适应不断变化的市场形势，满足下游多样化的需求特点，同时为公司创造新的利润增长点，公司计划通过建设高水平的研发中心对Flip-Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV等先进封装技术、新型封装材料、新生产工艺和新设备等问题进行深入研究，通过自主创新掌握国际前沿封装领域的关键技术，并实现规模化生产，为公司未来的持续快速发展提供技术来源和保障。

3、项目投资概算及建设计划

（1）项目投资概算

序号	费用名称	投资额（万元）				占比
		T+12 个月	T+24 个月	T+30 个月	合计	
1	建设投资	1,757.60	1,106.40	1,500.90	4,364.90	89.92%
1.1	设备购置及安装费	957.60	806.40	1,500.90	3,264.90	21.81%
1.2	工程建设费	800	-	-	800.00	20.48%
1.3	装修费	-	300.00	-	300.00	7.68%
2	土地购置费	98.36	-	-	98.36	2.52%
3	流动资金	30	110.00	100.00	240.00	3.07%
4	预备费	87.88	55.32	75.05	218.25	4.50%
合计		**1,973.84**	**1,271.72**	**1,675.95**	**4,921.51**	**100%**

（2）项目建设计划

本次募投项目建设期为2.5年，工程前期准备3个月，包括市场调研、技术开发、研究、开展工厂设计、相关手续的审批；工程建设期为27个月，包括研发中心办公楼及各类辅助设施施工、设备定货及委托加工、设备到货、安装、单机试运转等。

公司计划先以自有资金进行本募投项目建设，待募集资金到位后置换自有资金投资部分。

（3）新增主要设备

研发中心所需设备应结合技术发展趋势，既要满足研发需要，又要具备先进性。据此，研发中心拟投入3,264.90万元购置研发设备，新购置设备清单如下：

单位：台/套；万元

序号	设备名称	设备用途	数量	单价	总价	是否进口
1	表面蒸金系统	SEM 检测时导通电荷	1	9.45	9.45	是
2	能普分析仪	表面元素分析	1	31.50	31.50	是
3	液晶热点分析仪	寻找产品失效位置	1	22.05	22.05	是
4	全自动开封机	塑封体开封用	1	25.20	25.20	是
5	清洗机	清洗划片后的芯片	1	113.40	113.40	是
6	等离子清洗机	清洗待焊线的半成品	1	94.50	94.50	是
7	自动塑封系统	注塑设备	1	441.00	441.00	是
8	超薄减薄机	减薄芯片	1	630.00	630.00	是
9	超薄划片机	划片	1	157.50	157.50	是
10	自动断面研磨机	研磨样品层面	1	31.50	31.50	是
11	Clipbonder	装片,焊接铜带	1	113.40	113.40	是
12	植球机	植球	1	113.40	113.40	是
13	测试机	测试	1	630.00	630.00	是
14	SMT	贴片	1	252.00	252.00	是
15	TSV 测试设备	测试	1	600.00	600.00	是
合计					**3,264.90**	

4、项目建设目标及研发中心的研发方向

（1）项目建设目标

本项目建设的主要目标是：

①将建成新产品研发室、新工艺研发室、新材料研发室、新设备研发室和新产品导入室，力争将气派科技的研发中心建设成为具有国内先进水平的集成电路封装测试研发中心，并开展支撑企业中长期发展需要的技术创新工作，组织专业人员对关键技术工艺进行攻关，解决Flip-Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP和TSV的关键技术和工艺难题，保证所开发的产品具有更好的可靠性、电气性能、散热性、更小的体积、更低的噪声和更强的抗电磁干扰（EMI）能力，丰富公司产品种类，切实提高公司产品的质量，从而极大地提升公司产品的市场竞争力和市场占有率；

②未来3～5年内将完成BGA、Flip-Chip、CSP和WLCSP四项新技术的样品试制，并逐步形成小批量生产和规模化生产能力，同时收集MCM、SiP和TSV三项技术的市场需求和最新技术动态，进行初步研究开发。未来五年内将完成包括MCM、SiP和TSV在内共7项新技术的样品试制，并形成批量生产能力；

③在确保产品可靠性的前提下，以提高生产效率、降低成本为目标，不断研发改进适合公司产品的新工艺和新设备；

④进行高品质的新型塑封树脂、装片胶、框架以及高可靠性的合金线等新型材料的应用研究，在降低生产成本的同时提升产品质量，从而进一步增强公司产品的市场竞争力；

⑤与国内外高校、研究机构建立研究合作关系，吸收引进骨干科技人才；

⑥通过研发中心的建设，规范企业科技活动管理与科技资源整合、利用等工作，规范企业核心技术的知识产权管理、专利申报、维护等工作。

（2）研发方向

在电子产品不断朝着微型化、轻便化、多功能化、高集成化和高可靠性方向发展的推动下，集成电路封装技术也向高密度化、小型化、薄型化、多引脚或无引脚的方向发展。

目前国内市场的主要需求仍在DIP、SOP、QFP、QFN等产品上，但随着数码相机、智能家电、智能手机和平板电脑等消费及通信领域技术的迅猛发展，国内芯片市场对Flip--Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV等先进的封装技术的市场需求将呈现逐年上升的趋势。

目前国内集成电路厂商中仅有少数企业拥有上述先进封装技术，面对集成电路封装技术升级带来的机遇和挑战，公司将进一步加大研发投入，加快高端人才引进步伐，开展Flip-Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP和TSV等先进集成电路封装技术的研发创新，并尽早将成果转换成生产力，为抢占市场份额，实现公司持续盈利增长提供技术保障。

5、项目的环保情况

本项目生产过程产生的污染物经过处理和回收，均达到环保要求。其中研发过程中产生的各种边角料经收集后由专门的环保公司回收利用，对环境不造成污染；生活垃圾收集后由环卫人员送至当地的垃圾处理厂进行统一处理；污水经处理装置处理满足接管标准后排入污水管网，后经当地污水处理厂统一处理；对研发过程中的设备噪声污染，公司通过提高设备自动化程度、减少人工操作等方法减少其对员工和周边环境的影响。

本项目符合国家环保法律法规的规定，已通过东莞市环境保护局【东环建（2014）0015号】《关于广东气派科技有限公司研发中心建设项目环境影响报告表的批复》的环保评估审核。

6、项目选址情况

本项目选址位于广东省东莞市石排镇福隆第二工业区二路，地块为公司已经购入的土地。

7、项目的组织方式和进展情况

本项目将以公司全资子公司广东气派科技有限公司为主体组织实施。

8、本项目对公司经营成果的影响

本项目不直接产生经济效益，产生的间接经济效益一是体现在未来公司新产品以及升级产品的生产销售，二是体现在公司研发设计方面的服务能力、服务水

平、服务质量的提升上，最终体现在公司营业收入规模的增加和毛利率的上升。

根据公司现行的折旧政策和无形资产摊销政策，公司预计项目正式建成后，将每年新增固定资产折旧和无形资产摊销共计347万元。

第十四节 股利分配政策

一、报告期内的股利分配政策

报告期内，本公司分配当年税后利润时，按以下顺序进行分配：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司可以采取现金和/或股份方式分配股利。公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司在盈利年度应当分配股利，公司可以采取现金或者股份方式分配股利。

二、报告期内的股利分配情况

最近三年，本公司股利分配情况如下：

（一）2011 年度股利分配情况

根据2012年8月16日的召开的股东会审议通过2011年度利润分配方案：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职深ZH[2012]565号），公司截至2011年12月31日的累计未分配利润为人民币28,205,514.19元，现决定对全体股东分配利润共计12,500,000.00元（含税），各股东分别按其出资比例分配并享有该等利润（含税），具体为：梁大钟按85%的出资比例分配并享有利润10,625,000.00元（含税）；白瑛按15%的出资比例分配1,875,000.00元（含税）。公司已于2012年11月30日分配完毕。

公司股利分配方案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）2012 年度股利分配情况

2012年度，公司未进行股利分配。

（三）2013 年度股利分配情况

根据2014年3月29日的召开的2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2014]7123号），母公司2013年度实现税后净利润47,701,124.35元。同时由于公司2013年分别对以2013年3月31日为基准日期、2013年1-3月所产生的利润8,639,925.47元全部进入资本公积金，故2013年母公司实际可支配的净利润为39,061,198.88元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积3,906,119.89元，母公司可供股东分配利润为35,155,078.99元。股东大会决定决定以2013年末总股本7,300万股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金红利，共将分配现金730万元，现金分红比例占母公司可分配利润数额的20.77%。

公司股利分配方案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、发行后的股利分配政策

公司2014年第四次（临时）股东大会审议通过了发行上市后适用的《公司章程》（草案），公司利润分配政策主要如下：

（一）利润分配的原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但应当优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。

（三）利润分配的具体内容和条件

公司进行现金分红应同时具备以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或超过5,000万元。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。

在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的20%，且在任何3个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。

公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：1、公司经营情况良好；2、因公司股票价格与公司股本规模不匹配或者公司有重大投资计划或重大现金支出、公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东的整体利益；3、公司的现金分红符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）利润分配政策及其调整的决策程序和机制

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和《公司章程》的规定制订合理的利润分配方案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，其中，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对公司生产经营造成重大不利影响的，公司经详细论证后可以对既定利润分配政策作出调整。公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符

合有关法律、法规的规定，经董事会审议通过后须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在有关法律、法规、规范性文件允许或《公司章程》规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因、留存未分配利润的用途以及独立董事的明确意见，公司当年的利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司在将该利润分配议案提交股东大会审议时应为投资者提供网络投票便利条件。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

四、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据2014年第四次（临时）股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股股票前滚存利润分配方案》议案决议，若公司首次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票完成后由新老股东按其持股比例享有。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露制度相关情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本公司制定了《信息披露管理制度》，规范和完善公司信息管理制度，更好地履行信息披露义务。

公司由证券法律事务部负责信息披露和投资者关系，具体工作由董事会秘书负责实施。公司信息披露和投资者关系的对外联系方式是：

董事会秘书	文正国
联系电话	0755-89386868-8501
传真	0755-89386103
地址	深圳市龙岗区平湖街道平新大道165号恒顺厂区1栋气派科技股份有限公司

二、重要合同

截至本招股说明书签署日，对公司具有重要影响的合同如下：

（一）销售合同

根据行业惯例，公司与供应商、客户之间的采购合同、销售合同均是以签署框架协议和订单、报价单的形式履行，框架协议约定产品、交付、验收、质量等基本条款，具体产品名称、数量、价格等以订单或报价单为准。

公司与主要客户签订的正在履行的框架协议如下：

1、2011年1月15日，公司与深圳市环宇微电子有限公司签署《集成电路封装协议》（合同编号：QPSZ-820-201101008），约定由公司对环宇微提供的大圆片（Wafer）进行塑封加工，环宇微须提前一个月将封装数量书面通知公司，单价以环宇微下单前双方签字确认的最新单价为准。本协议自签订之日起生效，至合作终止或另签新协议生效时终止。

2、2011年1月20日，公司与深圳市励创微电子有限公司签署《集成电路封装协议》（合同编号：QPSZ-820-201101007），约定由公司对励创微提供的大圆片

（Wafer）进行塑封加工，励创微须提前一个月将封装数量书面通知公司，单价以下单前双方签字确认的最新单价为准。本协议自签订之日起生效，至合作终止或另签新协议生效时终止。

3、2011年7月1日，公司与深圳市南翔科技有限公司签署《集成电路封装协议》（合同编号：QPSZ-820-201106003），约定由公司对南翔科技提供的大圆片（Wafer）进行塑封加工，南翔科技须提前一个月将封装数量书面通知公司，单价以下单前双方签字确认的最新单价为准。本协议自签订之日起生效，至合作终止或另签新协议生效时终止。

4、2011年10月6日，公司与深圳普达芯电子有限公司签署《集成电路封装协议》（合同编号：QPSZ-820-201110004），约定由公司对普达芯提供的大圆片（Wafer）进行塑封加工，普达芯须提前一个月将封装数量书面通知公司，单价以下单前双方签字确认的最新单价为准。本协议自签订之日起生效，至合作终止或另签新协议生效时终止。

5、2011年10月12日，公司与深圳市华芯邦科技有限公司签署《集成电路封装协议》（合同编号：QPSZ-820-201110003），约定由公司对华芯邦提供的大圆片（Wafer）进行塑封加工，封装数量须提前一个月书面通知公司，单价以下单前双方签字确认的最新单价为准。本协议自签订之日起生效，至合作终止或另签新协议生效时终止。

6、2013年10月26日，公司与深圳市馨晋商电子有限公司签署《集成电路封装协议》（合同编号：QP-820-030-300126），约定由公司对馨晋商提供的晶圆（Wafer）进行塑封加工，封装数量应当提前三十天书面通知公司，单价以双方有权代表签字或者盖章确认的最新书面单价为准。本协议长期有效。

7、2014年9月11日，公司与华润赛美科微电子（深圳）有限公司签署《集成电路委托加工合同》（合同编号：10140123#），约定由公司对华润赛美科提供的圆片进行封装加工，封装加工量由华润赛美科在每月20日前提供下月订单预测，每季度的前10天提供下季度订单预测，封装单价和付款方式以报价单方式另行订立。本协议有效期为一年，协议任何一方未在协议到期前的1个月内书面通知另一方终止或修改本协议，则协议自动续延。

（二）采购合同

1、原材料采购

公司与主要原材料供应商签订的正在履行的框架协议如下：

（1）2013年1月1日，公司与汉高华威电子有限公司签署《销售合同》（合同编号：QP-810-P360008），约定公司向汉高华威采购产品，合同有效期至2015年12月31日。根据公司与汉高华威签署的采购订单，公司采购的产品主要为半导体环氧塑封料。

（2）2013年1月7日，公司与宁波康强电子股份有限公司签署《基本采购合同》（合同编号：QP-810-P31210），约定公司向宁波康强采购产品，合同有效期为一年，如在合同期满之日前两个月双方均未书面提出终止合同的，合同有效期自动延续一年，且此后以此方式延续，直至双方业务往来结束。根据公司与宁波康强签署的采购订单，公司采购的产品主要为丝材、引线框。

（3）2014年1月7日，公司与进峰贸易（深圳）有限公司签署《采购合同》（合同编号：10140144），约定公司向进峰贸易采购产品，合同有效期一年，如在合同期满之日前两个月双方均未书面提出终止合同的，合同有效期自动延续一年，且此后以此方式延续，直至双方业务往来结束。根据公司与进峰贸易签署的采购订单，公司采购的产品主要为引线框。

2、设备采购

公司与主要设备供应商签订的正在履行的框架协议如下：

2014年2月11日，公司与先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司签署《设备买卖合同》（合同编号：QP-810-P201402001），约定公司向其采购15台热超声焊线机，合同总金额为人民币583.01万元。

（三）授信及担保合同

合同名称及编号	授信/承兑银行	授信/承兑额度	授信期限	担保合同及编号	担保方式	担保人
《授信额度协议》2014 圳中银布额协字第 0000527 号	中国银行股份有限公司深圳布吉支行	授信额度（承兑汇票额度）为人民币 2,000 万元	自 2014.6.11 至 2015.6.10	《保证金质押总协议》2014 年圳中银布质总字第 049 号	保证金质押	公司
				《最高额保证合同》2014 年圳中银布保额字第 0027 号	最高额连带责任保证	梁大钟
				《最高额保证合同》2014 年圳中银布保额字第 0028 号	最高额连带责任保证	广东气派
《授信协议》2014 年龙字第 0014633002 号	招商银行股份有限公司深圳横岗支行	授信额度为人民币 4,000 万元	自 2014.3.10 至 2015.3.9	《最高额抵押合同》2014 年龙字第 0014633002 号	最高额抵押	公司
				《最高额不可撤销担保书》2014 年龙字第 0014633002-01 号	最高额连带责任保证	梁大钟
				《最高额不可撤销担保书》2014 年龙字第 0014633002-02 号	最高额连带责任保证	白瑛

（四）其他重要合同

1、2014年2月，广东气派科技有限公司与东莞市建工集团有限公司签署《广东省建设工程标准施工合同》（合同编号：20140002），约定由东莞市建工集团有限公司承包广东气派科技有限公司位于东莞市石排镇福隆村第二工业区二路的广东气派科技有限公司新建工厂项目，合同价款为人民币15,730万元，合同工期为300天，拟从2014年3月20日开始施工，至2015年1月20日。

2、2014年6月3日，公司与香港应用科技研究院有限公司（以下简称“香港应科院”）签署《技术合作开发及许可协议》，约定由香港应科院与公司在集成电路封装测试领域进行研发合作，并以开发BGA和Flip-chip产品及研发相关技术作为双方合作的起点。香港应科院向公司提供10项交付技术及合作开发成果及服务，许可公司及其子公司广东气派科技有限公司在中国内地使用许可技术进行产品生产和销售；前述10项交付技术及合作开发成果中第3项三维封装技术（含有嵌入式主动和被动元器件并以BGA的形式进行封装）和第6项三维封装技术（含有嵌入式主动和被动元器件并以Flip-chip的形式进行封装）相关的知识产权为香港应科院所有，其余第1、2、4、5、7-10项技术（包含基于仿真芯片、功能芯片以BGA形式的先进封装技术以及基于仿真芯片、功能芯片以Flip-chip形式的先进封装技术及样品等）相关的知识产权为公司所有。公司应向香港应科院支付许可费、使用费和服务费，其中：许可费总额为人民币50万元，根据第3项和第6项技术项目进程分三期支付；使用费=每项最终产品“封装加工费”单价×每项最终产品封装加工数量×该项相应使用费收费率（使用费收费率根据第3项和第6项技术最终产品的累计封装加工净额确定）；服务费总额为人民币90万元，根据第1、2、4、5、7-10项技术项目进程分五期支付。本协议自签订之日起生效，有效期为五年。

三、对外担保

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保。

四、重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书签署日，公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼及仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

五、刑事诉讼

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未涉及刑事诉讼。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

梁大钟：梁大钟　白　瑛：白瑛　施保球：施保球

孟　宇：孟宇　魏云海：魏云海　陈　贤：陈贤

吴战篪：吴战篪

全体监事：

周建斌：周建斌　赵　红：赵红　孙少林：孙少林

高级管理人员：

梁大钟：梁大钟　施保球：施保球　林　忠：林忠

文正国：文正国　谭云烽：谭云烽

气派科技股份有限公司

2014 年 11 月 25 日

二、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

李钦军

保荐代表人：

程久君 杜跃春

法定代表人：

何 如

国信证券股份有限公司

2014年11月25日

三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

支毅　　敖华劳　　王永强

律师事务所负责人签名：

赵洋

北京市竞天公诚律师事务所

2019年11月25日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

屈先富

韩雁光

刘光荣

会计师事务所负责人签名：

陈永宏

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年 11月 15日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师签名：

邓春辉

段振强

资产评估机构负责人签名：

郑文洋

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2019年11月15日

六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

屈先富

韩雁光

刘光荣

会计师事务所负责人签名：

陈永宏

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年 11月 15日

第十七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间

查阅时间为发行期间每个工作日的上午9:00—11:00，下午2:00—5:00

三、备查文件查阅地点

（一）发行人：气派科技股份有限公司

公司地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新大道165号恒顺厂区1栋1楼105、2-5楼

邮编：518111

电话：0755-89386868-8501

传真：0755-89386103

互联网址：http://www.szscpc.com

联系人：文正国

（二）保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

公司地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

电话：0755-82134633

传真：0755-82131766

联系人：程久君、杜跃春、李钦军、张文、洪甜恬、侯立潇